785G-E65 Series

MS-7576 (v1.x) Mainboard



G52-75761X7

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks are the properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of ATI Technologies, Inc.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of Advanced Micro Devices, Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is a registered trademark of Novell, Inc.

Revision History

Revision	Revision History	Date
V1.2	For PCB 1.X, Asia version	August 2009

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

- Visit the MSI website for FAQ, technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information: ***http://www.msi.com/index.php?func=service***
- Contact our technical staff at: ***http://ocss.msi.com***

Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source and adjust properly 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that could damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.

  DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

警告使用者:

這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycleing special disposal.

FCC-B Radio Frequency Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

OIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

TABLE OF CONTENTS

Copyright Notice ii
Trademarks ii
Revision History ii
Technical Support ii
Safety Instructions iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement iv
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement v
English En-1
Mainboard Specifications En-2
Quick Components Guide En-4
CPU (Central Processing Unit) En-5
Memory En-8
Power Supply En-10
Back Panel En-11
Connectors En-13
Button En-19
Switch En-20
Slots En-21
LED Status Indicators En-24
BIOS Setup En-25
Software Information En-37
한국어 Kr-1
메인보드 사양 Kr-2
빠른 부품 설명서 Kr-4
CPU (중앙 처리 장치) Kr-5
메모리 Kr-8
전원 공급 장치 Kr-10
후면 패널 Kr-11
커넥터 Kr-13
버튼 Kr-19
스위치 Kr-20
슬롯 Kr-21
LED 상태 표시기 Kr-24
BIOS 설정 Kr-25
소프트웨어 정보 Kr-37
日本語 Jp-1
マザーボードの仕様 Jp-2

クイックコンポーネントガイド Jp-4
CPUに関する注意事項 Jp-5
メモリ Jp-8
電源 Jp-10
I/Oパネル Jp-11
コネクター Jp-13
ボタン Jp-19
スイッチ Jp-20
スロット Jp-21
状態表示LED Jp-24
BIOSの設定 Jp-25
ソフトウェアの情報 Jp-37
繁體中文 Tc-1
主機板規格 Tc-2
快速零組件指南 Tc-4
CPU (中央處理器) Tc-5
記憶體 Tc-8
電源供應器 Tc-10
背板 Tc-11
接頭 Tc-13
按鈕 Tc-19
開關 Tc-20
插槽 Tc-21
LED 燈號說明 Tc-24
BIOS 設定 Tc-25
軟體訊息 Tc-37
简体中文 Sc-1
主板规格 Sc-2
组件快速指南 Sc-4
CPU (中央处理器) Sc-5
内存 Sc-8
电源适配器 Sc-10
后置面板 Sc-11
接口 Sc-13
按钮 Sc-19
开关 Sc-20
插槽 Sc-21
LED 状态灯说明 Sc-24
BIOS 设置 Sc-25
软件信息 Sc-37

785G-E65 Series

English

Asia version

Mainboard Specifications

Processor Support

- AMD® Phenom™ II X4/ X3 and Athlon X4/ X3/ X2 processors in the AM3 package.
  (For the latest information about CPU, please visit
  http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0, supports up to 5.2 GT/s

Chipset

- North Bridge: AMD® 785G chipset
- South Bridge: AMD® SB710 chipset

Memory Support

- DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*=OC) SDRAM (total 16GB Max)
- 4 DDR3 DIMMs (240pin / 1.5V)
  (For more information on compatible components, please visit
  http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

- Supports PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® RTL8111DL

IEEE 1394 (optional)

- Chip integrated by VIA® VT6315N
- Transfer rate is up to 400Mbps

Audio

- Chip integrated by Realtek® ALC888S/ ALC889
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec

IDE

- 1 IDE port by AMD® SB710
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode

SATA

- 5 SATAII ports by AMD® SB710
- Supports storage and data transfers at up to 3 Gb/s

E-SATA

- 1 E-SATA port by AMD® SB710
- Supports storage and data transfers at up to 3 Gb/s

RAID

- SATA 1~5 support RAID 0/ 1/ 10 or JBOD mode by AMD® SB710

Floppy

- 1 floppy port
- Supports 1 FDD with 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB and 2.88 MB

Connectors

- Back panel
  - 1 PS/2 port
  - 1 Optical S/PDIF-Out port
  - 1 VGA port
  - 1 DVI-D port
  - 1 HDMI port
  - 1 IEEE1394 port (optional)
  - 6 USB 2.0 ports
  - 1 eSATA port
  - 1 LAN jack
  - 6 flexible audio jacks
- On-Board Connectors
  - 3 USB 2.0 connectors
  - 1 IEEE1394 connector (optional)
  - 1 SPDIF out connector
  - 1 CD-In connector
  - 1 Front Panel Audio connector
  - 1 Chassis Intrusion Switch connector
  - 1 Serial connector
  - 1 TPM connector
  - 1 OC switch
  - 1 Power LED Button
  - 1 Reset LED Button
  - 1 Clear CMOS Button

Slots

- 1 PCI Express x16 slot
- 3 PCI Express x1 slots
- 2 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface

Form Factor

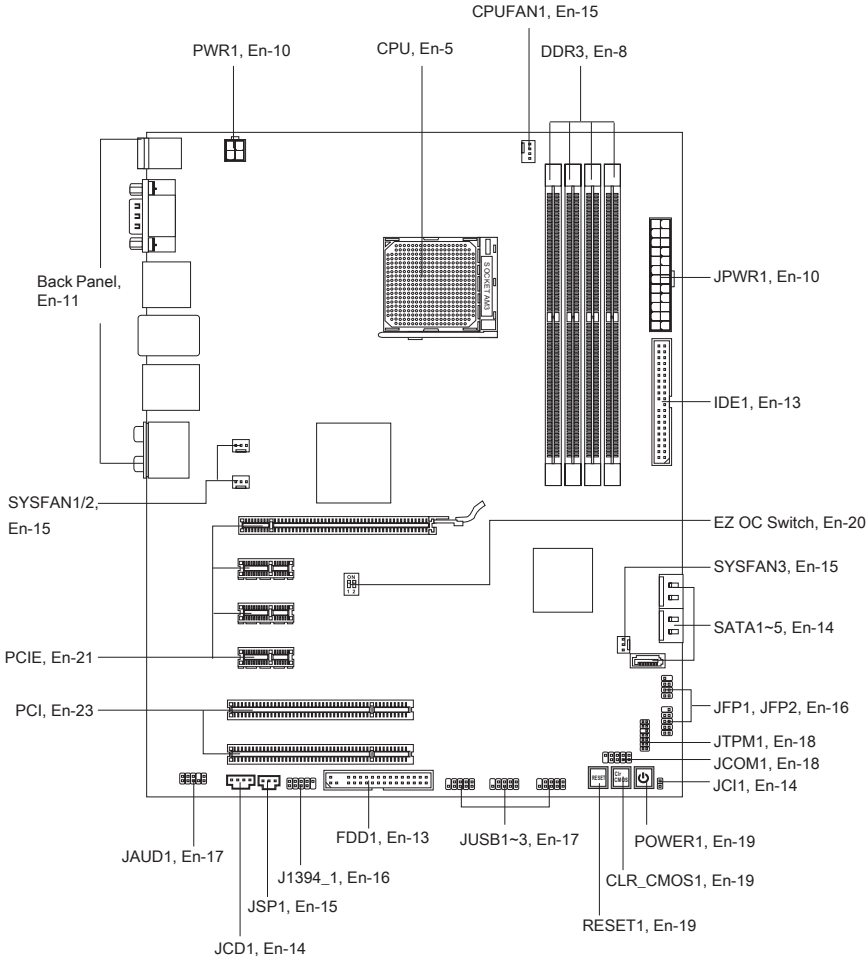
- ATX (30.5cm X 24.4 cm)

Mounting

- 9 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php

Quick Components Guide



CPU (Central Processing Unit)

When you are installing the CPU, make sure to install the cooler to prevent overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning on the computer. For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

Important

Overheating

Overheating will seriously damage the CPU and system. Always make sure the cooling fan can work properly to protect the CPU from overheating. Make sure that you apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.

Replacing the CPU

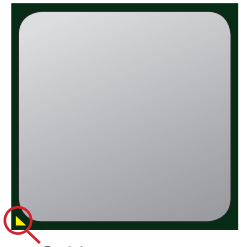
While replacing the CPU, always turn off the ATX power supply or unplug the power supply's power cord from the grounded outlet first to ensure the safety of CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. However, please make sure your components are able to tolerate such abnormal setting, while doing overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommended. We do not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation or beyond product specifications.

Introduction to AM3 CPU

The surface of CPU. Remember to apply some thermal paste on it for better heat dispersion.



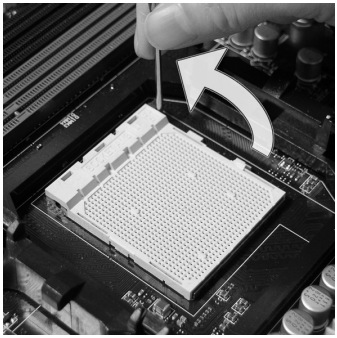
Gold arrow

CPU & Cooler Installation

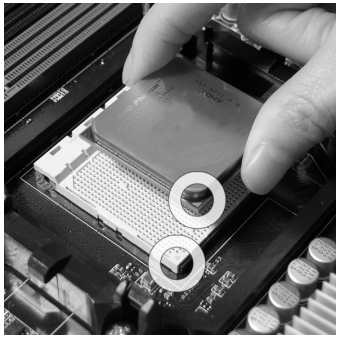
When you are installing the CPU, **make sure the CPU has a cooler attached on the top to prevent overheating**. Meanwhile, do not forget to apply some thermal paste on CPU before installing the heat sink/cooler fan for better heat dispersion.

Follow the steps below to install the CPU & cooler correctly. Wrong installation will cause the damage of your CPU & mainboard

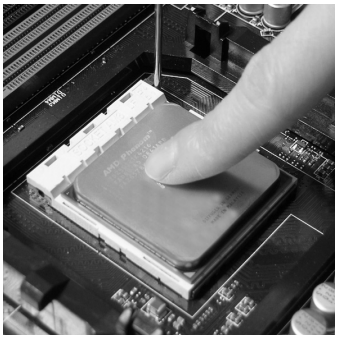
1. Pull the lever sideways away from the socket. Make sure to raise the lever up to a 90-degree angle.



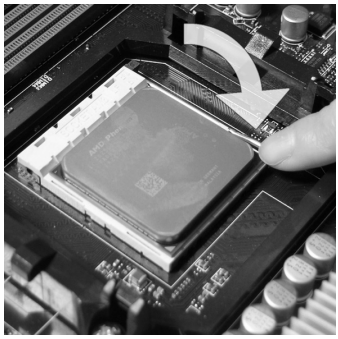
2. Look for the gold arrow of the CPU. The gold arrow should point as shown in the picture. The CPU can only fit in the correct orientation.



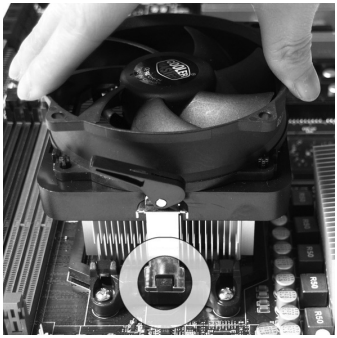
3. If the CPU is correctly installed, the pins should be completely embedded into the socket and can not be seen. Please note that any violation of the correct installation procedures may cause permanent damages to your mainboard.



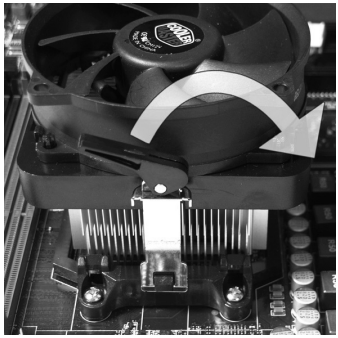
4. Press the CPU down firmly into the socket and close the lever. As the CPU is likely to move while the lever is being closed, always close the lever with your fingers pressing tightly on top of the CPU to make sure the CPU is properly and completely embedded into the socket.



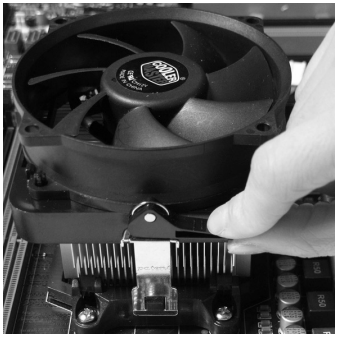
5. Position the cooling set onto the retention mechanism.
   Hook one end of the clip to hook first.



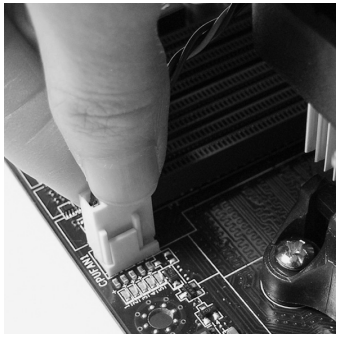
6. Then press down the other end of the clip to fasten the cooling set on the top of the retention mechanism.
   Locate the Fix Lever and lift up it.



7. Fasten down the lever.



8. Attach the CPU Fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.

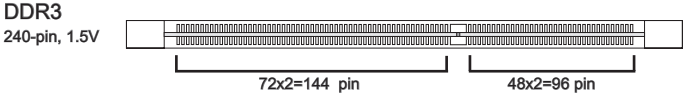


Important

- *Mainboard photos shown in this section are for demonstration only. The appearance of your mainboard may vary depending on the model you purchase.*
- *While disconnecting the Safety Hook from the fixed bolt, it is necessary to keep an eye on your fingers, because once the Safety Hook is disconnected from the fixed bolt, the fixed lever will spring back instantly.*

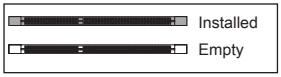
MEMORY

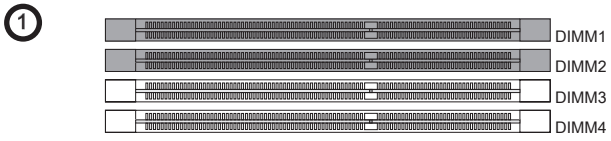
These DIMM slots are used for installing memory modules.
For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/index.php?func=testreport

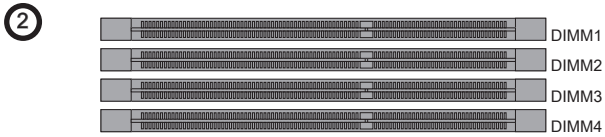


Dual-Channel mode Population Rule

In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus lines simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance the system performance. The following illustrations explain the population rules for Dual-Channel mode.







Important

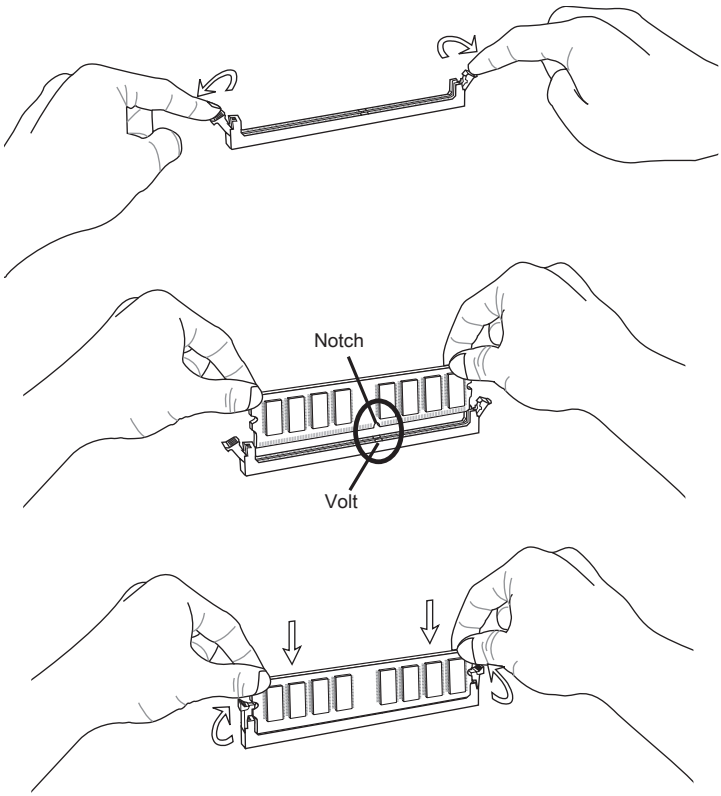
- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2 and the DDR3 standard is not backwards compatible. You should always install DDR3 memory modules in the DDR3 DIMM slots.*
- *In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the **same type and density** in different channel DIMM slots.*
- *To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into the **DIMM1** first.*
- *Due to the chipset resource deployment, the system density will only be detected up to 15+GB (not full 16GB) when each DIMM is installed with a 4GB memory module.*

Installing Memory Modules

1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the right orientation.
2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seated.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot clips at the sides.

Important

You can barely see the golden finger if the memory module is properly inserted in the DIMM slot.

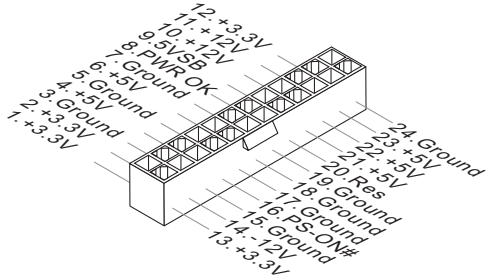


Power Supply

ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

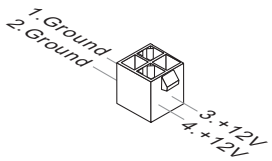
This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply firmly into the connector.

You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you'd like to use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply along with pin 1 & pin 13.



ATX 4-pin Power Connector: PWR1

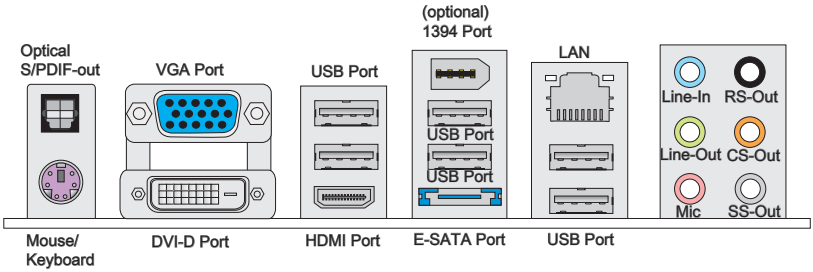
This connector is used to provide power to the CPU.



Important

- *Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to ensure stable operation of the mainboard.*
- *Power supply of 350 watts (and above) is highly recommended for system stability.*

Back Panel



▸ **Mouse/Keyboard**

The standard PS/2® mouse/keyboard DIN connector is for a PS/2® mouse/keyboard.

▸ **USB Port**

The USB (Universal Serial Bus) port is for attaching USB devices such as keyboard, mouse, or other USB-compatible devices.

▸ **VGA Port**

The DB15-pin female connector is provided for monitor.

▸ **DVI-D Port**

The DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) connector allows you to connect a LCD monitor. It provides a high-speed digital interconnection between the computer and its display device. To connect an LCD monitor, simply plug your monitor cable into the DVI-D connector, and make sure that the other end of the cable is properly connected to your monitor (refer to your monitor manual for more information.)

▸ **Optical S/PDIF-Out**

This SPDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

▸ **HDMI Port**

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio/video interface capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all TV format, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

▸ **1394 Port (optional)**

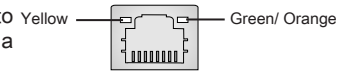
The IEEE1394 port on the back panel provides connection to IEEE1394 devices.

▸ **E-SATA Port**

The E-SATA (External-SATA) port is for attaching the E-SATA hard drive.

▸LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connection to the Local Area Network (LAN). You can connect a network cable to it.



LED	Color	LED State	Condition
Left	Yellow	Off	LAN link is not established.
		On(Steady state)	LAN link is established.
		On(brighter & pulsing)	The computer is communicating with another computer on the LAN.
Right	Green	Off	10 Mbits/sec data rate is selected.
		On	100 Mbits/sec data rate is selected.
	Orange	On	1000 Mbits/sec data rate is selected.

▸Audio Ports

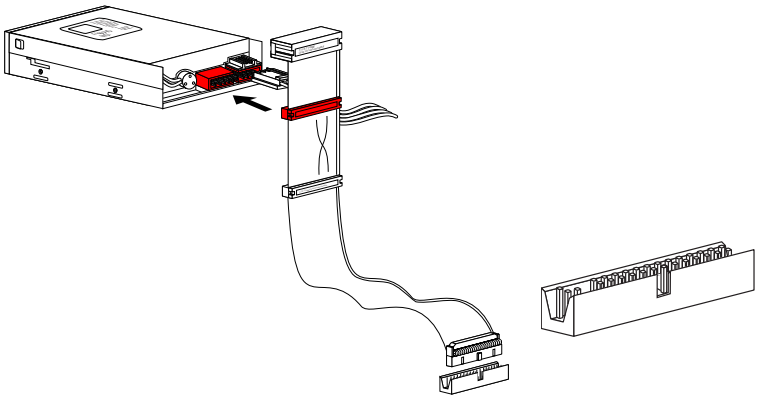
These audio connectors are used for audio devices. It is easy to differentiate between audio effects according to the color of audio jacks.

- Line-In (Blue) - Line In, is used for external CD player, tape-player or other audio devices.
- Line-Out (Green) - Line Out, is a connector for speakers or headphones.
- Mic (Pink) - Mic, is a connector for microphones.
- RS-Out (Black) - Rear-Surround Out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
- CS-Out (Orange) - Center/ Subwoofer Out in 5.1/ 7.1 channel mode.
- SS-Out (Gray) - Side-Surround Out 7.1 channel mode.

Connectors

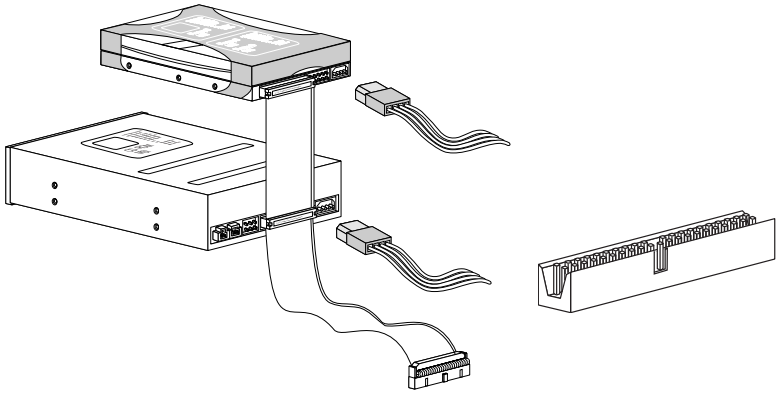
Floppy Disk Drive Connector: FDD1

This connector supports 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB or 2.88MB floppy disk drive.



IDE Connector: IDE1

This connector supports IDE hard disk drives, optical disk drives and other IDE devices.

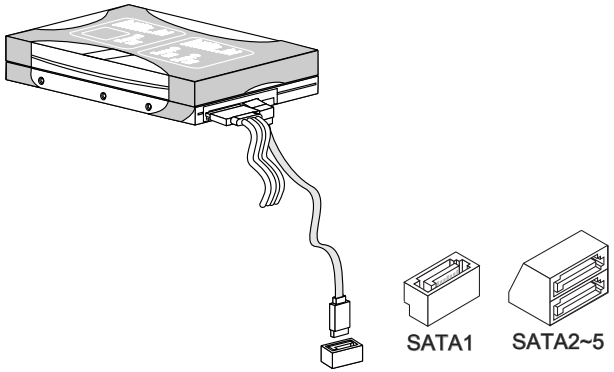


Important

If you install two IDE devices on the same cable, you must configure the drives separately to master / slave mode by setting jumpers. Refer to IDE device's documentation supplied by the vendors for jumper setting instructions.

Serial ATA Connector: SATA1~5

This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can connect to one Serial ATA device.

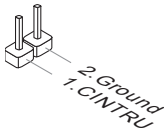


Important

Please do not fold the Serial ATA cable into 90-degree angle. Otherwise, data loss may occur during transmission.

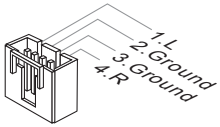
Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.



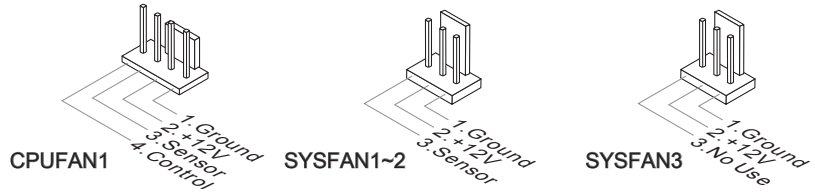
CD-In Connector: JCD1

This connector is provided for external audio input.



Fan Power Connectors: CPUFAN1, SYSFAN1~3

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connecting the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be connected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage of the CPU fan control.

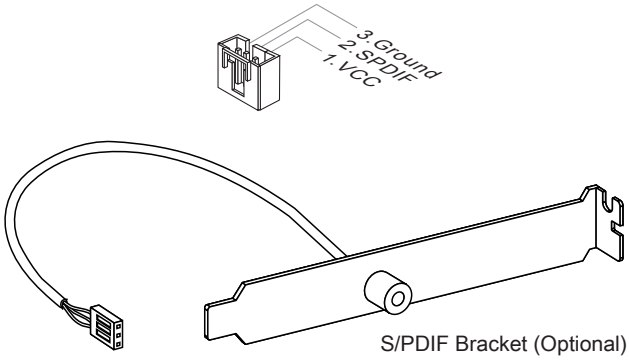


Important

- *Please refer to the recommended CPU fans at processor's official website or consult the vendors for proper CPU cooling fan.*
- *CPUFAN1 supports fan control. You can install* ***Overclocking Center*** *utility that will automatically control the CPU fan speed according to the actual CPU temperature.*
- *Fan cooler set with 3 or 4 pins power connector are both available for CPUFAN1.*

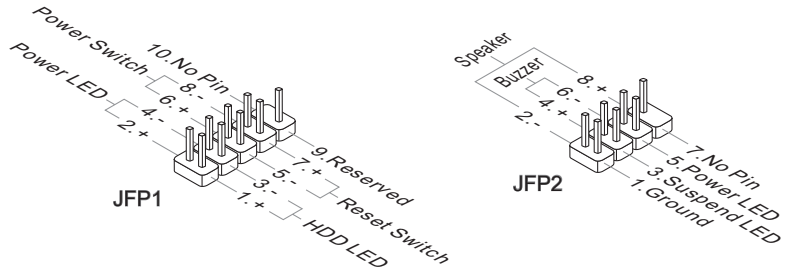
S/PDIF-Out Connector: JSP1

This connector is used to connect S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) interface for digital audio transmission.



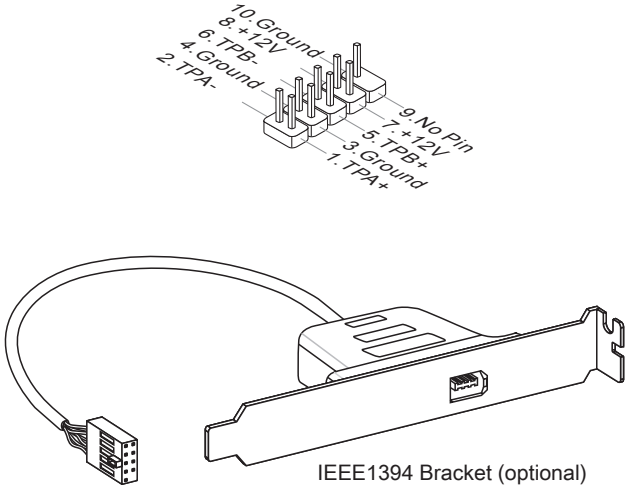
Front Panel Connector: JFP1, JFP2

This connector is for electrical connection to the front panel switches and LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



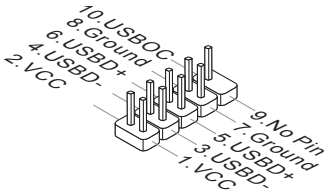
IEEE1394 Connector: J1394_1 (Optional)

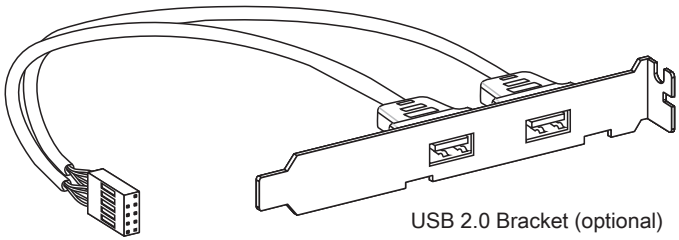
This connector allows you to connect the IEEE1394 device via an optional IEEE1394 bracket.



Front USB Connector: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cameras, MP3 players, printers, modems and the like.





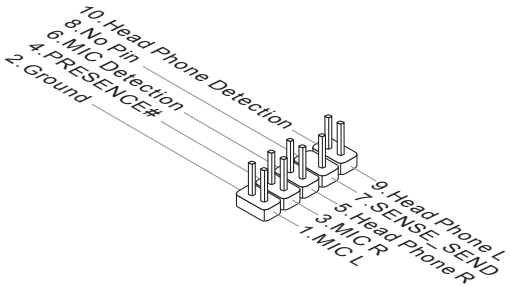
USB 2.0 Bracket (optional)

Important

Note that the pins of VCC and GND must be connected correctly to avoid possible damage.

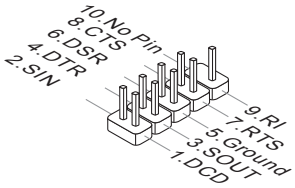
Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



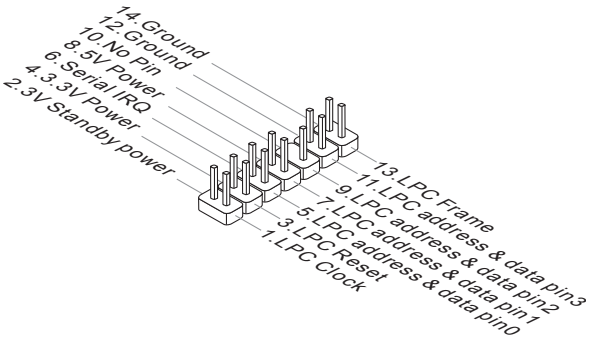
Serial Port Connector: JCOM1

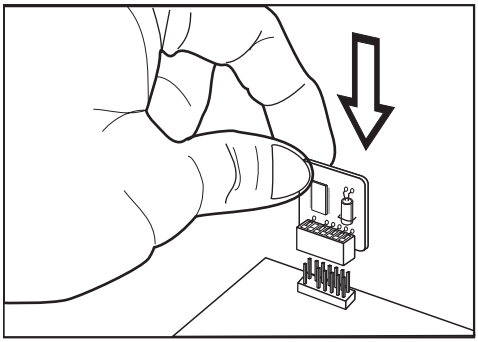
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/ receives 16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.



TPM Module connector: JTPM1

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module (optional). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.



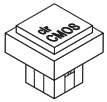


Button

The motherboard provides the following button for you to set the computer's function. This section will explain how to change your motherboard's function through the use of button.

Clear CMOS Button: CLR_CMOS1

There is a CMOS RAM on board that has a power supply from external battery to keep the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, use the button to clear data. Press the button to clear the data.



Important

Make sure that you power off the system before clearing CMOS data.

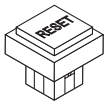
Power Button: POWER1

This power button is used to turn-on or turn-off the system. Press the button to turn-on or turn-off the system. This button will light after you power-on the system, and the light will turn-off when you power-off the system.



Reset Button: RESET1

This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system. This button will light when the system is in S0 status.



SWITCH

Overclock FSB Switch: EZ OC Switch

You can overclock the FSB to increase the processor frequency by changing the switch. Follow the instructions below to set the FSB.



Default



Increase 10% speed of FSB



Increase 15% speed of FSB



Increase 20% speed of FSB

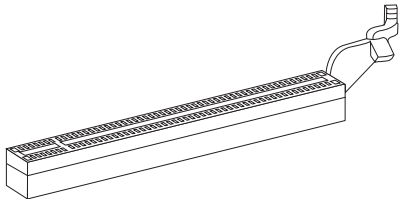
Important

- *Make sure that you power off the system before setting the switch.*
- *When overclocking cause system instability or crash during boot, please set the switch to default setting.*

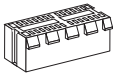
Slots

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express Slot

The PCI Express slot supports the PCI Express interface expansion card.



PCI Express x16 Slot



PCI Express x1 Slot

Hybrid CrossFireX™ Technology

Hybrid CrossFireX™ technology brings multi-GPU performance capabilities by enabling an AMD® 785G integrated graphics processor and a discrete graphics processor to operate simultaneously with combined output to a single display for blisteringly-fast frame rates. Unleash the graphics performance.

System Request

1. Hybrid CrossFireX™ is only supported with the Vista operating system.
2. Graphic card based on an ATI Radeon™ HD 2400 Series, ATI Radeon™ HD 3400 Series or ATI Mobility Radeon™ HD 3400 Series graphics processor.
3. Mainboard based on an AMD® 785G integrated chipset.

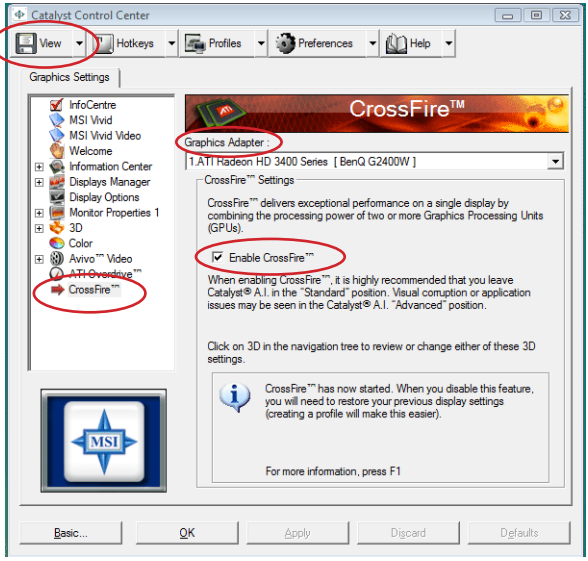
Enabling Hybrid CrossFireX™ Technology

Power off the system and install the ATI graphic card that supports Hybrid CrossFireX™ technology. After then, power on the system and install the driver that Hybrid CrossFireX™ technology. Restart the system and wait for the ATI Icon to show in the System Tray. Click the icon and then the following aspect appears in Catalyst Control Center:



Click this icon.

1. Select the Advanced View from the view drop menu.



2. From the “Graphics Settings” tree in the Catalyst Control Center, click CrossFire™.
3. From the “Graphics Adapter” list, select the graphics card that acts as the Display GPU.
4. Select “Enable CrossFire™”.
5. Click Apply.

When Hybrid CrossFireX™ is enabled, GPU Accelerated Physics is automatically disabled for all cards in the configuration as are all displays except the one used by Hybrid CrossFireX™.

More details please refer to http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx

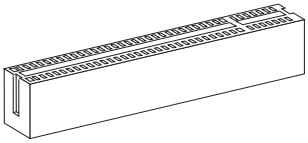
Important

Changing integrated graphic memory operating mode may cause Hybrid CrossFireX™ fail. To avoid the issue, please follow the steps below to setup the system:

- *Disable the Hybrid CrossFireX™ in Catalyst Control Center.*
- *Reboot into BIOS.*
- *Select the option in Advanced BIOS Features -> Chipset Feature -> On-Chip VGA.*
- *Save BIOS settings and reboot.*
- *Enable the Hybrid CrossFireX™ in Catalyst Control Center.*

PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot

The PCI slot supports LAN card, SCSI card, USB card, and other add-on cards that comply with PCI specifications.



32-bit PCI Slot

Important

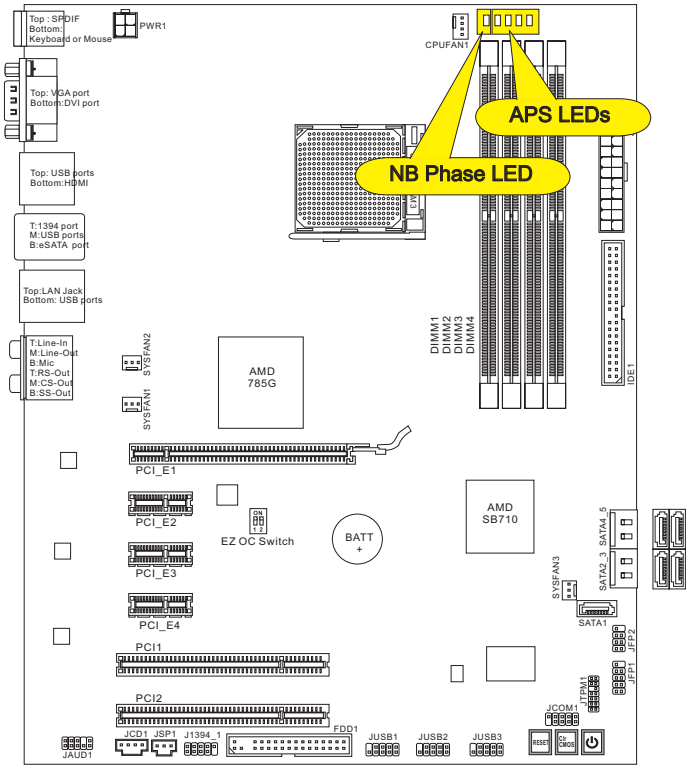
When adding or removing expansion cards, make sure that you unplug the power supply first. Meanwhile, read the documentation for the expansion card to configure any necessary hardware or software settings for the expansion card, such as jumpers, switches or BIOS configuration.

PCI Interrupt Request Routing

The IRQ, acronym of interrupt request line and pronounced I-R-Q, are hardware lines over which devices can send interrupt signals to the microprocessor. The PCI IRQ pins are typically connected to the PCI bus pins as follows:

	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI Slot2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

LED Status Indicators



APS LEDs

These APS (Active Phase Switching) LEDs indicate the current CPU power phase mode. Follow the instructions

below to read.

■ : ON, □ : OFF

■■■■ 4 of the LEDs will light blue when CPU is in 4 phase power mode.
■■■□ 3 of the LEDs will light blue when CPU is in 3 phase power mode.
■■□□ 2 of the LEDs will light blue when CPU is in 2 phase power mode.
■□□□ 1 of the LEDs will light blue when CPU is in 1 phase power mode.

NB Phase LED

Lights blue when the NB is operating.

BIOS Setup

This chapter provides basic information on the BIOS Setup program and allows you to configure the system for optimum use. You may need to run the Setup program when:

- An error message appears on the screen during the system booting up, and requests you to run BIOS SETUP.
- You want to change the default settings for customized features.

Important

- *The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.*
- *Upon boot-up, the 1st line appearing after the memory count is the BIOS version. It is usually in the format:*

A7576AMS V1.0 072409 where:

1st digit refers to BIOS maker as A = AMI, W = AWARD, and P = PHOENIX.

2nd - 5th digit refers to the model number.

6th digit refers to the chipset as I = Intel, N = NVIDIA, A = AMD and V = VIA.

7th - 8th digit refers to the customer as MS = all standard customers.

V1.0 refers to the BIOS version.

072409 refers to the date this BIOS was released.

Entering Setup

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL to enter SETUP

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Getting Help

After entering the Setup menu, the first menu you will see is the Main Menu.

Main Menu

The main menu lists the setup functions you can make changes to. You can use the arrow keys (↑↓) to select the item. The on-line description of the highlighted setup function is displayed at the bottom of the screen.

Sub-Menu

If you find a right pointer symbol appears to the left of certain fields that means a sub-menu can be launched from this field. A sub-menu contains additional options for a field parameter. You can use arrow keys (↑↓) to highlight the field and press <Enter> to call up the sub-menu. Then you can use the control keys to enter values and move from field to field within a sub-menu. If you want to return to the main menu, just press the <Esc >.

General Help <F1>

The BIOS setup program provides a General Help screen. You can call up this screen from any menu by simply pressing <F1>. The Help screen lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted item. Press <Esc> to exit the Help screen.

The Main Menu

Once you enter BIOS CMOS Setup Utility, the Main Menu will appear on the screen. The Main Menu allows you to select from the setup functions and two exit choices. Use arrow keys to select among the items and press <Enter> to accept or enter the sub-menu.



▸ **Standard CMOS Features**

Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

▸ **Advanced BIOS Features**

Use this menu to setup the items of the BIOS special enhanced features.

▸ **Integrated Peripherals**

Use this menu to specify your settings for integrated peripherals.

▸ **Power Management Setup**

Use this menu to specify your settings for power management.

▸ **H/W Monitor**

This entry shows your PC health status.

▸ **Green Power**

Use this menu to specify the power phase.

▸ **BIOS Setting Password**

Use this menu to set the password for BIOS.

▸ **Cell Menu**

Use this menu to specify your settings for frequency/voltage control and overclocking.

▸ **User Settings**

Use this menu to save/ load your settings to/ from CMOS for BIOS.

▸ **M-Flash**

Use this menu to read/ flash the BIOS from storage drive (FAT/ FAT32 format only).

▸Load Fail-Safe Defaults

Use this menu to load the default values set by the BIOS vendor for stable system performance.

▸Load Optimized Defaults

Use this menu to load the default values set by the mainboard manufacturer specifically for optimal performance of the mainboard.

▸Save & Exit Setup

Save changes to CMOS and exit setup.

▸Exit Without Saving

Abandon all changes and exit setup.

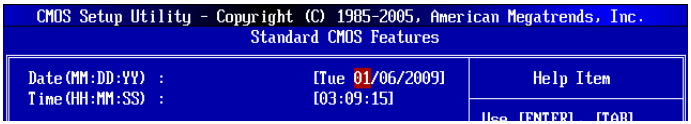
When entering the BIOS Setup utility, follow the processes below for general use.

1. Load Optimized Defaults : Use control keys (↑ ↓) to highlight the Load Optimized Defaults field and press <Enter> , a message as below appears:

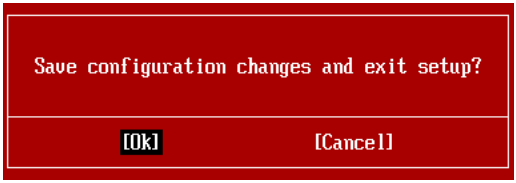


Select [Ok] and press Enter to load the default settings for optimal system performance.

2. Setup Date/ Time : Select the Standard CMOS Features and press <Enter> to enter the Standard CMOS Features-menu. Adjust the Date, Time fields.



3. Save & Exit Setup : Use control keys (↑ ↓) to highlight the Save & Exit Setup field and press <Enter> , a message as below appears:



Select [Ok] and press Enter to save the configurations and exit BIOS Setup utility.

Important

The configuration above are for general use only. If you need the detailed settings of BIOS, please see the complete version of English manual on MSI website.

4. Cell Menu Introduction : This menu is for advanced user who want to overclock the mainboard.



Important

Change these settings only if you are familiar with the chipset.

▸Current CPU / DRAM Frequency

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

▸CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This submenu shows the information of installed CPU.

▸AMD Cool'n'Quiet

The Cool'n'Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed and power consumption.

Important

To ensure that Cool'n'Quiet function is activated and will be working properly, it is required to double confirm that:

- *Run BIOS Setup, and select Cell Menu. Under* ***Cell Menu****, find* ***AMD Cool'n'Quiet****, and set this item to "Enabled".*
- *Enter Windows, and select [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options]. Enter* ***Power Options Properties*** *tag, and select* ***Minimal Power Management*** *under* ***Power schemes****.*

▸CPU Technology Support

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu shows the technologies that the installed CPU supported.

▸Adjust CPU FSB Frequency (MHz)

This item allows you to select the CPU Front Side Bus clock frequency (in MHz).

▸Adjust CPU Ratio

This item is used to adjust CPU clock multiplier (ratio). It is available only when the processor supports this function.

▸Adjusted CPU Frequency (MHz)

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

▸Adjust CPU-NB Ratio

This item is used to adjust CPU-NB ratio.

▸Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)

It shows the adjusted CPU-NB frequency. Read-only.

▸EC Firmware

This item allows you to select the EC Firmware for Advanced Clock Calibration. For unlocking the additional cores, you could set it [Special] and then set Advanced Clock Calibration [Auto] in order to be able to activate the processor cores.

▸Advanced Clock Calibration

This item is for overclock. Setting to [Enabled] allows you to set the CPU Ratio higher. It is available only when the processor supports this function.

▸Auto OverClock Technology

Setting this item to [Max FSB] allows the system to detect the maximum FSB clock and to overclock automatically. If overclocking fails to run, you can try the lower FSB clock for overclocking successfully.

▸MultiStep OC Booster

This item is used to avoid the BIOS might crash with overclocking.

Disabled	Disable this item, apply OC settings during POST.
Mode 1	Slight OC during POST and then apply full OC when loading the OS
Mode 2	Load the OS then apply the OC settings.

▸MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸DIMM1~4 Memory SPD Information

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of installed memory.

▸Advance DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸DRAM Timing Mode

This field has the capacity to automatically detect all of the DRAM timing. If you set this field to [DCT 0], [DCT 1] or [Both], some fields will appear and selectable. DCT 0 controls channel A and DCT1 controls channel B.

▸CAS Latency (CL)

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

▸tRCD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately. This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cycles, the faster the DRAM performance.

▸tRP

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate its charge before DRAM refresh may be incomplete and DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▸tRAS

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This setting determines the time RAS takes to read from and write to a memory cell.

▸tRTP

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This setting controls the time interval between a read and a precharge command.

▸tRC

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. The row cycle time determines the minimum number of clock cycles a memory row takes to complete a full cycle, from row activation up to the precharging of the active row.

▸tWR

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. It specifies the amount of delay (in clock cycles) that must elapse after the completion of a valid write operation, before an active bank can be precharged. This delay is required to guarantee that data in the write buffers can be written to the memory cells before precharge occurs.

▸ tRRD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. Specifies the active-to-active delay of different banks.

▸ tWTR

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This item controls the Write Data In to Read Command Delay memory timing. This constitutes the minimum number of clock cycles that must occur between the last valid write operation and the next read command to the same internal bank of the DDR device.

▸ tRFC0~3

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. These settings determine the time RFC take to read from and write to memory cells.

▸ tWRTTO

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. Timing of Read to Write turnaround for data; the minimum cycle time between command last clock of CAS read operation to next command write operation. If you set this item smaller, system will run faster but might be more unstable. Please set it depends on memory module.

▸ tWRRD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. Timing of Write to Read; the minimum cycle time from last clock of first virtual CAS write-burst operation to a following one read-burst operation for different chip or DIMM.If you set this item smaller, system will run faster but might be more unstable.Please set it depends on memory module.

▸ tWRWR

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. Timing of Write to Write; the minimum cycle time from last clock of first virtual CAS write-burst operation to a following write-burst peration that changed the enabled terminator.If you set this item smaller, system will run faster but might be more unstable. Please set it depends on memory module.

▸ tRDRD

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], these fields are adjustable. Timing of Read to Read; the minimum cycle time from last clock of a first virtual CAS read-burst operation to a following one read-burst operation for different chip or DIMM. If you set this itemsmaller, system will run faster but might be more unstable.Please set it depends on memory module.

▸ DRAM Drive Strength

This feature allows you to control the memory data bus' signal strength. Increasing the drive strength of the memory bus can increase stability during overclocking.

▸ DRAM Advance Control

This field has the capacity to automatically detect the advanced DRAM timing. If you set this field to [DCT 0], [DCT 1] or [Both], some fields will appear and selectable.

▸ 1T/2T Memory Timing

When the DRAM Timing Mode sets to [DCT 0], [DCT1] or [Both], the field is adjustable. This field controls the SDRAM command rate. Selecting [1T] makes SDRAM signal controller to run at 1T (T=clock cycles) rate. Selecting [2T] makes SDRAM signal controller run at 2T rate.

▸ DCT Unganged Mode

This feature is used to Integrate two 64-bit DCTs into a 128-bit interface.

▸ Bank Interleaving

Bank Interleaving is an important parameter for improving overclocking capability of memory. It allows system to access multiple banks simultaneously.

▸ Power Down Enable

This is a memory power-saving technology. When the system does not access memory over a period of time, it will automatically reduce the memory power supply.

▸ MemClk Tristate C3/ATLVID

This setting allows you to enable/disable the MemClk Tristating during C3 and ATLVID.

▸ FSB/DRAM Ratio

This item allows you to select the ratio of FSB/ DRAM.

▸ Adjusted DRAM Frequency (MHz)

It shows the adjusted Memory frequency. Read-only.

▸ Onboard VGA Over Clock

This item allows you to overclock the onboard VGA.

▸ Onboard VGA Clock

This item will appear when Onboard VGA Over Clock sets to [Enabled]. It allows you to adjust the onboard VGA clock.

▸ HT Link Control

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ HT Incoming/ Outgoing Link Width

These items allow you to set the Hyper-Transport Link width. Setting to [Auto], the system will detect the HT link width automatically.

▸ HT Link Speed

This item allows you to set the Hyper-Transport Link speed. Setting to [Auto], the system will detect the HT link speed automatically.

▸ Adjusted HT Link Frequency (MHz)

It shows the adjusted HT Link frequency. Read-only.

▸ Adjust PCI-E Frequency (MHz)

This field allows you to select the PCIE frequency (in MHz).

▸ Auto Disable DRAM/PCI Frequency

When set to [Enabled], the system will remove (turn off) clocks from empty DRAM/ PCI slots to minimize the electromagnetic interference (EMI).

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

▸Spread Spectrum

When the mainboard's clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the pulses are reduced to flatter curves. If you do not have any EMI problem, leave the setting at Disabled for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, set to Enabled for EMI reduction. Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.

Important

- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.*

Important

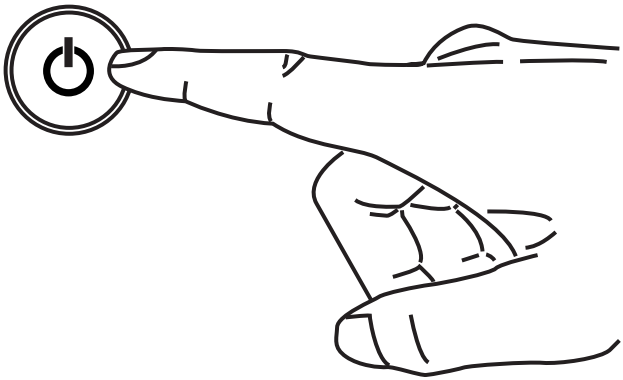
Failed Overclocking Resolution

This motherboard supports overclocking greatly. However, please make sure your peripherals and components are bearable for some special settings. Any operation that exceeds product specification is not recommended. Any risk or damge resulting from improper operation will not be under our product warranty.

Two ways to save your system from failed overclocking...

- *Reboot*

  Press the Power button to reboot the system three times. Please note that, to avoid electric current to affect other devices or components, we suggest an interval of more than 10 seconds among the reboot actions.



At the fourth reboot, BIOS will determine that the previous overclocking is failed and restore the default settings automatically. Please press any key to boot the system normally when the following message appears on screen.

```
Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....
```

- *Clear CMOS*

  Please refer to "how to clear CMOS data" section for more information about how to clear CMOS data.

Software Information

Take out the Driver/Utility DVD that is included in the mainboard package, and place it into the DVD-ROM drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility DVD contains the:

- Driver menu : The Driver menu shows the available drivers. Install the driver by your desire and to activate the device.
- Utility menu : The Utility menu shows the software applications that the mainboard supports.
- WebSite menu : The WebSite menu shows the necessary websites.

Important

Please visit the MSI website to get the latest drivers and BIOS for better system performance.

785G-E65 시리즈

한국어

Asia version

메인보드 사양

지원되는 프로세서

- AM3 패키지의 AMD® Phenom™ II X4/ X3 및 Athlon X4/ X3/ X2 프로세서.
  (CPU에 대한 최신 정보는
  http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2참조)

HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0, 최대 5.2 GT/s 지원

칩셋

- 노스 브릿지: AMD® 785G 칩셋
- 사우스 브릿지: AMD® SB710 칩셋

지원되는 메모리

- DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*=OC) SDRAM (합계 최대 16GB)
- DDR3 DIMM 4개(240핀 / 1.5V)
  (호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은
  http://www.msi.com/index.php?func=testreport를 참조하십시오.)

LAN

- Realtek® RTL8111DL에 의해 PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet 지원

IEEE 1394 (옵션)

- VIA® VT6315N에 의해 통합된 칩
- 400Mbps의 최대 전송 속도

오디오

- Realtek® ALC888S/ ALC889에 의해 통합된 칩
- 잭 감지 기능이 있는 플렉시블 8 채널 오디오
- Azalia 1.0 Spec 규격 준수

IDE

- AMD® SB710에 의한 IDE 포트 1개
- Ultra DMA 66/100/133 모드 지원
- PIO, 버스 마스터 작동 모드 지원

SATA

- AMD® SB710에 의한 SATAII 포트 5개
- 최대 3 Gb/s의 저장 및 데이터 전송 지원

E-SATA

- AMD® SB710에 의한 E-SATA 포트 1개
- 최대 3 Gb/s의 저장 및 데이터 전송 지원

RAID

- AMD® SB710에 의해 RAID 0/ 1/ 10 또는 JBOD 모드 지원되는 SATA 1~5

플로피

- 플로피 포트 1개
- 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB 및 2.88 MB의 FDD 1개 지원

커넥터

■ 후면 패널
- PS/2 포트 1개
- 광학 S/PDIF 출력 포트 1개
- VGA 포트 1개
- DVI-D 포트 1개
- HDMI 포트 1개
- IEEE1394 포트 1개 (옵션)
- USB 2.0 포트 6개
- eSATA 포트 1개
- LAN 잭 1개
- 플렉시블 오디오 잭 6개

■ 온보드 커넥터
- USB 2.0 커넥터 3개
- IEEE1394 커넥터 1개 (옵션I)
- SPDIF 출력 커넥터 1개
- CD 입력 커넥터 1개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1개
- 섀시 침입 스위치 커넥터 1개
- 시리얼 커넥터 1개
- TPM 커넥터 1개
- OC 스위치 1개
- 전원 LED 버튼 1개
- 리셋 LED 버튼 1개
- CMOS 클리어 버튼 1개

슬롯

■ PCI Express x16 슬롯 1개
■ PCI Express x1 슬롯 3개
■ PCI 슬롯 2개, 3.3V/ 5V PCI 버스 인터페이스 지원

폼 팩터

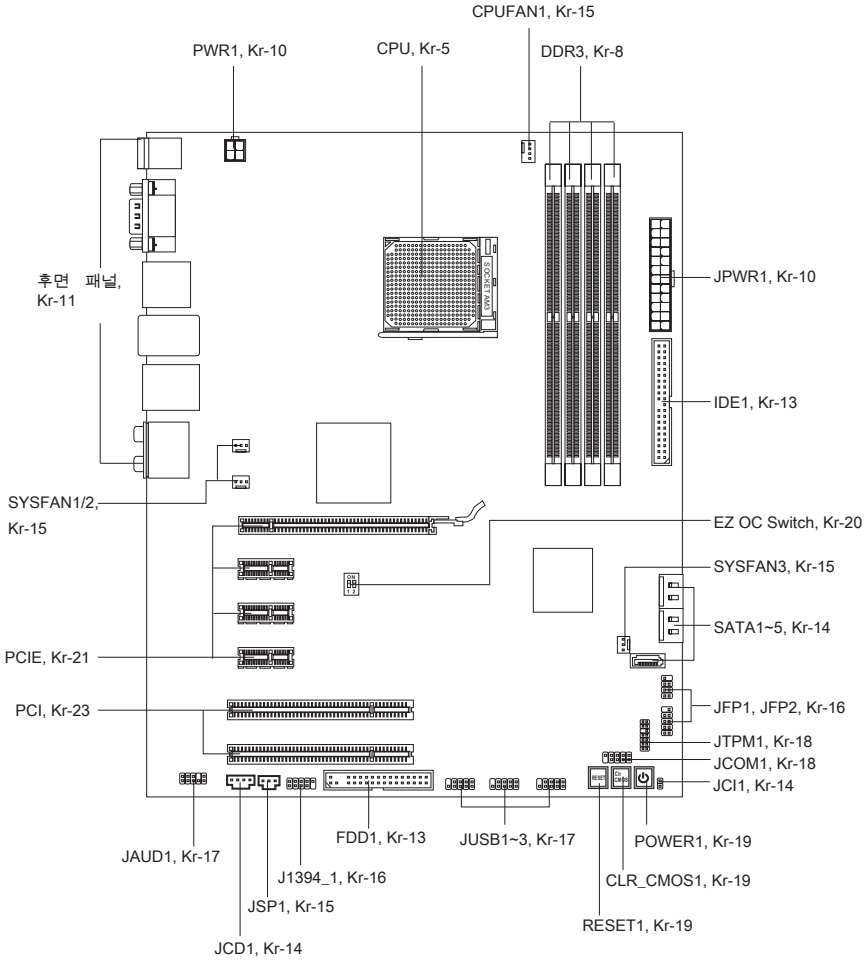
■ ATX (30.5cm X 24.4 cm)

장착

■ 장착 구멍 9개

액세서리 구매나 제품 번호 등의 다양한 정보는, 웹페이지
http://www.msi.com/index.php에서 확인할 수 있습니다.

빠른 부품 설명서


CPUFAN1, Kr-15
PWR1, Kr-10
CPU, Kr-5
DDR3, Kr-8
후면 패널, Kr-11
JPWR1, Kr-10
IDE1, Kr-13
SYSFAN1/2, Kr-15
EZ OC Switch, Kr-20
SYSFAN3, Kr-15
SATA1~5, Kr-14
PCIE, Kr-21
PCI, Kr-23
JFP1, JFP2, Kr-16
JTPM1, Kr-18
JCOM1, Kr-18
JCI1, Kr-14
JAUD1, Kr-17
FDD1, Kr-13
JUSB1~3, Kr-17
POWER1, Kr-19
J1394_1, Kr-16
CLR_CMOS1, Kr-19
JSP1, Kr-15
RESET1, Kr-19
JCD1, Kr-14

CPU (중앙 처리 장치)

CPU 설치 시 과열을 방지하는 쿨러를 반드시 설치하십시오. CPU 쿨러가 없는 경우, 컴퓨터를 켜기 전에 판매점에 문의하십시오.
CPU에 대한 최신 정보는 http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2참조

중요 사항

과열

과열은 CPU와 시스템을 심각하게 손상시킬 수 있습니다. CPU가 과열되지 않도록 냉각 팬이 제대로 작동하는지 항상 확인하십시오. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판 사이에 서멀 페이스트(또는 서멀 테이프)를 고르게 바르십시오.

CPU 교체

CPU 교체 시, 항상 전원을 끄거나 먼저 ATX 전원 공급장치의 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑아 CPU의 안전을 확보하십시오.

오버클로킹

이 메인보드는 오버클로킹 기능을 지원하도록 디자인되었습니다. 그러나 오버클로킹이 진행되는 동안 부품이 이러한 비정상적인 설정을 견뎌낼 수 있는지 확인하십시오. 제품 사양을 초과하는 범위에서 작동시키지 마십시오. 당사는 올바르지 않은 작동이나 제품 사양을 초과한 범위에서 사용하여 발생한 손상 또는 위험은 보증하지 않습니다.

AM3 CPU 소개

CPU의 표면. 열이 잘 발산되도록 서멀 페이스트를 표면에 약간 바르십시오.

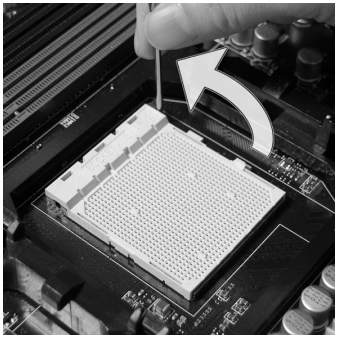


노란색 삼각형

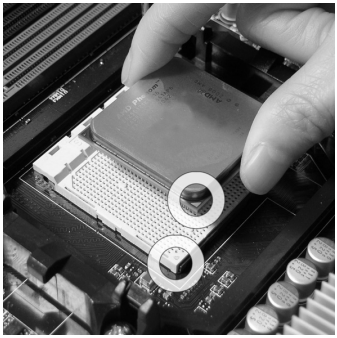
CPU 및 쿨러 설치

CPU 설치 시 **과열을 방지하는 쿨러를 상단에 연결하십시오**. 한편, 열이 잘 발산되도록 방열판/쿨러 팬을 설치하기 전에 CPU에 서멀 페이스트를 약간 바르십시오.
아래의 단계에 따라 CPU 및 쿨러를 올바로 설치하십시오. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상됩니다.

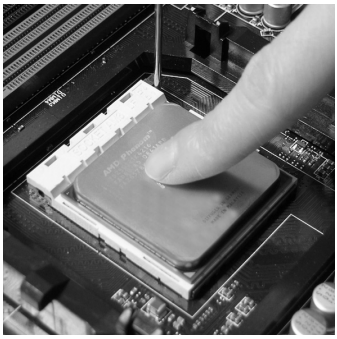
1. 레버를 소켓에서 비스듬히 당깁니다. 레버를 90도까지 올립니다.



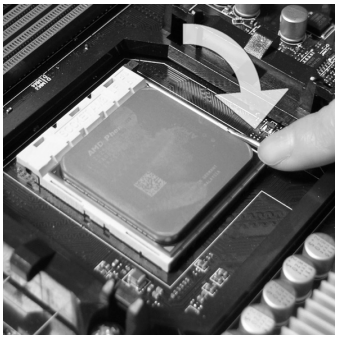
2. CPU의 금색 화살표를 찾습니다. 금색 화살표가 그림과 같이 가리키고 있어야 합니다. CPU는 올바른 한 쪽 방향으로만 끼워집니다.



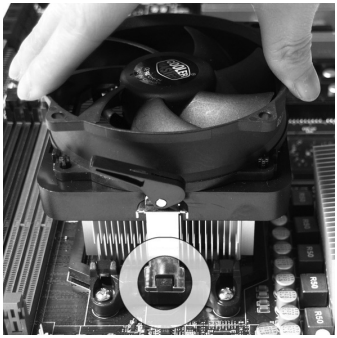
3. CPU가 올바로 설치되면, 핀이 소켓에 완전히 끼워져서 보이지 않게 됩니다. 올바른 설치 절차를 따르지 않으면 메인보드가 영구적으로 손상될 수 있습니다.



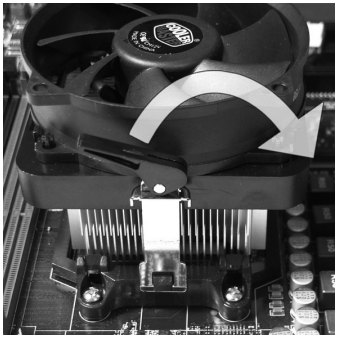
4. CPU를 소켓 안으로 꽉 눌러 넣고 레버를 닫습니다. 레버를 닫는 동안 CPU가 움직일 우려가 있기 때문에, 레버를 닫을 때는 항상 손가락으로 CPU의 상단을 꽉 눌러 CPU가 소켓 안에 제대로 완전히 끼워지도록 해야 합니다.



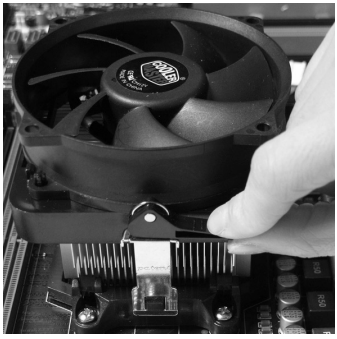
5. 쿨러 세트를 고정 위치에 올려놓습니다.
   먼저 클립의 한쪽 끝을 사용하여 겁니다.



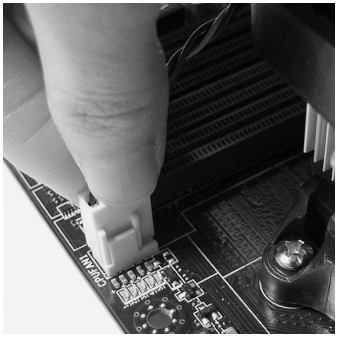
6. 그리고 나서 클립의 다른 쪽 끝을 눌러 쿨러 세트를 고정 위치의 상단에고정합니다.
   고정 레버를 찾아 위로 올립니다.



7. 레버를 아래로 눌러 고정합니다.



8. CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU팬 커넥터에 연결합니다.

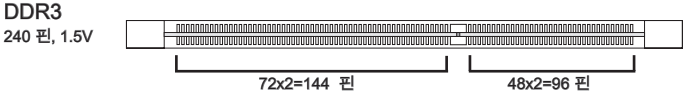


중요 사항

- *이 절에 표시된 메인보드 사진은 데먼스트레이션을 보여줄 목적으로만 사용된 사진입니다. 메인보드의 외양은 구입한 모델에 따라 다를 수있습니다.*
- *안전 혹이 고정 볼트에서 분리되는 즉시 고정 레버가 다시 튀어 오르기 때문에, 고정 볼트에서 안전 혹을 분리할 때는 손가락에서 눈을 떼지 마십시오.*

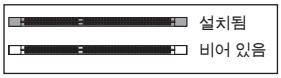
메모리

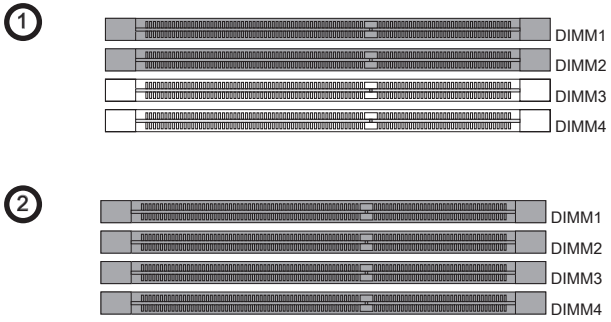
DIMM 슬롯은 메모리 모듈을 설치하는 데 사용됩니다.
호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은
http://www.msi.com/index.php?func=testreport를 참조하십시오.



듀얼 채널 모드 배포 규칙

듀얼 채널 모드에서는 메모리 모듈이 2개의 데이터 버스 회선을 동시에 사용하여 데이터를 전송 및 수신할 수 있습니다. 듀얼 채널 모드를 활성화하면 시스템 성능이 향상됩니다. 다음 그림에서 듀얼 채널 모드의 배포 규칙을 참조하십시오.





중요 사항

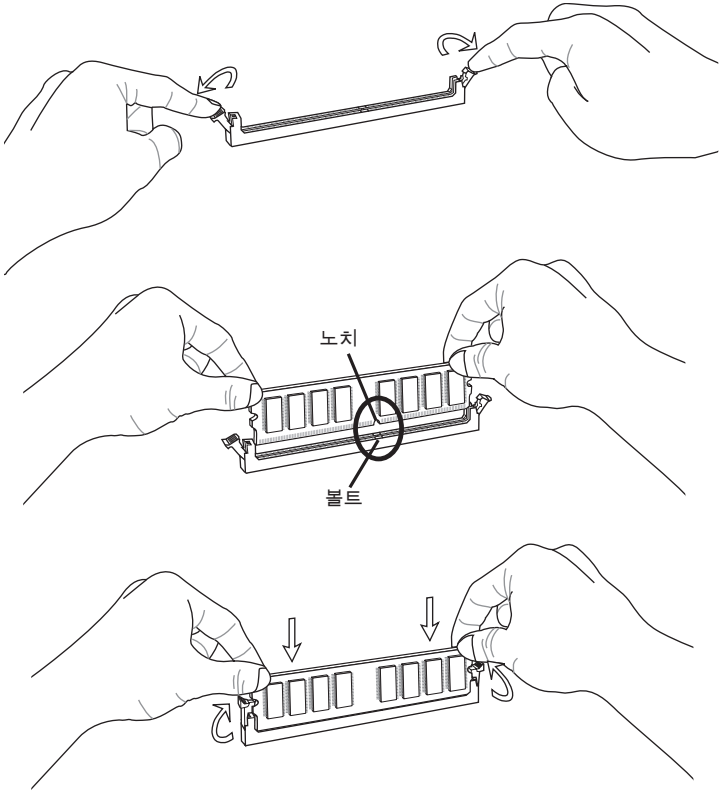
- *DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 교환되지 않으며, DDR3 표준은 역호환이 되지 않습니다. 항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다s.*
- *듀얼 채널 모드에서, 다른 채널 DIMM 슬롯에 **유형과 밀도가 동일한** 메모리 모듈을 설치했는지 확인하십시오.*
- *성공적인 시스템 부팅을 하려면, 메모리 모듈을 먼저 DIMM1에 끼우십시오.*
- *칩셋 리소스 배치 때문에, 각 DIMM이 4GB 모듈로 설치된 경우 시스템 밀도가(전체 16GB가 아닌) 최대 15+GB까지만 인식됩니다.*

메모리 모듈 설치

1. T메모리 모듈은 중앙에 노치가 하나만 있으며, 오른쪽 방향으로만 맞습니다.
2. 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 수직으로 끼웁니다. 그리고 나서 메모리 모듈 위의 골든 핑거가 DIMM 슬롯에 깊이 삽입될 때까지 밀어 넣습니다. 메모리 모듈이 제자리를 잡으면, DIMM 슬롯의 양쪽에 있는 플라스틱 클립이 자동으로 닫힙니다.
3. 메모리 모듈이 양쪽에 있는 DIMM 슬롯 클립에 의해 제자리에 잠가졌는지 수동으로 확인하십시오.

중요 사항

메모리 모듈이 DIMM 슬롯에 제대로 삽입되면 골든 핑거가 거의 보이지 않습니다.

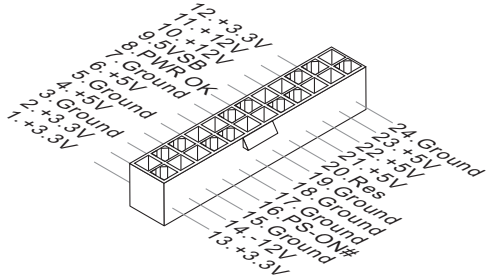


전원 공급 장치

ATX 24 핀 전원 커넥터: JPWR1

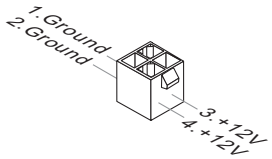
이 커넥터를 사용하여 ATX 24 핀 전원 공급장치를 연결할 수 있습니다. ATX 24 핀 전원 공급장치를 연결하려렴, 전원 공급장치의 플러그가 올바른 방향으로 삽입되었는지, 이 정렬되었는지 확인하십시오. 그리고 나서 전원 공급장치를 커넥터 안쪽으로 꽉 맞게 누릅니다.

원하는 경우 20 핀 ATX 전원 공급장치를 사용할 수 있습니다. 20 핀 ATX전원 공급장치를사용하려면, 전원 공급장치의 플러그를 핀 1 및 핀13과 함께 연결하십시오.



ATX 4 핀 전원 커넥터: PWR1

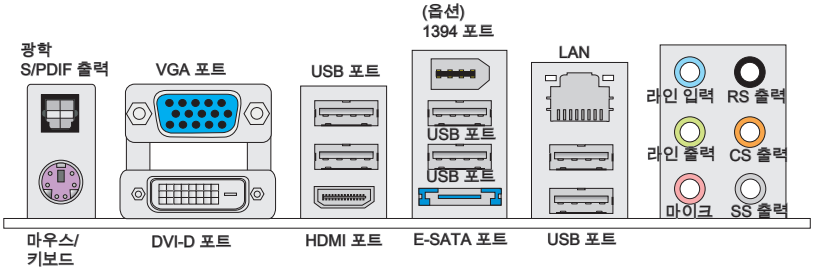
이 전원 커넥터는 CPU에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.



중요 사항

- *모든 커넥터가 올바른 ATX 전원 공급장치에 연결되어 메인보드의 작동이 안정적인지 확인하십시오.*
- *시스템 안정성을 위해 350와트 이상의 전원 공급장치를 권장합니다.*

후면 패널



▸마우스/키보드

표준 PS/2® 마우스/키보드 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▸USB 포트

USB (Universal Serial Bus) 포트는 키보드, 마우스 또는 기타 USB 호환 가능 장치와 같은 USB 장치를 연결하는 데 사용됩니다.

▸VGA 포트

DB15핀 피메일 커넥터가 모니터용으로 제공됩니다.

▸DVI-D 포트

DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) 커넥터를 사용하여 LCD 모니터를 연결할 수 있습니다.이 커넥터는 컴퓨터와 디스플레이 장치를 고속의 디지털 방식으로 연결합니다. LCD 모니터를 연결하려면, 모니터 케이블을 DVI-D 커넥터에 연결하고 케이블의 다른 쪽 끝이모니터에 제대로 연결되었는지 확인하기만 하면 됩니다. (자세한 내용은 모니터 설명서를 참조하십시오.)

▸광학 S/PDIF 출력

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 광 섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는 데 사용됩니다.

▸HDMI 포트

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)는 압축되지 않은 스트림을 전송할 수 있는 올 디지털 오디오/비디오 인터페이스입니다. HDMI는 단 하나의 케이블에서 표준, 고급 또는 고해상도 비디오, 다채널 디지털 오디오를 포함하여 모든 TV 형식을 지원합니다..

▸1394 포트 (옵션)

후면 패널의 IEEE1394 포트는 IEEE1394 장치에 대한 연결을 제공합니다.

▸E-SATA 포트

이 E-SATA (External-SATA) 포트는 E-SATA 외장 하드 드라이브를 연결하는 데 사용됩니다.

▸LAN

표준 RJ-45 LAN 잭은 Local Area Network (LAN) 연결용입니다. 네트워크 케이블을 이 잭에 연결할 수 있습니다.



LED	칼라	LED 상태	조건
왼쪽	노란색	꺼짐	LAN 링크가 구축되지 않았습니다.
		켜기(지속 상태)	LAN 링크가 구축되었습니다.
		켜기(밝게 및 펄싱)	컴퓨터가 LAN 상의 다른 컴퓨터와 통신 중입니다.
오른쪽	녹색	꺼짐	10 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다.
		켜기	100 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다.
	오렌지색	켜기	1000 Mbit/sec 데이터 속도를 선택했습니다.

▸오디오 포트

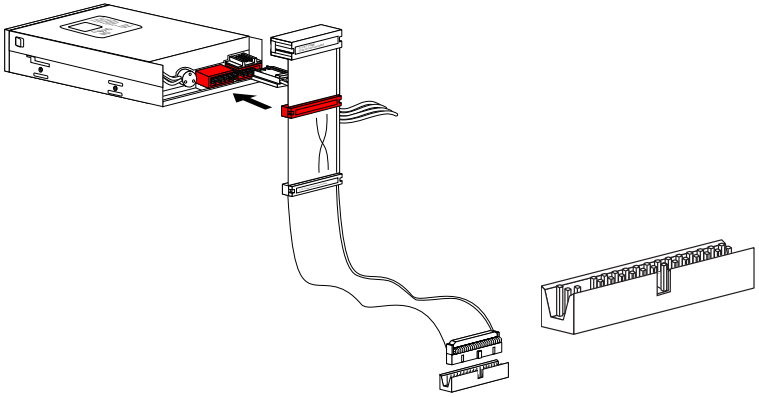
이 오디오 커넥터는 오디오 장치에 사용됩니다. 오디오 잭의 색상으로 오디오 효과를 쉽게 구별할 수 있습니다.

- 라인 입력(파란색) - 라인 입력은 외부 CD 플레이어, 테이프 플레이어 또는 기타 오디오 장치에 사용됩니다.
- 라인 출력(녹색) - 라인 출력은 스피커 또는 헤드폰에 사용되는 커넥터입니다.
- 마이크(핑크색) - 마이크는 마이크에 사용되는 커넥터입니다.
- RS 출력(검은색) - 4/5.1/7.1 채널 모드의 뒤쪽 서라운드 출력.
- CS 출력(오렌지색) - 5.1/7.1 채널 모드의 중앙/서브우퍼 출력.
- SS 출력(회색) - 7.1 채널 모드의 측면 서라운드 출력.

커넥터

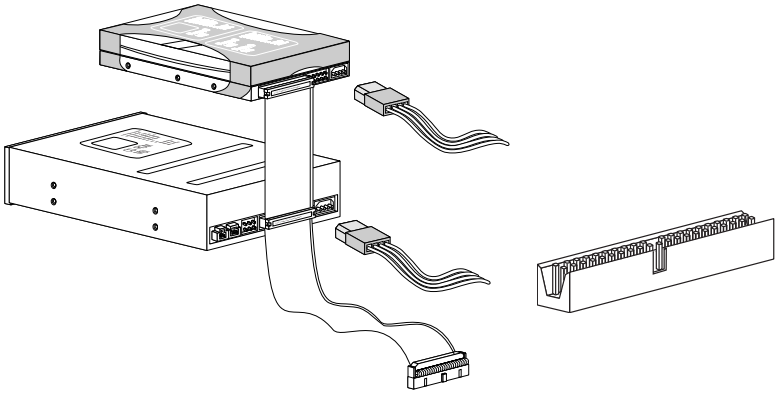
플로피 디스크 드라이브 커넥터: FDD1

이 커넥터는 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB 또는 2.88MB 플로피 디스크 드라이브를 지원합니다.



IDE 커넥터: IDE1

이 커넥터는 IDE 하드 디스크 드라이브, 광학 디스크 드라이브 및 기타 IDE 장치를 지원합니다.

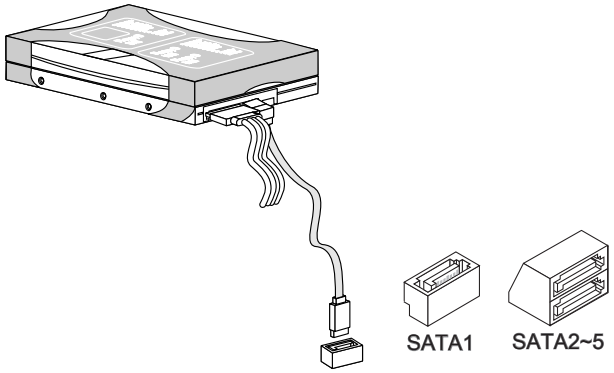


중요 사항

동일한 케이블에 2개의 IDE 장치를 설치하는 경우, 점퍼 설정으로 마스터/슬레이브에 드라이브를 별도로 구성해야 합니다. 점퍼 설정 방법은 공급업체가 제공한 IDE 장치의 설명서를 참조하십시오.

시리얼 ATA 커넥터: SATA1~5

이 커넥터는 고속의 시리얼 ATA 인터페이스 포트에 사용됩니다. 각 커넥터는 하나의 시리얼 ATA 장치에 연결할 수 있습니다.

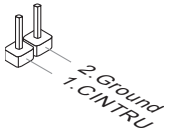


중요 사항

시리얼 ATA 케이블을 90도로 꺾지 마십시오. 그럴 경우, 전송 중 데이터가 손실될 수 있습니다.

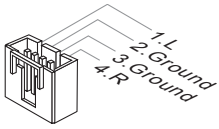
섀시 침입 커넥터: JCI1

이 커넥터는 섀시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 섀시가 열리는 경우, 섀시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지를 표시합니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.



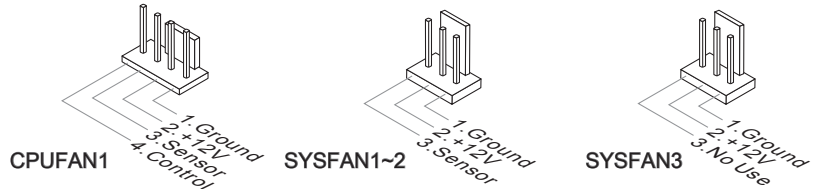
CD 입력 커넥터: JCD1

이 커넥터는 외부 오디오 입력용으로 제공됩니다.



팬 전원 커넥터: CPUFAN1, SYSFAN1~3

팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 냉각 팬을 지원합니다. 전선을 커넥터에 연결할 때,항상 빨간색 전선이 양극으로서 +12V에 연결되어야 하고, 검은색 전선은 접지선으로서 GND에 연결되어야 합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋 온보드가 있는 경우, CPU 팬 제어를 활용하기 위해 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다.

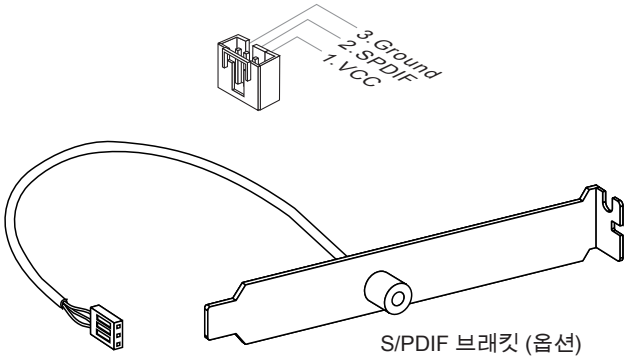


중요 사항

- *프로세서의 공식 웹 사이트에서 권장 CPU 팬을 참조하거나 판매점에 올바른CPU 냉각 팬을 문의하십시오.*
- *CPUFAN1 은 팬 제어를 지원합니다. 실제 CPU 시스템 온도에 따라 이 CPU 속도를 자동으로 제어하는 **Overclocking Center** 유틸리티를 설치할 수 있습니다.*
- *3 또는 4핀 전원 커넥터를 설정된 팬 쿨러을 CPUFAN1에서 사용할 수 있습니다.*

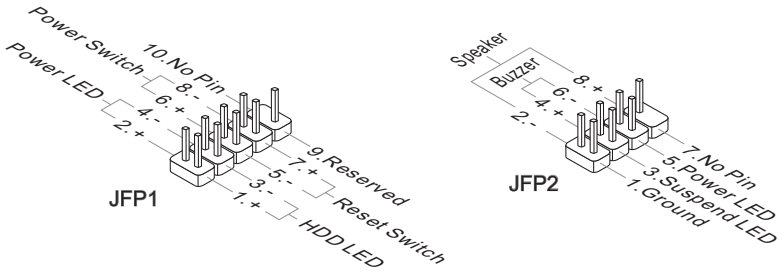
S/PDIF 출력 커넥터: JSP1

이 커넥터는 디지털 오디오 전송을 위해 S/PDIF(Sony & Philips Digital Interconnect Format) 인터페이스를 연결하는 데 사용됩니다.



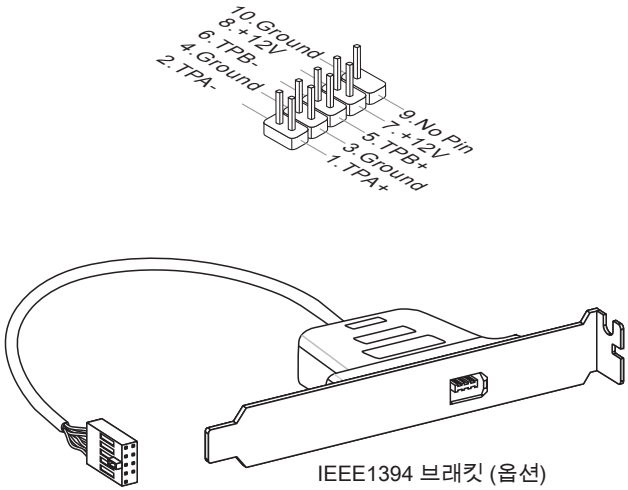
전면 패널 커넥터: JFP1, JFP2

이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 대한 전기 연결에 사용됩니다. JFP1은 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.



IEEE1394 커넥터: J1394_1 (옵션)

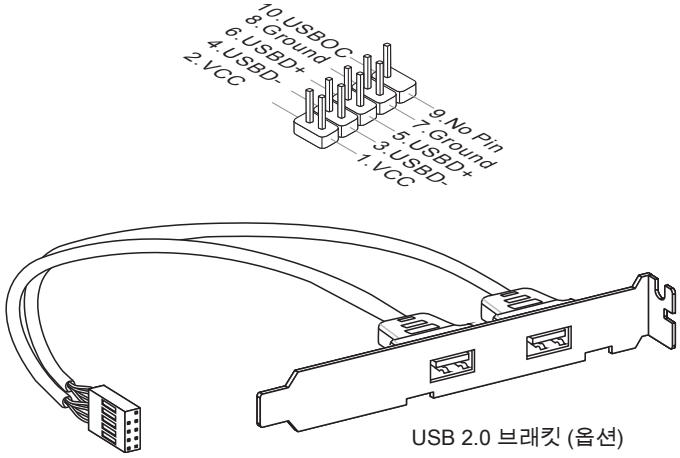
이 커넥터를 사용하여 옵션인 IEEE1394 브래킷을 통해 IEEE1394 장치를 연결할 수 있습니다.



IEEE1394 브래킷 (옵션)

전면 USB 커넥터: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

Intel® I/O Connectivity Design Guide를 준수한 이 커넥터는 USB HDD, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 프린터, 모뎀 등과 같은 고속의 USB 인터페이스 주변 장치를 연결하는 데 적합합니다.



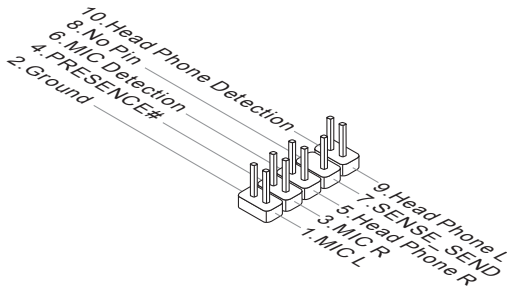
USB 2.0 브래킷 (옵션)

중요 사항

VCC 및 GND의 핀은 손상을 방지하기 위해 올바로 연결되어야 합니다.

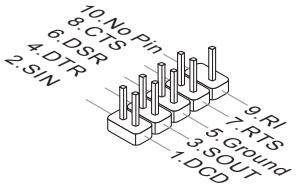
전면 패널 오디오 커넥터: JAUD1

이 커넥터를 사용하여 전면 패널 오디오를 연결할 수 있으며, 이 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.



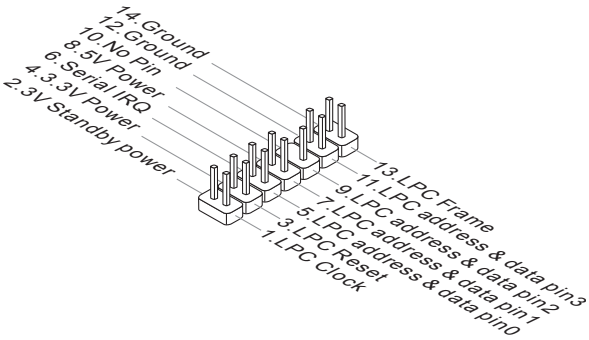
시리얼 포트 커넥터: JCOM1

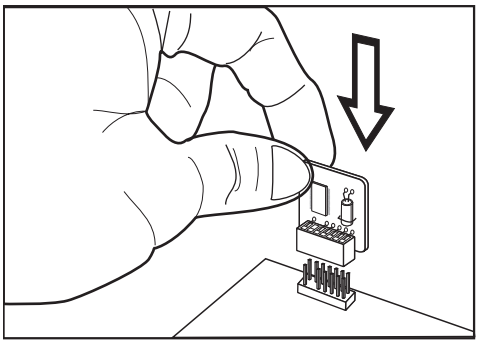
이 커넥터는 16550A 고속 통신 포트로서 16 바이트의 FIFO를 송수신합니다. 시리얼 장치를 연결할 수 있습니다.



TPM 모듈 커넥터: JTPM1

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈(옵션)에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하십시오.



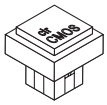


버튼

메인보드는 컴퓨터의 기능을 설정할 수 있도록 다음 버튼을 제공합니다. 이 절에서는 버튼의 사용으로 메인보드의 기능을 변경하는 방법을 설명합니다.

CMOS 클리어 버튼: CLR_CMOS1

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받은 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면, 이 버튼을 사용하여 데이터를 지우십시오. 이 버튼을 누러 데이터를 지울 수 있습니다.



중요 사항

CMOS 데이트를 지우기 전에 시스템을 종료하십시오.

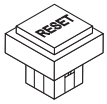
전원 버튼: POWER1

이 버튼은 시스템을 켜거나 끄는 데 사용됩니다. 버튼을 눌러 시스템을 켜거나 끄십시오. 시스템을 시작하면 이 불을 켜지고 시스템을 종료하면 불을 꺼집니다.



리셋 버튼: RESET1

이 리셋 버튼은 시스템을 리셋하는 데 사용됩니다. 버튼을 눌러 시스템을 리셋하십시오. 시스템이 S0 상테에서 버튼 불을 켜집니다.



스위치

오버클록 FSB 스위치: EZ OC Switch

스위치를 변경하여 프로세서 주파수를 높이기 위해 FSB 값을 높일 수 있습니다. 아래의 지시에 따라 FSB를 설정하십시오.



기본값



FSB 속도를
10% 높임



FSB 속도를
15% 높임



FSB 속도를
20% 높임

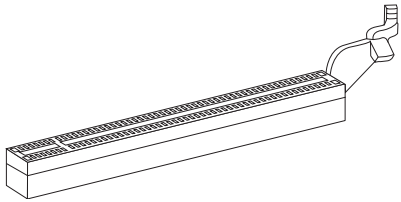
중요 사항

- *스위치를 변경하기 전에 시스템을 종료하십시오.*
- *오버클록할 때 시스템이 불안정하거나 부팅하는 동안 추락하면 기본 설정으로 스위치를 다시 설정하시기 바랍니다.*

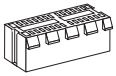
슬롯

PCI (Peripheral Component Interconnect) Express 슬롯

PCI Express 슬롯은 PCI Express 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.



PCI Express x16 슬롯



PCI Express x1 슬롯

Hybrid CrossFireX™ 기술

Hybrid CrossFireX™기술은 AMD® 785G 통합 그래픽 프로세서와 개별 그래픽 프로세서를동시에 작동시켜 하나의 디스플레이에 출력을 결합시킴으로써 매우 빠른 프레임 속도로 멀티 GPU 성능을 가능하게 해줍니다. 그래픽 성능을 대폭 향상시킵니다.

시스템 요청

1. Hybrid CrossFireX™은 Vista 운영체제에만 지원됩니다.
2. 그래픽 카드는 ATI Radeon™ HD 2400 시리즈[2], ATI Radeon™ HD 3400 시리즈 또는 ATI Mobility Radeon™ HD 3400 시리즈 그래픽 프로세스를 기반으로 합니다.
3. AMD® 785G을 기반으로 한 메인보드가 칩셋을 통합하였습니다.

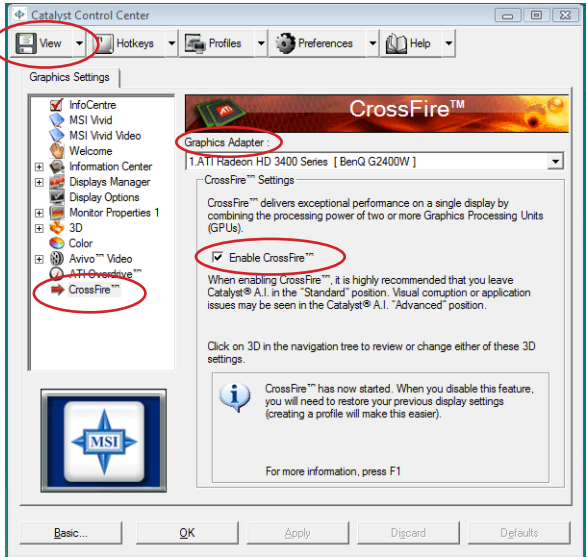
Hybrid CrossFireX™ Technology 활성화

시스템 전원을 끄고 Hybrid CrossFireX™ technology를 지원하는 ATI 그래픽 카드를 설치합니다. 그런 다음 시스템을 켜고 Hybrid CrossFireX™ 기술을 지원하는 드라이버를 설치합니다. 시스템을 다시 시작하고 ATI 아이콘이 시스템 트레이에 표시될 때까지 기다립니다. 아이콘을 클릭하면 Catalyst Control Center에 다음 내용이 나타납니다.



이 아이콘을 클릭합니다.

1. 보기 드롭다운 메뉴에서 고급 보기를 선택합니다.



2. Catalyst Control Center의 “그래픽 설정” 트리에서 CrossFire™을 클릭합니다.
3. “그래픽 어댑터” 목록에서 디스플레이 GPU 역할을 하는 그래픽 카드를 선택합니다.
4. “CrossFire™ 사용”을 선택합니다.
5. 적용을 클릭합니다.

Hybrid CrossFireX™가 사용으로 설정되면, Hybrid CrossFireX™가 사용하는 디스플레이를제외한 모든 디스플레이 구성 내의 모든 카드에 대해 GPU Accelerated Physics가 사용안함으로 자동 설정됩니다.

자세한 내용은 http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx를 참조하십시오.

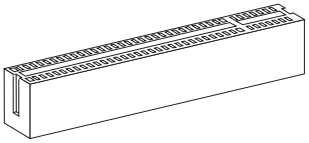
중요 사항

통합된 그래픽 카드 작동 모드를 변경하면 Hybrid CrossFireX™ 장애가 발생할 수있습니다. 이를 피하려면 아래 단계에 따라 시스템을 설정하십시오:

- *Catalyst Control Center의 Hybrid CrossFireX™를 비활성화합니다.*
- *재부팅하여 BIOS로 들어갑니다.*
- *고급 BIOS 기능->칩셋 기능->온칩 VGA에서 옵션을 선택합니다.*
- *BIOS 설정을 저장하고 재부팅합니다.*
- *Catalyst Control Center의 Hybrid CrossFireX™를 활성화합니다.*

PCI (Peripheral Component Interconnect) 슬롯

PCI 슬롯은 LAN 카드, SCSI 카드, USB 카드 및 PCI 규격을 준수하는 기타 애드온 카드를 지원합니다.



32 비트 PCI 슬롯

중요 사항

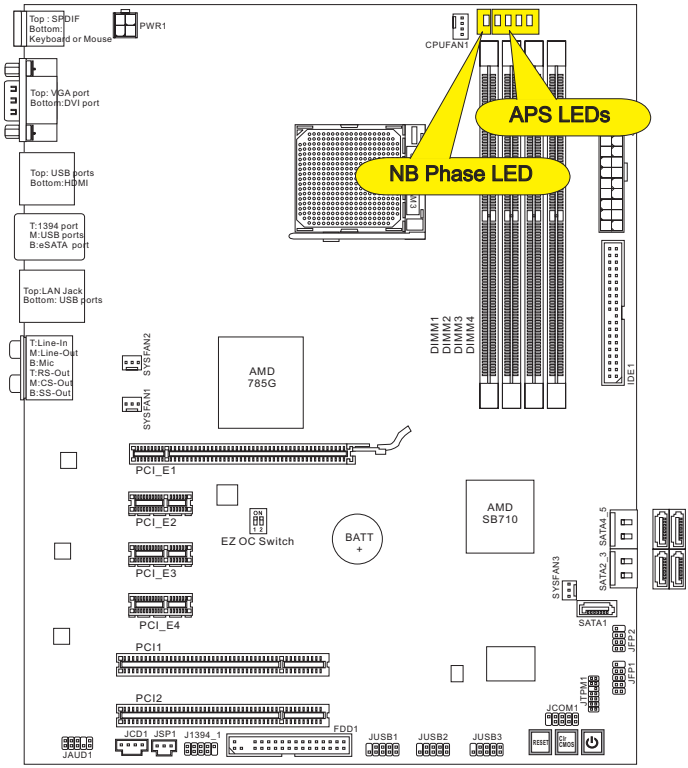
확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원 공급장치의 플러그를 뽑으십시오.점퍼, 스위치 또는 BIOS 구성과 같은 확장 카드에 대해 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 설정을 구성하려면 확장 카드의 설명서를 읽으십시오.

PCI 인터럽트 요청 라우팅

Interrupt request line의 약어인 IRQ는 I-R-Q라고 발음하며, 장치가 인터럽트 신호를 마이크로프로세서로 전송할 수 있는 하드웨어 회선입니다. PCI IRQ 핀은 일반적으로 다음과 같이 PCI 버스 핀에 연결됩니다.

	순서1	순서2	순서3	순서4
PCI 슬롯1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI 슬롯2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

LED 상태 표시기



APS LEDs

이 APS (Active Phase Switching) LED는 현재 CPU 전원 위상 모드를 표시합니다. 아래의 소개를 읽으십시오.

■ : 켜기, □ : 꺼짐

■■■■ CPU가 4위상 전원 모드에 있는 경우 4개 LED는 파란색으로 켜집니다.
■■■□ CPU가 3위상 전원 모드에 있는 경우 3개 LED는 파란색으로 켜집니다.
■■□□ CPU가 2위상 전원 모드에 있는 경우 2개 LED는 파란색으로 켜집니다.
■□□□ CPU가 1위상 전원 모드에 있는 경우 1개 LED는 파란색으로 켜집니다.

NB 위상 LED

NB는 운행하는 경우 파란색 불을 켜집니다.

BIOS 설정

이 장에서는 BIOS 설정 프로그램에 대한 기본 정보를 제공하여 사용자가 최적의 사용을 위해 시스템을 구성할 수 있도록 도와줍니다. 다음의 경우 설정 프로그램을 실행해야 합니다.

- 시스템을 부팅하는 동안 화면에 오류 메시지가 나타나고 BIOS 설정을 실행하도록 요청하는 경우.
- 사용자 정의된 기능을 사용하기 위해 기본 설정을 변경하려는 경우.

중요 사항

- *이 장에서 설명되는 각 BIOS 범주 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 계속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있으며 참조용으로만 사용해야 합니다.*
- *부팅 시 메모리 카운트 다음에 나타나는 첫 번째 행의 정보가 BIOS 버전입니다. 이는 대개의 경우 다음과 같은 형식으로 표시됩니다.*

A7576AMS V1.0 072409 여기에서:

1번째 문자는 BIOS 마커로서, A = AMI, W = AWARD, P = PHOENIX입니다.

2~5번째 자리수는 모델 번호입니다.

6번째 문자는 칩셋 공급업체로서, I = Intel, N = NVIDIA, A = AMD, V = VIA 입니다.

7~8번째 문자는 고객으로서, MS = 모든 표준 고객입니다.

V1.0은 BIOS 버전입니다.

072409은 이 BIOS가 발표된 날짜입니다.

설정 시작

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, <DEL> 키를 눌러 설정을 시작합니다.

Press DEL to enter SETUP

(DEL을 눌러 설정을 시작합니다.)

사용자가 응답하거나 설정을 입력하기 전에 메시지가 표시되면, 시스템을 껐다가 다시 켜거나 리셋 (RESET) 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

도움말 불러오기

설정 메뉴를 시작한 다음, 처음으로 표시되는 메뉴가 주 메뉴입니다.

주 메뉴

주 메뉴는 변경할 수 있는 설정 기능을 나열합니다. 화살표 키(↑↓)를 사용하여 항목을 선택할 수 있습니다. 강조 표시된 설정 기능의 온라인 설명이 화면의 하단에 표시됩니다.

하위 메뉴

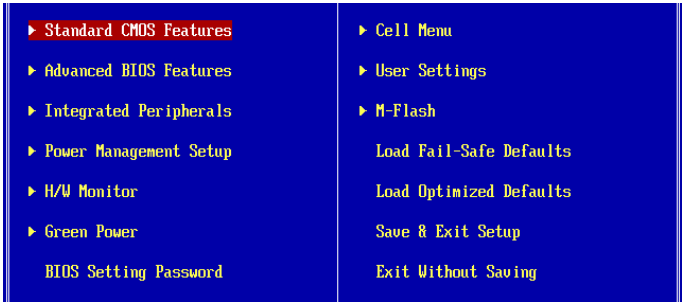
오른쪽 그림과 같이 올바른 포인터 기호가 특정 필드의 왼쪽에표시되면, 이 필드에서 추가 옵션을 포함한 하위 메뉴를 시작할 수 있다는 것을 의미합니다. 컨트롤 키(↑↓)를 사용하여 필드를 강조 표시하고 <Enter>를 눌러 하위 메뉴를 불러냅니다. 그리고 나서 컨트롤 키를 사용하여 값을 입력하고 하위 메뉴내에서 필드 간을 이동합니다. 주 메뉴로 돌아가려면, <Esc >를 누르기만 하면 됩니다.

일반 도움말 <F1>

BIOS 설정 프로그램은 일반 도움말 화면을 제공합니다. 간단히 <F1>을 누르기만 하면 어느 메뉴에서든지 이 화면을 불러낼 수 있습니다. 도움말 화면은 사용할 수 있는 적절한 키와 강조 표시된 항목에 대해 선택할 수 있는 항목을 나열합니다. <Esc>를 누르면 도움말 화면이 종료됩니다.

주 메뉴

BIOS CMOS 설정 유틸리티에 들어가면 주 메뉴가 화면에 표시됩니다. 주 메뉴의 설정 기능 및 두개 종료 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 화살표 키를 사용하여 항목 중 하나를 선택한 다음 <Enter>를 눌러 하위 메뉴를 수락하거나 또는 시작합니다.



▸Standard CMOS Features (표준 CMOS 기능)
이 메뉴를 사용하여 시간, 날짜 등과 같은 기본 시스템 구성을 처리합니다.

▸Advanced BIOS Features (고급 BIOS 기능)
이 메뉴를 사용하여 BIOS 특별 고급 기능의 항목을 설정합니다.

▸Integrated Peripherals (통합된 주변 장치)
이 메뉴를 사용하여 통합된 주변 장치의 설정을 지정합니다.

▸Power Management Setup (전원 관리 설정)
이 메뉴를 사용하여 전원 관리의 설정을 지정합니다.

▸H/W Monitor (H/W 모니터)
이 항목은 PC의 건간 상태를 표시합니다.

▸Green Power
이 메뉴를 사용하여 전원 페이즈를 지정합니다.

▸BIOS Setting Password (BIOS 설정 암호)
이 메뉴를 사용하여 BIOS의 암호를 설정합니다.

▸Cell Menu (셀 메뉴)
이 메뉴를 사용하여 주파수/전압 제어 및 오버클로킹의 설정을 지정합니다.

▸User Settings (사용자 설정)
이 메뉴를 사용하여 BIOS의 설정을 CMOS에/에서 저장하거나 로드합니다.

▸M-Flash (M-플래시)
이 메뉴를 사용하여 스토리지 드라이브에서 BIOS를 읽거나 플래시합니다 (FAT/FAT32 포맷 전용).

▸Load Fail-Safe Defaults (장애시 안전 기본값 로드)
이 메뉴를 사용하여 안정된 시스템 성능을 위해 BIOS 공급업체가 설정한 기본값을 로드합니다.

▸Load Optimized Defaults (최적 기본값 로드)
이 메뉴를 사용하여 특별히 메인보드 최적의 성능을 위해 메인보드 제조업체가 설정한 기본값을 로드합니다.

▸Save & Exit Setup (저장 및 설정 종료)
CMOS에 변경 사항을 저장하고 설정을 종료합니다.

▸Exit Without Saving (저장하지 않고 종료)
모든 변경 사항을 취소하고 설정을 종료합니다.

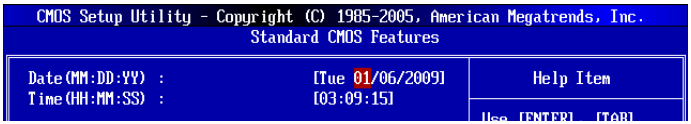
BIOS 설정 유틸리티를 시작할 때, 일반적 사용의 경우 다음 절차를 따르십시오.

1. Load Optimized Defaults (최적 기본값 로드): 컨트롤 키(↑↓)를 사용하여 Load-Optimized Defaul 필드를 강조 표시한 다음 <Enter>를 누르면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

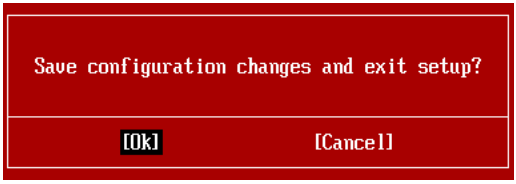


   [OK(확인)]을 선택하고 Enter 키를 누르면 최적의 시스템 성능을 위한 기본 설정이 로드됩니다.

2. Setup Date/ Time (날짜/시간 설정): 표준 CMOS 기능 Standard CMOS Features을 선택한 다음 <Enter>를 눌러서 표준 CMOS 기능 메뉴로 들어갑니다. 날짜, 시간 필드를 조정합니다.



3. Save & Exit Setup (저장 및 설정 종료): 컨트롤 키(↑↓)를 사용하여 Save & Exit Setup 필드를 강조 표시한 다음 <Enter>를 누르면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.



   [OK(확인)] 키와 Enter 키를 눌러 구성을 저장한 다음 BIOS 설정 유틸리티를 종료합니다.

중요 사항

위의 구성은 일반적 사용의 경우에만 해당됩니다. BIOS 설정에 대한 세부사항은 MSI 웹 사이트의 영어 설명서의 완전한 버전를 참조하십시오.

4. Cell Menu Introduction (셀 메뉴 소개): 메인보드를 오버클로킹하려는 고급 사용자를 위한 메T뉴입니다.



중요 사항

사용자가 칩셋에 익숙할 경우에만 이 설정을 변경하십시오.

▸Current CPU / DRAM Frequency (현재 CPU/ DRAM 주파수)

이 항목은 CPU 및 메모리 속도의 현재 클록을 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▸CPU Specifications (CPU 사양)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 CPU에 대한 정보를 표시합니다.

▸AMD Cool'n'Quiet (AMD 쿨앤콰이어트)

쿨앤콰이어트 기술은 CPU 속도와 소비 전력을 효과적이고 동적으로 낮출 수 있습니다.

중요 사항

쿨앤콰이어트 기능이 활성화되고 제대로 작동하는지 확인하려면, 다음을 이중으로 확인해야 합니다:

- *BIOS 설정을 실행하고 **Cell Menu(셀메뉴)** 에서 **AMD Cool'n'Quiet(쿨앤콰이어트)**를 찾아 이 항목을 "Enabled(사용)"로 설정합니다.*
- *Windows를 시작하여 [시작]-> [설정]->[제어판]->[전원 옵션]을 선택합니다. **PowerOptions Properties (전원 옵션 등록 정보)** 태그를 시작하여 **Power schemes (전원 체계)**에서 **Minimal Power Management (최소 전원 관리)**를 선택합니다.*

▸CPU Technology Support (CPU 기술 지원)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 기술을 표시합니다.

▸Adjust CPU FSB Frequency (CPU FSB 주파수 조정) (MHz)

이 항목을 사용하여 CPU FSB 클록 주파수(in MHz)를 선택할 수 있습니다.

▸Adjust CPU Ratio (CPU 비율 조정)

이 항목을 사용하여 CPU 클록 승수기(비율)을 설정할 수 있습니다. 이 필드는 프로세서가 이 기능을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

▸Adjusted CPU Frequency (조정된 CPU 주파수) (MHz)

이 항목은 조정된 CPU 주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▸Adjust CPU-NB Ratio (CPU-NB 비율 조정)

이 항목을 사용하여 CPU-NB 클록 비율을 조정할 수 있습니다.

▸Adjusted CPU-NB Frequency (조정된 CPU NB 주파수) (MHz)

이 항목은 조정된 CPU NB 주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▸EC Firmware (EC 펌웨어)

이 항목을 사용하여 Advanced Clock Calibration(고급 클록 교정)을 위해 EC Firmware를 선택할 수 있습니다. 추가 코어를 잠금 해제하기 위해 이 항목을 [Special(특별)]으로 설정하고 나서 Advanced Clock Calibration(고급 클록 교정)을 [Auto(자동)]으로 설정하면 프로세서 코어를 활성화할 수 있습니다.

▸Advanced Clock Calibration (고급 클록 교정)

이 항목은 오버클로킹에 사용됩니다. [Enabled(사용)]로 설정하면 CPU 속도를 더 높게 설정할 수 있습니다. 이 필드는 프로세서가 이 기능을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.

▸Auto OverClock Technology (자동 오버클록 기술)

이 항목을 [Max FSB(최대 FSB)]로 설정하면, 시스템에서 최대 FSB 클록을 인식하고 자동으로 오버클로킹할 수 있습니다. 오버클로킹 실행에 실패하면, 성공적인 오버클로킹을 위해 FSB 클록을 낮추어 시도할 수 있습니다.

▸MultiStep OC Booster (다단계 OC 부스터)

이 항목은 오버클럭킹이 진행되는 동안 BIOS가 깨지는 것을 방지하는 데 사용됩니다.

사용 안함	이 항목을 사용 안함으로 설정하고 POST 동안 OC 설정을 적용합니다.
모드 1	POST 동안 OC 일부를 적용하고 OS를 로드하는 동안 OC 전체를 적용합니다.
모드 2	OS를 로드한 다음 OC 설정을 적용합니다.

▸MEMORY-Z (메모리-Z)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▸DIMM1~4 Memory SPD Information (DIMM1~4 메모리 SPD 정보)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다. 이 하위 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.

▸Advance DRAM Configuration (고급 DRAM 구성)

<Enter>키를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▸DRAM Timing Mode (DRAM 타이밍 모드)

이 필드에는 DRAM 타이밍을 자동 인식하는 기능이 있습니다. 이 필드를 [DCT 0], [DCT 1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정할 경우 일부 필드가 표시되고 해당 필드를 선택할 수 있습니다. DCT 0이 채널 A를, DCT1이 채널 B를 제어합니다.

▸CAS Latency (CAS 대기 시간) (CL)

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 이렇게 되면 SDRAM이 읽기 명령을 받아서 이 명령을 시작하기 전에 (클록 사이클의) 타이밍 지연을 결정하는 CAS 대기 시간을 제어합니다.

▸tRCD

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. DRAM이 재충전되면 행과 열이 따로 분리됩니다. 이 설정 항목을 사용하면 RAS(열 주소)에서 CAS(행 주소)로의 변환 타이밍을 결정할 수 있습니다. 클록 사이클이 짧을수록 DRAM 성능이 빨라집니다.

▸tRP

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 이 설정은 사전에 충전할 수 있는 RAS 사이클 수를 제어합니다. DRAM 재충전 이전에 RAS가 충전 시간을 충분히 갖지 못할 경우, 충전이 불충분해서 DRAM이 데이터를 보존하지 못할 수 있습니다. 이 항목은 시스템에 동기화 DRAM이 설치된 경우에만 적용됩니다.

▸tRAS

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 이 설정은 RAS가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▸tRTP

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 읽기 명령과 사전 충전 명령 간의 시간 간격을 결정합니다.

▸tRC

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 행 사이클 시간은 메모리 행이 행 활성화에서 현재 행의 사전 충전에 이르기까지 전체 사이클을 완료하는 데 필요한 클록 사이클의 최소 수를 결정합니다.

▸tWR

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 유효한 쓰기 작업의 완료 후 현재 뱅크를 사전 충전할 수 있을 때까지 경과해야 하는 지연(클럭 사이클의)을 지정합니다. 이 지연은 사전 충전이 발생하기 전에 쓰기 버퍼의 데이터를 메모리 셀에 쓸 수 있도록하는 데 필요합니다.

▸ **tRRD**

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 다른 뱅크의 active-to-active 지연을 지정합니다.

▸ **tWTR**

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 이 항목은 읽기 명령지연에 데이터 쓰기(Write Data In to Read Command Delay) 메모리 타밍을 제어합니다. 이 항목이 DDR 장치의 동일한 내부 뱅크에 대한 유효한 최종 쓰기 작업과 다음 읽기 명령 사이에 발생하는 클럭 사이클의 최소 수를 구성합니다.

▸ **tRFC0~3**

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 이 설정은 RFC가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▸ **tWRTTO**

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 데이터 읽기와 쓰기사이에 순환 시간; CAS 읽기 작업의 최종 클럭 명령과 다음 쓰기 작업 명령 사이에 최소 사이클 시간을 결정합니다. 항목 설정이 작을수록 시스템의 운행 속도는 빨라지지만 시스템이 더 불안정할 것입니다. 메모리 모듈을 따라 설정하십시오.

▸ **tWRRD**

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 쓰기와 읽기사이에 사간; 첫번째 가상 CAS 쓰기 버스트 작업의 최종 클럭과 다음의 다른 칩거나 DIMM를 위해 한 읽기 버스트 작업 사이에 최소 사이클 시간을 결정합니다. 항목 설정이 작을수록 시스템의 운행 속도는 빨라지지만 시스템이 더 불안정할 것입니다. 메모리 모듈을 따라 설정하십시오.

▸ **tWRWR**

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 쓰기와 쓰기사이에 사간;첫번째 가상 CAS 쓰기 버스트 작업의 최종 클럭과 다음의 활성화하는 터미네이터를 변경된 읽기 버스트 작업 사이에 최소 사이클 시간을 결정합니다. 항목 설정이 작을수록 시스템의 운행 속도는 빨라지지만 시스템이 더 불안정할 것입니다. 메모리 모듈을 따라 설정하십시오.

▸ **tRDRD**

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 읽기와 읽기사이에 사간; 첫번째 가상 CAS 읽기 버스트 작업의 최종 클럭과 다음의 다른 칩거나 DIMM를 위해 한 읽기 버스트 작업 사이에 최소 사이클 시간을 결정합니다. 항목 설정이 작을수록 시스템의 운행 속도는 빨라지지만 시스템이 더 불안정할 것입니다. 메모리 모듈을 따라 설정하십시오.

▸ **DRAM Drive Strength (DRAM 드라이브 장점)**

이 기능을 사용하여 메모리 데이터 버스의 신호 강도를 제어할 수 있습니다. 메모리 버스의 드라이브 강도를 높이면 오버클로킹 동안 안정성이 높아집니다.

▸DRAM Advance Control (DRAM 고급 제어)

이 필드에는 고급 DRAM 타이밍을 자동 인식하는 기능이 있습니다. 이 필드를 [DCT 0], [DCT 1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정할 경우 일부 필드가 표시되고 해당 필드를 선택할 수 있습니다.

▸1T/2T Memory Timing (1T/2T 메모리 타이밍)

DRAM Timing Mode(DRAM 타이밍 모드)가 [DCT 0], [DCT1] 또는 [Both(둘 다)]로 설정되어 있으면, 이 필드를 조정할 수 있습니다. 이 필드가 SDRAM 명령 대기 시간을 제어합니다. [1T]를 선택하면 SDRAM 신호 컨트롤러가 1T (T=클럭 사이클) 속도로 실행됩니다. [2T]를 선택하면 SDRAM 신호 컨트롤러가 2T 속도로 실행됩니다.

▸DCT Unganged Mode (DCT 언게인지드 모드)

이 기능은 2개의 64-비트 DCT를 하나의 128-비트 인터페이스로 통합하는 데 사용됩니다.

▸Bank Interleaving (뱅크 인터리빙)

뱅크 인터리빙은 메모리의 오버클로킹 성능을 높이는 데 중요한 매개변수입니다. 이를 사용하여 여러 개의 뱅크를 동시에 액세스할 수 있습니다.

▸Power Down Enable (전원 다운 사용)

이는 메모리 전원 절감 기술입니다. 시스템이 일정 시간 동안 메모리를 액세스하지 않는 경우, 메모리 전원 공급을 자동으로 줄어듭니다.

▸MemClk Tristate C3/ATLVID

이 설정을 사용하여 C3과 ATLVID 동안 MemClk Tristating을 활성화/비활성화할수 있습니다.

▸FSB/DRAM Ratio (FSB/DRAM 비율)

이 항목을 사용하여 FSB/ DRAM의 비율을 선택할 수 있습니다.

▸Adjusted DRAM Frequency (조정된 DRAM 주파수) (MHz)

이 항목은 조정된 메모리 주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▸Onboard VGA Over Clock (온보드 VGA 오버클록)

이 항목을 사용하여 온보드 VGA를 오버클록할 수 있습니다.

▸ Onboard VGA Clock (온보드 VGA 클록)

이 항목은 온보드 VGA 오버클록을 [사용]으로 설정된 경우 표시됩니다. 이 항목을 사용하여 온보드 VGA 클록을 조정할 수 있습니다.

▸HT Link Control (HT 링크 제어)

<Enter>를 눌러 하위 메뉴를 시작합니다.

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width (HT 수신/발신 링크 폭)

이 항목을 사용하여 하이퍼 전송 링크 폭을 설정할 수 있습니다. [Auto(자동)]으로 설정하면 시스템이 HT 링크 폭을 자동으로 인식합니다.

▸HT Link Speed (HT 링크 속도)

이 항목을 사용하면 하이퍼 전송 링크 속도를 설정할 수 있습니다. [자동(Auto)] 으로 설정하면 시스템은 HT 링크 속도를 자동으로 감지합니다.

▸Adjusted HT Link Frequency (조정된 HT 링크 주파수) (MHz)

이 항목은 조정된 HT 링크 주파수를 표시합니다. 읽기 전용입니다.

▸Adjust PCI-E Frequency (PCI-E 주파수 조정) (MHz)

이 항목을 사용하여 PCIE 주파수(in MHz)를 선택할 수 있습니다.

▸Auto Disable DRAM/PCI Frequency (DRAM/PCI 주파수 자동 해제)
[Enabled(사용)]으로 설정하면 시스템이 빈 DRAM/ PCI 슬롯에서 클록을 제거(전원이 꺼짐)하여 전자파 장애(EMI)를 최소화할 수 있습니다.

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)
이 항목은 CPU, 메모리 및 칩셋의 전압 조정에 사용됩니다.

▸Spread Spectrum (대역 확산)
메인보드의 클록 생성기가 펄스화되면 펄스의 극치값(스파이크)이 전자파 장애를 일으킵니다. 대역 확산 기능은 펄스 조절로 생성된 EMI를 줄여줌으로써 그 결과 펄스의 스파이크가 평탄한 곡선으로 줄어듭니다. EMI 문제가 발생하지 않을 경우 최적의 시스템 안정성 및 성능을 위해 사용 안함으호 설정합니다. 그러나 EMI로 인해 문제가 발생할 경우 EMI 감소를 사용으로 설정하십시오. 사소한 지터조차도 클록 속도를 일시적으로상승시키면 오버클로킹한 프로세스를 고정시키는 원인이 될 수 있으므로 오버클로킹을 진행하는 동안 대역 확산을 반드시 사용 안함으로 설정해야 합니다.

중요 사항

- *EMI 문제가 발생하지 않을 경우 최적의 시스템 안정성 및 성능을 위해 [Disabled(사용 안함)]으로 설정합니다. 그러나 EMI로 인해 문제가 발생할 경우 EMI 감소를 위해 대역 확산 값을 선택하십시오.*
- *대역 확산 값이 클수록 EMI는 감소되지만 시스템의 안정성은 저하됩니다. 가장 적합한 대역 확산 값은 해당 지역의 EMI 규정을 참조하십시오.*
- *사소한 지터조차도 클록 속도를 일시적으로 상승시키면 오버클로킹한 프로세스를 고정시키는 원인이 될 수 있으므로 오버클로킹을 진행하는 동안 대역확산을 반드시 사용 안함으로 설정해야 합니다.*

중요 사항

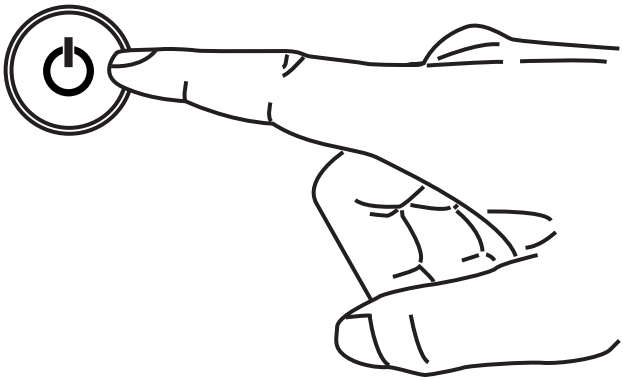
Failed Overclocking Resolution (오보클로킹 해상도 실패)

이 메인보드는 오버클럭킹을 전적으로 지원합니다. 그러나 사용자의 주변장치 및 구성 요소가 일부 특수 설정을 견딜 수 있는지 확인하십시오. 생산 사양을 초과하는 작업은 어떤 경우에도 바람직하지 않습니다. 적절하지 못한 작업으로 인한 위험이나 손상은 당사의 제품 보증을 받지 못합니다.

실패한 오버클럭킹으로부터 시스템을 저장하는 두가지 방법...

- *Reboot (재부팅)*

  전원 버튼을 눌러 시스템을 세 번 재부팅합니다. 전류가 다른 장치나 구성요소에 영향을 미치지 않도록 주의하십시오. 그러기 위해서 각각의 재부팅 사이에 10초 이상의 간격을 두는 것이 좋습니다.



네 번째 재부팅 시 BIOS가 이전 오버클럭킹이 실패했음을 판별하고 자동으로 기본 설정으로 돌아갑니다. 화면에 다음 메시지가 나타나면 아무 키나 눌러 시스템을 평소대로 부팅하십시오.

```
Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....
```

- *Clear CMOS (CMOS 초기화)*

  자세한 내용은 "CMOS 데이터 초기화 방법" 부분을 참조하세요.

소프트웨어 정보

메인보드 패키지에 들어 있는 드라이버/유틸리티 DVD를 꺼내서 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 설치는 자동 실행되며, 드라이버나 유틸리티를 클릭하기만 하면 팝업 화면이설치 완료를 표시합니다. 드라이버/유틸리티 DVD에는 다음이 포함됩니다.

- 드라이버 메뉴 : 사용 가능한 드라이버를 표시합니다. 원하는 대로 드라이버를 설치한 다음 장치를 활성화합니다.
- 유틸리티 메뉴 : 메인보드가 지원하는 소프트웨어 응용 프로그램을 표시합니다.
- 웹사이트 메뉴 : 필요한 웹사이트를 표시합니다.

중요 사항

최신 드라이버 및 BIOS로 시스템 성능을 향상시키고 싶다면 MSI 웹사이트를 방문하십시오.

785G-E65シリーズ

日本語

Asia version

マザーボードの仕様

対応プロセッサー

■ AM3 AMD® Phenom™ II X4/ X3とAthlon X4/ X3/ X2プロセッサー
(最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

■ HyperTransport™ 3.0、最大5.2 GT/sまでの速度をサポート

チップセット

■ ノースブリッジ: AMD® 785Gチップセット
■ サウスブリッジ: AMD® SB710チップセット

対応メモリ

■ DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*=OC) SDRAM (最大16GB搭載可能)
■ 4 DDR3 DIMM (240ピン / 1.5V)
(最新のメモリモジュール対応状況については下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

■ Realtek® RTL8111DL PCIE LAN 10/100/1000ファーストイーサネットをサポート

IEEE 1394 (オプション)

■ VIA® VT6315N
■ 最大400Mbpsまでの転送速度をサポート

オーディオ

■ Realtek® ALC888S/ ALC889
■ 8チャンネルオーディオ(接続検知機能付き)
■ Azalia 1.0準拠

IDE

■ AMD® SB710によるIDEポートを1基搭載
■ Ultra DMA 66/100/133モードをサポート
■ PIO、バスマスタの各動作モードをサポート

SATA

■ AMD® SB710によるSATAIIポートを5基搭載
■ 最大3 Gb/sまでのデータ転送をサポート

E-SATA

■ AMD® SB710によるeSATAポートを1基搭載
■ 最大3 Gb/sまでのデータ転送をサポート

RAID

■ SATA 1~5はAMD® SB710によるRAID 0/ 1/ 10あるいはJBODモードをサポート

フロッピー

■ フロッピーポートを1基搭載
■ 360KB、720KB、1.2MB、1.44MBまたは2.88MBのFDD、1台の接続が可能

コネクター

■ I/Oパネル
- PS/2ポート ×1
- 光学S/PDIF出力ポート ×1
- VGAポート ×1
- DVI-Dポート ×1
- HDMIポート ×1
- IEEE1394ポート ×1 (オプション)
- USB 2.0ポート ×6
- eSATAポート ×1
- LANジャック ×1
- オーディオジャック ×6

■ オンボードコネクター
- USB 2.0コネクター ×3
- IEEE1394コネクター ×1 (オプション)
- SPDIF出力コネクター ×1
- CD入力コネクター ×1
- フロントパネルオーディオコネクター ×1
- ケース開放センサーコネクター ×1
- シリアルコネクター ×1
- TPMコネクター ×1
- OCスイッチ ×1
- 電源LEDボタン ×1
- リセットLEDボタン ×1
- クリアCMOSボタン ×1

スロット

■ PCI Express x16スロット ×1
■ PCI Express x1スロット ×3
■ PCIスロット ×2、3.3V/ 5V PCIバスインターフェースをサポート

寸法

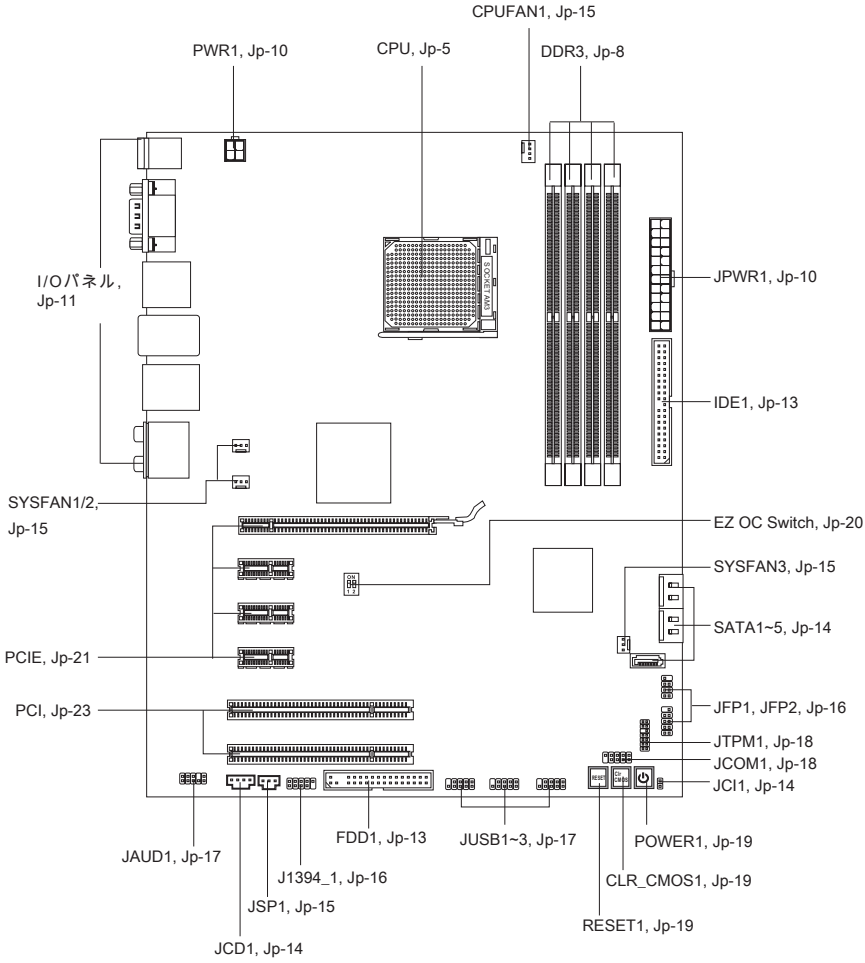
■ ATX (30.5cm X 24.4 cm)

取付穴

■ 9 穴

製品について更に詳しい情報を求めの場合は、弊社のWebサイトをご参照願います。
http://www.msi.com/index.php

クイックコンポーネントガイド



CPUに関する注意事項

CPUを装着する際はCPUクーラーを必ず装着してください。CPUクーラーを装着しない、あるいは取り付けが不十分だと、システムを安定して動作させることができないばかりか、最悪の場合CPUに修復不可能なダメージを与える場合があります。CPUクーラーが装着されていない状態でシステムの電源をONにしないでください。最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

注意

過熱

過熱が起こるとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。

CPUの交換

CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。

AM3 CPUについて

CPUのヒートスプレッダ側。効果的な放熱を行うために、シリコングリスを塗布してください。

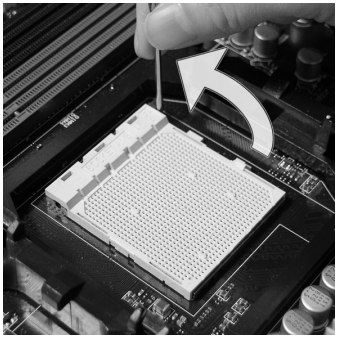


金色の三角印

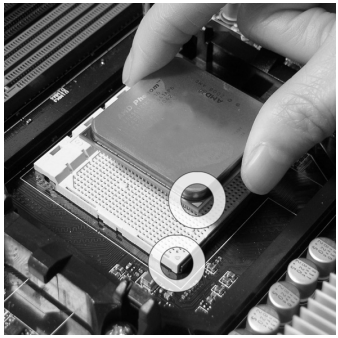
CPU & クーラーの装着

CPUを取り付ける際、**過熱を防ぐためにCPUクーラーをCPUに密着するように確実に取り付けてください**。また、CPUクーラーを装着する場合には必要に応じて適切な量のシリコングリスを塗布してください。下記の手順に従って正しくCPUとCPUクーラーを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合はCPUやマザーボードなどの破損を招きます。

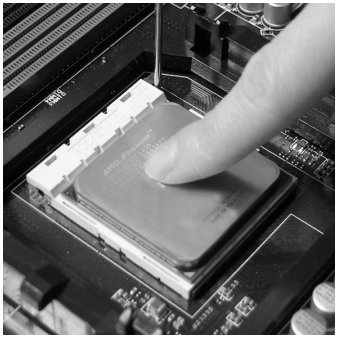
1. レバーをソケットから横方向に引っ張ってください。そのままレバーを持ち上げるようにしてソケットとの角度が90になるまで開きます。



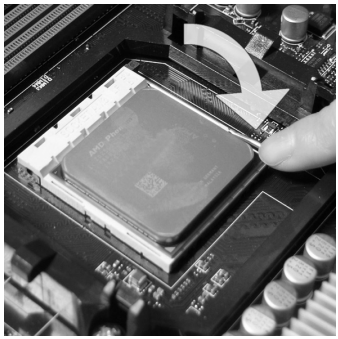
2. CPU上の金色の三角印(取り付け目印)と、ソケット上の三角印を合わせてCPUをセットします。



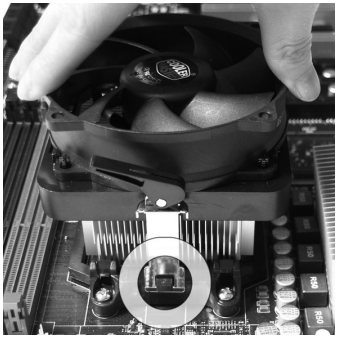
3. CPUが正しく装着された状態では、ピンがソケットにぴったりと差し込まれています。横から見てピンが浮いているような状態であれば、向きを確認して取り付けをやり直してください。間違ったCPUの装着はCPUやマザーボードに重大な損傷を与えてしまいますので、くれぐれもご注意ください。



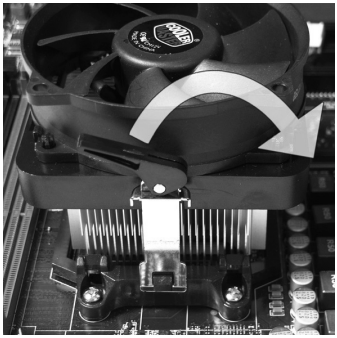
4. CPUを指でソケットにぐっと押し付けながら、固定レバーを倒してCPUを固定します。レバーで固定する際はCPUが押し戻される傾向があるので、レバーが固定されるまでCPUを抑える指を離さないでください。



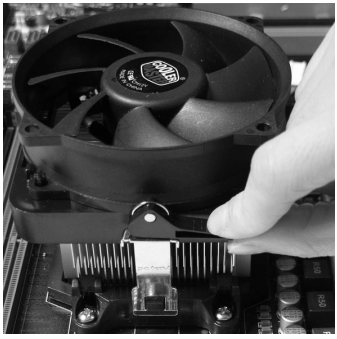
5. CPUクーラーをCPUの上に設置してください。リテンションキットに固定金具を噛ませます。



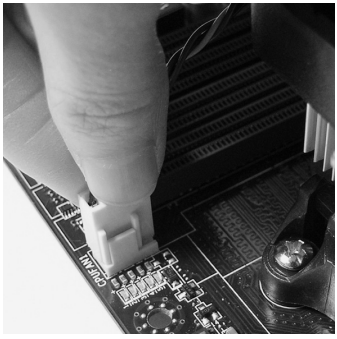
6. 片側の金具を押し下げて、ソケットのフックに取り付けます。レバーを逆サイドに倒します。



7. 片手でクーリングファンを押さえながら、レバーを倒します。



8. 最後にCPUファンの電源ケーブルをコネクターに接続します。

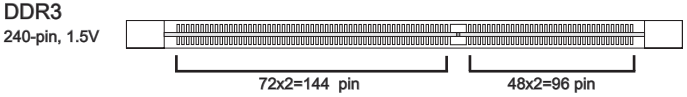


注意

- *本書で使用した画像はお手元の製品と細部が異なる場合があります。予めご了承ください。*
- *CPUファンを固定するバネ状金具は、弾力性の強い素材が使用されています。ロックを解除する際に弾けるように戻り、指などを挟む危険性があります。マイナスドライバーなどでバネの先端を押さえながら作業を行うと良いでしょう。*

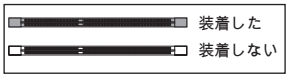
メモリ

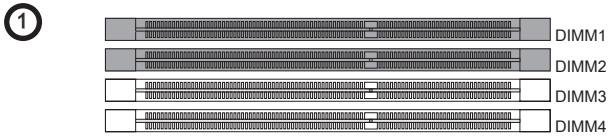
これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。
最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページを参照ください。
http://www.msi.com/index.php?func=testreport

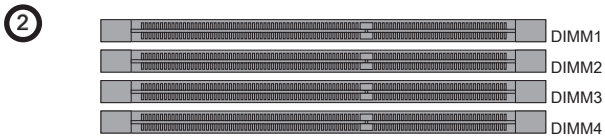


デュアルチャンネルモードソケットルール

デュアルチャンネルメモリアクセス方式は、二つのメモリデータバスを同時に使用してデータの読み書きを行うことによりアクセススピードを向上させます。デュアルチャンネルを有効にするには、以下の組み合わせでメモリモジュールを装着します。







注意

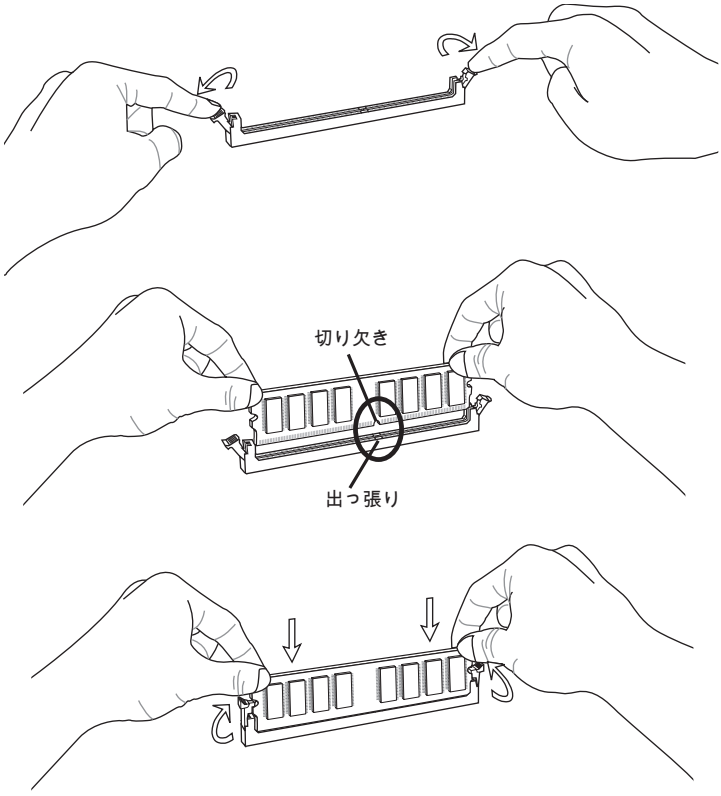
- *DDR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電気的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。*
- *デュアルチャンネルアクセスを有効にする為には同一メーカーの**同一メモリモジュール**を装着してください。*
- *メモリスロットは**DIMM1**を優先的に使用してください。*
- *チップセットの仕様により、各DIMMスロットに4GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(16GB未満での認識となります)*

メモリモジュールの装着

1. メモリモジュール中央付近には左右非対称の場所に切り欠きが 1 ヶ所設けられており、このため間違った向きでは差し込めないように作られています。
2. DIMMメモリモジュールをDIMMスロットへ垂直に差し込むとDIMMスロットの両側にあるモジュール固定ラッチが自動的に閉じ、モジュールを固定します。
3. 電源投入前にモジュールが両側のモジュール固定ラッチによって正しく固定されているかどうかを必ず確認してください。

注意

メモリモジュールがしっかりと装着されると、モジュールの端子部分が見えなくなります。

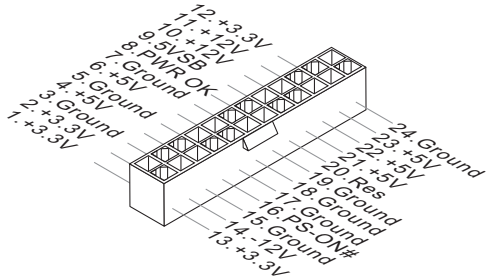


電源

ATX 24ピン電源コネクター: JPWR1

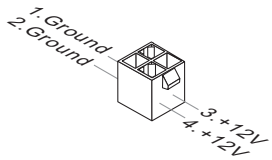
ATX電源24ピンコネクターを接続します。接続の際にはコネクターの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクターのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。

20ピンのATX電源も使用可能です。その場合には、11、12、23 & 24ピンは使用しません。



ATX 4ピン電源コネクター: PWR1

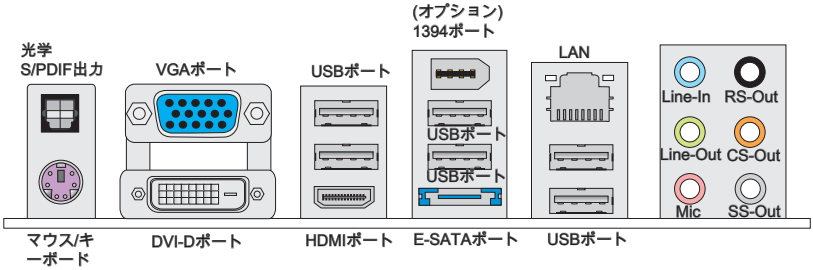
この電源コネクターは、CPUに電源を供給します。



注意

- *本製品を動作させるには上記二つのコネクターを正しく接続している必要があります。*
- *350W以上の良質な電源ユニットを使用してください。*

I/Oパネル



▸マウス/キーボード

マザーボードはPS/2®、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2®、マウス/キーオードミニDINコネクターが各一個ずつ設けられています。

▸USBポート

キーボードやマウスなどのUSB機器を本製品へ接続する場合に使用します。

▸VGAポート

外部モニターに映像をアナログ出力する端子です。

▸DVI-Dポート

DVI-D (Digital Visual Interface-Digital)コネクターでLCDモニターを接続できます。PCとディスプレイーデバイスの間に高速デジタルインターコネクト器が搭載されています。LCDモニターを接続する場合に、モニターケーブルをDVI-Dコネクターに挿入し、もう一端を正しくモニターに接続してください。(詳細についてはモニターマニュアルを参照してください。)

▸光学S/PDIF出力

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは光学ファイバーケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。5.1チャンネル/7.1チャンネルサウンド音声出力に対応しています。

▸HDMIポート

HDMI (High Definition Multimedia Interface)は同一端内で映像信号と音声信号をデジタル出力することができます。信号の劣化が少なく、接続が簡単であることから、急速に普及が進んでいる規格です。

▸1394ポート (オプション)

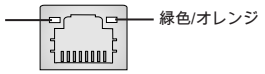
バックパネルのIEEE1394ポートはIEEE1394デバイスを接続します。

▸E-SATAポート

E-SATAポートはE-SATA接続の外付けドライブを接続する場合に使用します。

▸LAN

コンピューターをネットワーク環境へ接続する際に使用します。



LED	色	LED状態	コンディション
左	黄色	Off	ネットワークに接続していません。
		On(点灯)	ネットワークに接続しています。
		On(点滅)	通信中です。
右	緑色	Off	10 Mbits/秒で通信しています。
		On	100 Mbits/秒で通信しています。
	オレンジ	On	1000 Mbits/秒で通信しています。

▸オーディオポート

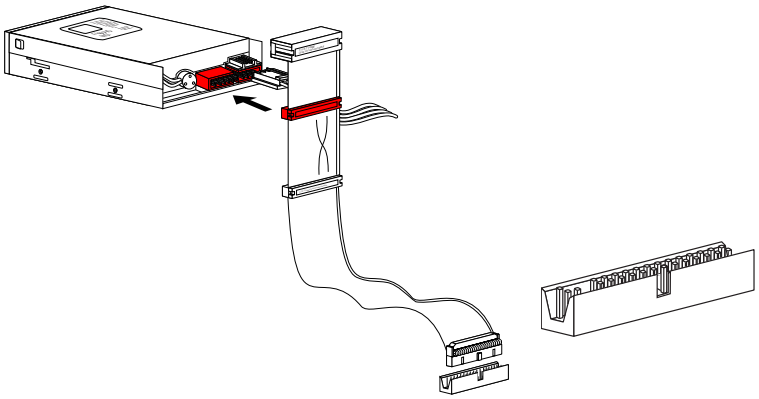
各チャンネルごにコネクター部の色を分類しており、ジャックの色と合わせることによって簡単に接続が可能です。

- Line-In (青色) - ライン入力、外付けCDプレイヤー、オーディオプレイヤーなどの機器を接続します。
- Line-Out (緑色) - ライン出力、スピーカあるいはヘッドホンを接続します。
- Mic (ピンク) - マイクを接続します。
- RS-Out (黒色) - 4/ 5.1/ 7.1チャンネルモード時にリアスピーカー端子を接続します。
- CS-Out (オレンジ) - 5.1/ 7.1チャンネルモード時にセンター/サブウーファー端子を接続します。
- SS-Out (灰色) - 7.1チャンネルモード時にサイドスピーカー端子を接続します。

コネクター

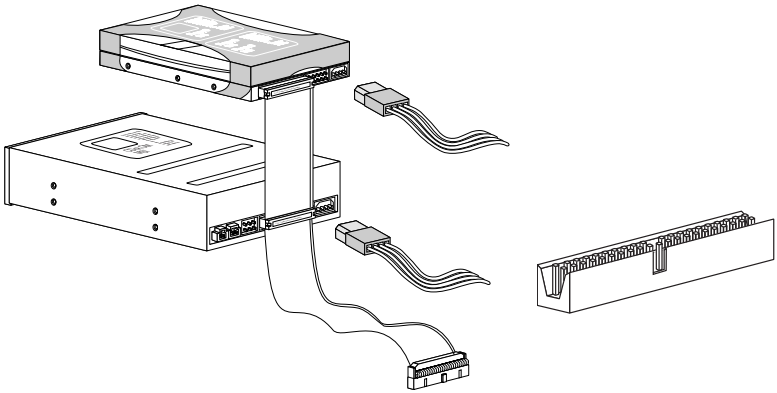
FDDコネクター: FDD1

本製品は360KB，720KB，1.2MB，1.44MB及び2.88MBのフロッピーディスクドライブに対応しています。



IDEコネクター: IDE1

本製品はIDE HDD、光学ディスクドライブなどのデバイスをサポートします。

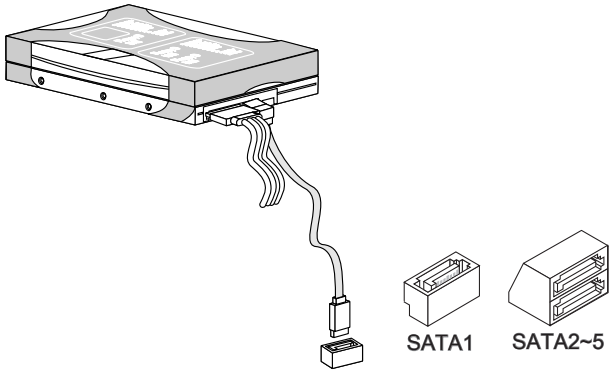


注意

ハードディスクを2台使用する場合は、ジャンパピンでマスター/スレーブの設定を行う必要があります。ジャンパ設定についてはハードディスクメーカーが提供するマニュアルを参照してください。

シリアルATAコネクター: SATA1~5

このコネクターは高速シリアルATAインターフェイスポートです。一つのコネクターにつき、一つのハードディスクを接続することができます

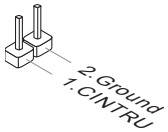


注意

シリアルATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。

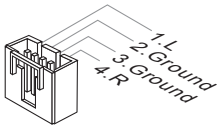
ケース開放センサーコネクター: JCI1

このコネクターには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します



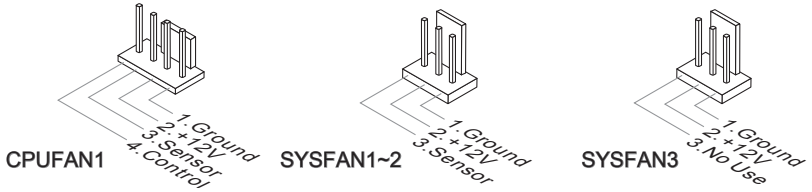
CD入力コネクター: JCD1

このコネクターはCD-ROMオーディオコネクターを接続します。



ファン電源コネクター: CPUFAN1, SYSFAN1~3

ファン電源コネクターは+12Vの冷却ファンをサポートします。接続する時に注意しなければならないのは、赤い線はプラスなので+12Vに、黒い線はアースなのでGNDに接続することです。また、本製品のシステムハードウェアモニタ機能を使用する場合はファンの回転数センサー機能がついたファンを使用する必要があります。

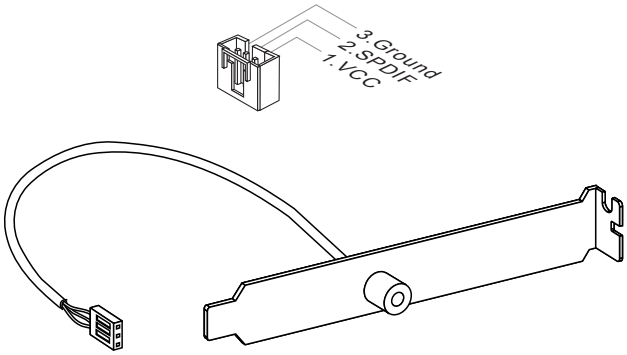


注意

- *CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。*
- *CPUFAN1はファンコントローラーをサポートします。ユーザーはOverclocking Centerユーティリティをインストールして、温度によって自動的にCPUファンの回転数をコントロールします。*
- *3/4ピンの電源コネクター付きのファンクーラーはCPUFAN1に使用できます。*

S/PDIF出力コネクター: JSP1

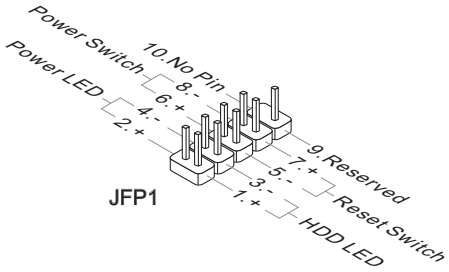
デジタルフォーマットで音声ソースを出力するためのインターフェイスです。5.1チャンネル/7.1チャンネルサウンド音声出力に対応しています。

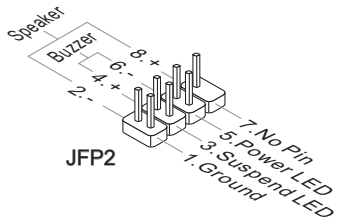


S/PDIFブラケット (オプション)

フロントパネルコネクター: JFP1, JFP2

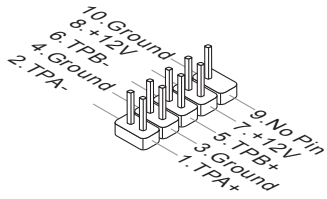
本製品にはケースのフロントパネルスイッチや電源 / HDDアクセスLED用にフロントパネルコネクターが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。

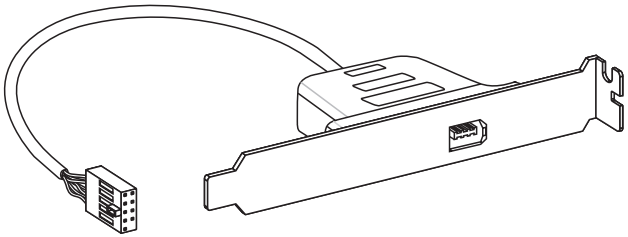




IEEE1394コネクター: J1394_1 (オプション)

このコネクターはオプションのIEEE1394ブラケット経由でIEEE1394デバイスを接続します。

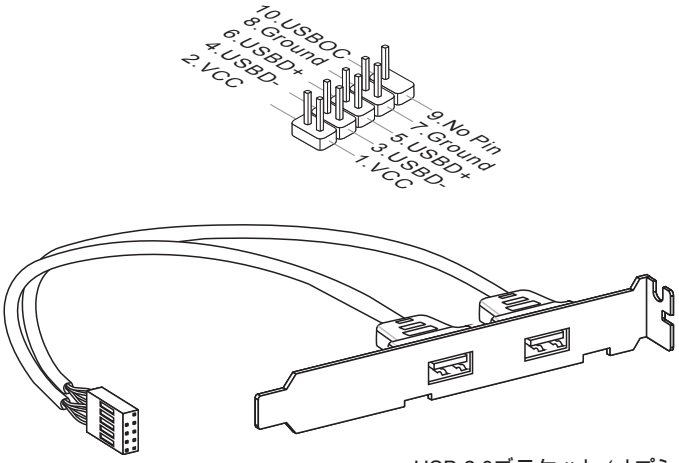




IEEE1394ブラケット (オプション)

フロントUSBコネクター: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

本製品にはインテル® I/O Connectivity Design Guideに準拠したUSB 2.0ピンヘッダーが搭載されています。USBは汎用性が非常に高く、外付けUSB　HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタなど様々な機器の接続に対応しています。



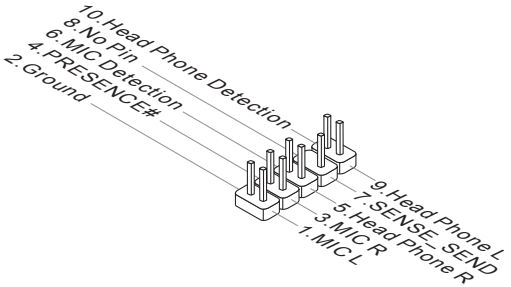
USB 2.0ブラケット (オプション)

注意

VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。

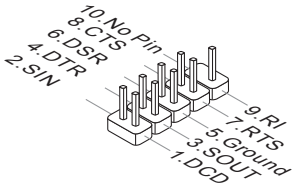
フロントパネルオーディオコネクター: JAUD1

フロントパネルオーディオピンヘッダーを使用するとケースのフロントパネルからのオーディオ出力が可能になります。ピン配列はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。



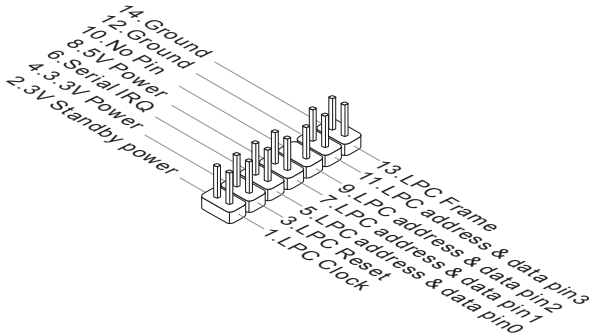
シリアルポートコネクター: JCOM1

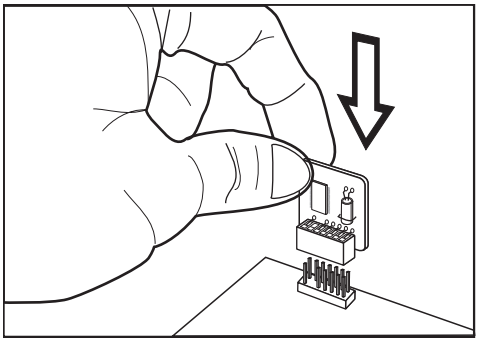
16550Aチップを採用した16バイトFIFOにてデータ転送を行います。このコネクターにシリアルマウスまたは他のシリアルデバイスを接続できます。



TPMモジュールコネクター: JTPM1

このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)モジュール(オプション)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照してください。





ボタン

本製品は以下のボタンを搭載しています。本章ではこのボタンの機能を解説します。

クリアCMOSボタン: CLR_CMOS1

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。



注意

CMOSクリアを行う際は、まずコンセントから電源コードを抜いてください。

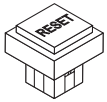
電源ボタン: POWER1

このボタンはシステムを起動/終了します。システムを起動すると、このボタンのライトが点灯しています。システムを終了すると、ライトが消えます。



リセットボタン: RESET1

このボタンはシステムをリセットします。システムがS0状態にすると、このボタンのライトが点灯しています。



スイッチ

オーバークロックFSBスイッチ: EZ OC Switch

このスイッチを変更すると、FSBをオーバークロックしてプロセッサーの周波数を上げることができます。以下の説明に従ってFSBを設定してください。



デフォルト



FSBの速度を
10%上げる



FSBの速度を
15%上げる



FSBの速度を
20%上げる

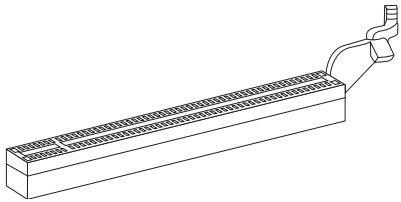
注意

- *このスイッチを変更する前に、必ずシステムの電源を落としてください。*
- *登録中にHWオーバークロックがシステムの不安定あるいはクラッシュを引き起こす場合には、スイッチをデフォルト設定に戻してください。*

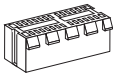
スロット

PCI Expressスロット

PCI ExpressスロットはPCI Expressインターフェース拡張カードをサポートします。



PCI Express x16スロット



PCI Express x1スロット

Hybrid CrossFireX™テクノロジー

Hybrid CrossFireX™テクノロジーはATI社が開発したマルチGPU技術であり、AMD® 785Gオンボードグラフィックスプロセッサーと離散型グラフィックスプロセッサーを同時に動作させることにより、同一のディスプレイに信号を出力して高速のフレームレートに達成し、グラフィックス処理性能を大幅に向上させることができます。

対応システム

1. Hybrid CrossFireX™はVista OSにのみ対応しています。
2. ATI Radeon™ HD 2400 Series[2]、ATI Radeon™ HD 3400 SeriesあるいはATI Mobility Radeon™ HD 3400 Seriesグラフィックスプロセッサーに基づいたグラフィックスカード。
3. AMD® 785G統合チップセットに基づいたマザーボード

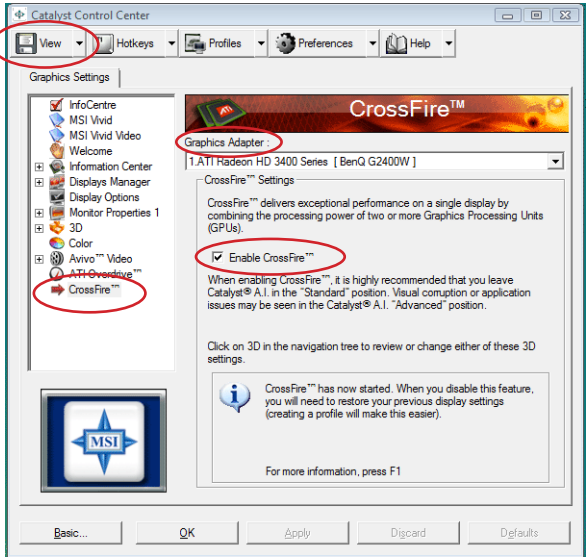
Hybrid CrossFireX™テクノロジーを有効

システムを終了してからHybrid CrossFireX™テクノロジーをサポートするATIグラフィックスカードを挿入してください。Hybrid CrossFireX™のドライバーをインストールした後、システムを再起動してATIアイコンがシステムトレーには表示されます。このアイコンをクリックすると、Catalyst™ Control Centerには以下のように表示されます。



このアイコンをクリックします。

1. まず、[view]の ドロップメニューから[Advanced View]を選択します。



2. それから、Catalyst Control Centerにはの[Graphics Settings]からCrossFire™をクリックしてください。
3. [Graphics Adapter]の一覧表には、Display GPUとして動作するグラフィックスカードを選択します。
4. [Enable CrossFire™]を選択します。
5. 最後に、[Apply]をクロックしてください。

Hybrid CrossFireX™を有効にすると、GPUの加速物理的性能は、Hybrid CrossFireX™が使用しているカードのほかに対して、自動的に無効になります。
詳細についてはAMDのホームページをご参照ください。http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx

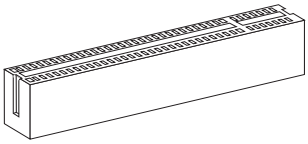
注意

統合グラフィックスメモリ操作モードを変更すると、Hybrid CrossFireX™ の起動が失敗する恐れがあります。この問題を防止するために、以下の説明に従ってシステムを設定して下さい。

- *Catalyst Control Center にはHybrid CrossFireX™ を無効にします。*
- *システムを再起動してBIOSに入ってください。*
- *Advanced BIOS Features -> Chipset Feature -> On-Chip VGAを選択します。*
- *BIOS設定を保存してから、再起動します。*
- *最後に、Catalyst Control Center にはHybrid CrossFireX™ を有効にします。*

PCIスロット

PCIスロットは最も汎用性の高い拡張スロットで、対応する様々な拡張カードが発売されています。拡張カードのセッティング方法については、拡張カードに同梱される説明書を参照してください。



32-bit PCIスロット

注意

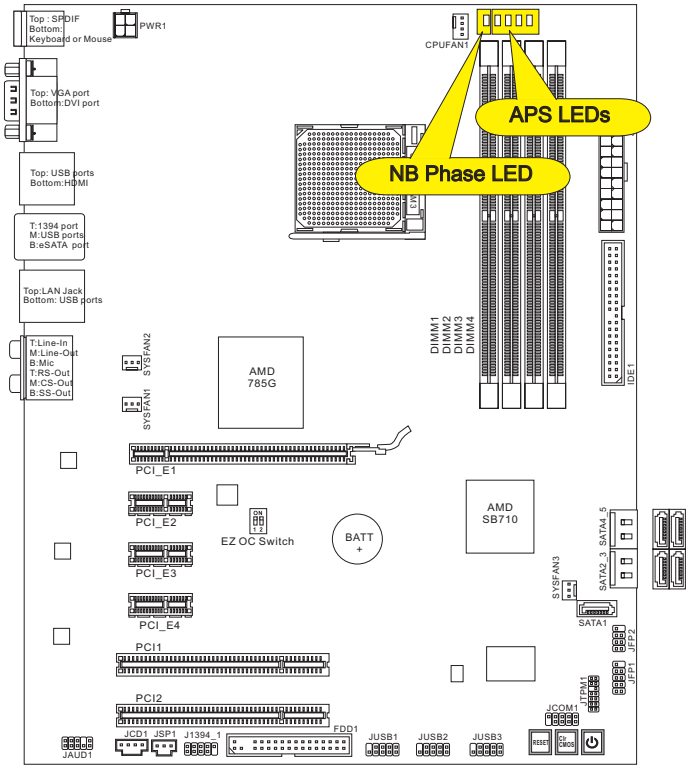
拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。

PCI割り込み要求ルーティング

ハードウェアがCPUに対して割り込み要求信号を発し、PCはこれを受けてデバイスの動作(イベントの発生)を処理します。標準的なPCIバスのIRQ設定は以下の通りです:

	Order1	Order2	Order3	Order4
PCI Slot1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI Slot2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

状態表示LED



APS LED

これらのAPS (Active Phase Switching) LEDは現在のCPU電源回路の動作フェーズ数を表示します。

■: オン, □: オフ

■■■■ CPUが4フェーズで動作している場合、四つのLEDが青く点灯しています。
■■■□ CPUが3フェーズで動作している場合、三つのLEDが青く点灯しています。
■■□□ CPUが2フェーズで動作している場合、二つのLEDが青く点灯しています。
■□□□ CPUが1フェーズで動作している場合、一つのLEDが青く点灯しています。

NBフェーズLED

NBが動作している場合、LEDが青く点灯しています。

BIOSの設定

本章ではBIOS設定について説明します。ユーザーの用途に合ったシステム設定を行うことで、より快適にシステムを使用できるようになります。また、以下に該当する場合は、BIOSセットアッププログラムを起動して設定値を適切な値に変更してください。

- システムの起動中に画面にエラーメッセージが表示され、SETUPを実行するように指示された場合。
- 機能をカスタマイズするために、デフォルト設定を変更する場合。

注意

- *BIOSはパフォーマンスの向上や問題回避のために、継続的に変更/修正が加えられています。そのため、お手元の製品と本書の内容に食い違いが生じてしまう場合があります。予めご了承ください。*
- *システムを起動すると、BIOSバージョンが画面の上側に表示されます。表示されるメッセジーはA7576AMS V1.0 072409のような書式となります。それぞれの意味は:*

  1桁目：AならAMI BIOS、WならAWARD BIOS、PならPHOENIX BIOS

  2 - 5桁目:製品のモデル番号

  6桁目:IならIntelチップセット、NならNVIDIAチップセット、AならAMDチップセット、VならVIAチップセット

  7 - 8桁目：MSIは正式出荷バージョン

  V1.0：BIOSバージョン

  072409：2009年07月24日リリース

BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、<DEL>キーを押してBIOSセットアップ画面を呼び出します。

Press DEL to enter SETUP
(<DEL>キーを押してセットアップ画面を呼び出す)

<DEL>を押す前にこのメッセジーが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。

ヘルプ

BIOS画面内を立ち上げると、最初にメインメニューが表示されます。

メインメニュー

メインメニューにはBIOSが提供する設定項目が各カテゴリー別に表示されます。矢印キー(↑↓)を使って項目を選択してください。カーソルが当たってハイライトされた設定項目の説明(英語)が画面の下部に表示されます。

サブメニュー

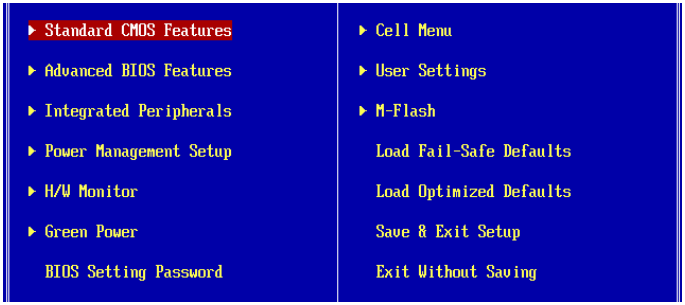
左手に三角が表示されている項目は、サブメニューがあることを示します。サブメニューに入るには項目をハイライトして<Enter>キーを押します。これでサブメニューが表示され、コントロールキーで項目の選択や変更を行います。上位のメニューに戻るには<Esc>キーを押します。

ヘルプキー <F1>

<F1>を押すと使用すべきキーやハイライトされた項目の選択肢の解説がポップアップウィンドウであきます。ヘルプウィンドウを閉じるには、<F1>か<Esc>キーを押してください。

メインメニュー

BIOS　CMOSセットアップユーティリティを開きますと、メインメニューが表示されます。メインメニューのセットアップ機能や終了の設定項目に複数の選択肢があります。矢印で選択し、<Enter>キーを押してサブメニューを表示します。



▸Standard CMOS Features (標準CMOS設定)
日付/時刻などのシステムの基本的な設定を行います。

▸Advanced BIOS Features (拡張BIOS設定)
拡張BIOS機能の設定を行います。

▸Integrated Peripherals (内蔵機能の設定)
IDE、サウンド機能、グラフィック機能などの各種オンボード機能の設定を行います。

▸Power Management Setup (電源管理セットアップ)
電源管理に関する設定を行います。

▸H/W Monitor (H/Wモニター)
PCの状態を表示します。

▸Green Power
動作フェーズ数の確認・設定を行います。

▸BIOS Setting Password (BIOS設定パスワード)
設定変更を制限するためのパスワードを設定します。

▸Cell Menu (セルメニュー)
周波数/電圧のコントロールやオーバークロックの各種設定を行います。

▸User Settings (ユーザー設定)
CMOSへのプロファイル書き込み/ CMOSからのプロファイル読み込みを行います。

▸M-Flash
USBメモリドライブを使ったBIOS更新を行う際に使用します。(FAT/FAT32フォーマットのみ)

▸Load Fail-Safe Defaults (BIOSの初期設定値をロードする)
安定動作を最優先した初期設定値をロードします。

▸Load Optimized Defaults (最適のデフォルト値をロードする)
工場出荷時の設定をロードします。動作の安定性と性能の釣り合いが取れた設定値です。

▸Save & Exit Setup (設定値を保存して終了する)
変更した設定値を保存して終了します。

▸Exit Without Saving (設定値を保存せず終了する)
変更した設定値を保存せず終了します。

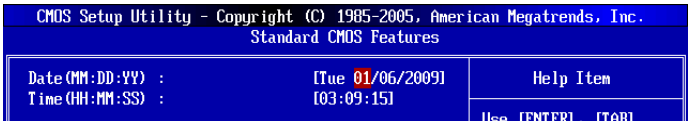
BIOSセットアップユーティリティについて、以下の手順で初期設定を行ってください。

1. Load Optimized Defaults (最適のデフォルト値をロードする) : コントロールキー(↑↓)で[Load Optimized Defaults]フィールドを強調表示します。<Enter>キーを押すと、以下のメッセージが表示されます。

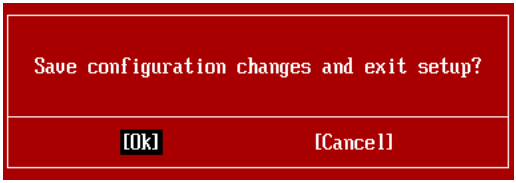


[Ok]キー押すと、工場出荷設定のデフォルト値がロードされます。

2. Setup Date/ Time (日付/時間を設定する) : [Standard CMOS Features]を選択して<Enter>キーを押すと、Standard CMOS Featuresメニューが表示されます。日付/時間を調整します。



3. Save & Exit Setup (設定値を保存して終了する) : コントロールキー(↑↓)で[Save &Exit Setup]フィールドを強調表示します。<Enter>キーを押すと、以下のメッセージが表示されます。



[Ok]を選択して<Enter>キーを押すと、設定を保存してBIOSセットアップユーティリティを終了します。

注意

BIOS設定の詳細について知りたい場合には、英語マニュアルを参照して下さい。

4. Cell Menu Introduction (セルメニューの解説) : 動作周波数や電圧の設定変更を行います。



注意

動作周波数や電圧の設定を変更すると、コンポーネントの消耗を早めたり、場合によっては破損を招くことがあります。本章の項目は変更しないで下さい。

▸Current CPU / DRAM Frequency (現在のCPU/ DRAM周波数)
CPUとメモリスピードの周波数を表示します。読取専用です。

▸CPU Specifications (CPUの仕様)
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUの情報を示します。

▸AMD Cool'n'Quiet
Cool'nQuiet機能を利用することにより、プロセッサーの異常過熱を防ぐとともに、省

エネ低騒音動作にも効果があります。

注意

Cool'n'Quietの機能を使用するには、以下の設定を行う必要があります。

- *BIOSのセットアップ画面を起動し、[Cell Menu]を選択します。[Cell Menu]で[AMD Cool'n'Quiet]を[Enable]に設定してください。*
- *ウインドウを開き、[Start]->[Settings]->[Control Pannel]->[Power Options]を選択してください。そして[Power Options Properties]には[Power schemes]の中で[Minimal Power Management]を選択します。*

▸CPU Technology Support (CPUのテクノロジーサポート)
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジーを示します。読取専用です。

▸Adjust CPU FSB Frequency (MHz) (CPU FSB周波数を調整する)
この項目はCPU FSB周波数を設定します(MHz)。

▸Adjust CPU Ratio (CPU倍率を調整する)
CPUクロック倍率を調整します。本機能をサポートするプロセッサーが搭載された場合には、この項目が有効です。

▸Adjusted CPU Frequency (MHz) (調整したCPU周波数)
調整したCPU周波数を表示します。読取専用です。

▸Adjust CPU-NB Ratio (CPU-NB倍率を調整する)
CPU-NB倍率を調整します。

▸Adjusted CPU-NB Frequency (MHz) (調整したCPU-NB周波数)
調整したCPU-NB周波数を表示します。読取専用です。

▸EC Firmware (ECファームウェア)
この項目は[Advanced Clock Calibration(高級なクロック校正)]のために、ECファームウェアを選択します。追加のコアを解除した場合、[Special]に設定し、そしてプロセッサーコアを動作させるために、[Advanced Clock Calibration(高級なクロック校正)]を[Auto]に設定してください。

▸Advanced Clock Calibration (高級なクロック校正)
オーバークロックのためです。[Enabled]に設定すると、CPU倍率を向上することができます。プロセッサーが本機能をサポートする場合には、この項目が有効になります。

▸Auto OverClock Technology (自動的なオーバークロックテクノロジー)
[Max FSB]に設定すると、システムが自動的に最大のFSBクロックを検知することができます。オーバークロックがうまくいかない場合には、下級FSBクロックを試みってください。

▸MultiStep OC Booster
この項目はオーバークロックよりのBIOSのクラッシュを防止します。

[Disabled]	無効にすると、POSTの間にOC設定を行います。
[Mode 1]	POSTの間にOCを見落としてください。後は、OSをロードしている時最高のOCを行います。
[Mode 2]	OSをロードした後OC設定を行います。

▸MEMORY-Z

<Enter>キーを押すと、サブメニュー画面が表示されます。

▸DIMM1~4 Memory SPD Information (DIMM1~4メモリSPD情報)

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を表示します。

▸Advance DRAM Configuration (高級なDRAM配置)

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸DRAM Timing Mode (DRAMタイミングモード)

この項目は自動的に全てのDRAMタイミングを検知することができます。[DCT 0]、[DCT 1]あるいは[Both]に設定すると、いくらかのフィールドが表示されて選択できます。DCT 0がチャンネルAをコントロールし、DCT1がチャンネルBをコントロールします。

▸CAS Latency (CL)

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。SDRAMが読み込みコマンドを受信した後読み込みを開始するまでのタイミング遅延であるCASレイテンシーを設定します。

▸tRCD

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。RAS(行アドレス信号)とCAS(列アドレス信号)の信号間隔を手動で設定します。一般的にクロックサイクル値が小さいほどDRAMの動作速度が上がります。

▸tRP

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。DRAMがリフレッシュに必要とする電荷を蓄積する時間を手動で設定します。RAS信号のクロック数がこの時間を規定しますが、電荷を蓄積するための時間が足りない場合はDRAMのリフレッシュは不完全になり、DRAMがデータを保持できなくなることがあります。システムに同期DRAMをインストールした場合のみこの項目が利用できます。

▸tRAS

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。RAS(行アドレス信号)が発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▸tRTP

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。この設定はデータ読み込みとプリチャージ命令の時間間隔をコントロールします。

▸tRC

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。RAS(行アドレス信号)の読み込みからプリチャージが完了するまでの 1 サイクルの時間です。通常はTRASとTRPの合計時間を入力します。

▸tWR

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。プリチャージが掛かる前のデータの書込みに要する時間を手動で設定するのがtWRです。この設定ではプリチャージが掛かる前に、書込み

バッファのデータがメモリセルに完全に書き込まれるように設定する必要があります。

▸tRRD

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。異なるメモリバンク間でデータアクセスを行うための遅延時間を手動で設定します。

▸tWTR

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。同じメモリバンク内で処理される書き込み命令から読み取り命令までの間隔時間を手動で設定します。読み取り命令の始める前にI/O gatingがセンス増幅器を増速駆動できます。

▸tRFC0~3

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。RFCを発信してからデータが読み出されるまでの時間です。

▸tWRTTO

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。データが読込みから書込みへの転換時間で、CAS(列アドレス信号)読込みと次の書込みの操作コマンドの最短間隔です。一般的に設定値が小さいほどシステムの動作速度が上がり、不安定になります。メモリモジュールによって設定を行ってください。

▸tWRRD

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。書込みから読込みへの時間で、最初の仮想CAS書込み信号のクロックから次の異なるチップあるいはDIMMのための読込み信号操作の最短間隔です。一般的に設定値が小さいほどシステムの動作速度が上がり、不安定になります。メモリモジュールによって設定を行ってください。

▸tWRWR

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。書込みから書込みへの時間で、最初の仮想CAS書込み信号のクロックから次の有効な終端器を変更した書込み信号操作の最短間隔です。 一般的に設定値が小さいほどシステムの動作速度が上がり、不安定になります。メモリモジュールによって設定を行ってください。

▸tRDRD

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0], [DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。読込みから読込みへの時間で、最初の仮想CAS読込み信号のクロックから次の異なるチップあるいはDIMMのための読込み信号操作の最短間隔です。一般的に設定値が小さいほどシステムの動作速度が上がり、不安定になります。メモリモジュールによって設定を行ってください。

▸DRAM Drive Strength (DRAMドライブ強度)

メモリデータバスの信号強度をコントロールします。オーバークロックの場合には、メモリバスのドライブ強度を増加すると、安定性を上げることができます。

▸DRAM Advance Control (DRAM高級なコントロール)

この項目は自動的にDRAMタイミングを検知することができます。[DCT 0], [DCT 1]あるいは[Both]に設定すると、いくらかのフィールドが表示されて選択します。

▸1T/2T Memory Timing (1T/2Tメモリタイミング)

[DRAM Timing Mode]を[DCT 0]、[DCT1]あるいは[Both]に設定すると、このフィールドが調整できます。ここでSDRAMコマンド率をコントロールできます。[1T]を選択すると、SDRAM信号コントローラーが1T(T=クロックサイクル)単位で制御され、[2T]では2T単位で制御されます。

▸DCT Unganged Mode

この機能は二つの64-bit DCTsを一つの128-bitインタフェースに統合します。

▸Bank Interleaving (バンク交互配置)

バンクインターリーブとはメモリのデータ転送を高速化する技術です。システムが複数のバンクに同時並行で読み書きを行うことによりアクセスを行います。

▸Power Down Enable (省電力モードを有効にする)

これが省電力テクノロジーです。指定された時間内にシステムへのアクセスがなかった場合、自動的にメモリの電源供給を減少します。

▸MemClk Tristate C3/ATLVID

C3/ATLVIDにはMemClk Tristatingを有効/無効にします。

▸FSB/DRAM Ratio (FSB/DRAM倍率)

FSBとメモリクロックを非同期で動作させる場合、本項目で動作比率を設定します。

▸Adjusted DRAM Frequency (MHz) (調整したDRAM周波数)

調整したメモリ周波数を表示します。読取専用です。

▸Onboard VGA Over Clock (オンボードVGAオーバークロック)

オンボードVGAをオーバークロックします。

▸ Onboard VGA Clock (オンボードVGAクロック)

[Onboard VGA Over Clock]を[Enabled]に設定すると、この項目が表示されます。オンボードVGAロックを調整します。

▸HT Link Control (HTリンクコントロール)

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width (HT上り/下りリンク幅)

この項目はHyper-Transport　Linkの幅を設定します。[Auto]に設定すると、システムが自動的にHT linkの幅を検知します。

▸HT Link Speed (HTリンクスピード)

HTリンクスピードを設定します。[Auto]に設定すると、システムは自動的にHTリンクスピードを検知します。

▸Adjusted HT Link Frequency (MHz) (調整したHTリンク周波数)

調整したHTリンク周波数を表示します。読取専用です。

▸Adjust PCI-E Frequency (MHz) (PCI-E周波数を調整する)

PCIE周波数を調整します(MHz)。

▸Auto Disable DRAM/PCI Frequency (DRAM/PCI周波数を自動的に無効にする)

[Enabled]に設定すると、システムは使用していないDRAM/PCIスロットのクロック発信を切り、EMIの発生を軽減する働きがあります。

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)
CPU、メモリとチップセットの電圧を調整します。

▸Spread Spectrum
コンピューターはクロック信号と呼ばれるパルス信号を元に動作しています。クロックジェネレーターがパルス信号を発生する際に、構造上やむを得ずスパイクノイズと呼ばれる電磁妨害(EMI)が生じます。基本的にはボード上の配線の取り回しによってノイズを相殺するように工夫しています。しかし特定環境下において外部にノイズが漏れてしまう場合があり、そのようなケースではスペクトラム拡散方式で信号の波形を変更することで、ノイズの漏れを回避する場合があります。通常は[Disabled]に設定して使用します。また、オーバークロックをかけた状態で使用する場合も[Disabled]に設定してください。

注意

- *特に電波障害などの問題が無い場合は、システムの安定性と性能を確保するために[Disabled]に設定して下さい。また、電波障害などが発生した場合は、必ず[Enabled]に設定して障害の軽減に努めて下さい。*
- *Spread Spectrumの値は大きければ大きいほどノイズ除去効果が高まりますが、システムの安定度は低下します。*
- *オーバークロック動作実験をする場合は、必ず[Disabled]に設定してください。*

注意

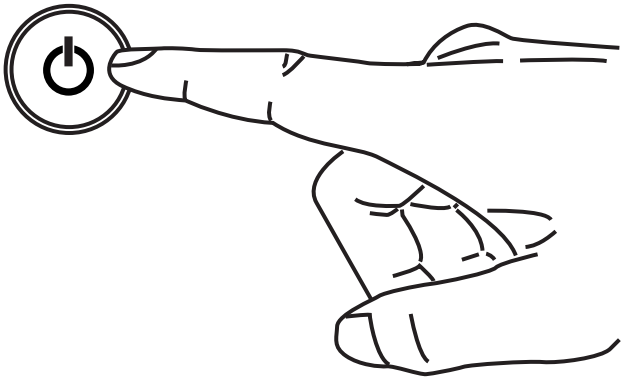
Failed Overclocking Resolution (オーバークロックがうまくいかない場合)

本製品は多彩なオーバークロック設定をサポートします。しかしながら、オーバークロック実験の成功にはCPUをはじめ温度や電圧など実に様々な要素が影響する上に定格以外の設定で動作させることはあらゆるコンポーネントにダメージを与える可能性があります。不適切な操作や設定原因でシステムを破損した場合は、製品保証の対象外です。

Two ways to save your system from failed overclocking... (オーバークロック失敗後にシステムを復旧する方法...)

- *Reboot (再起動)*

  システムを再起動するために、電源ボタンを3回も押してください。連続した電源のON/OFFは機器に悪影響を与えます。再起動する場合は10秒以上の間隔を空けて下さい。



4回目の再起動でもシステムが正常動作できない場合、前回設定に問題があったとシステムが判断し、自動的にデフォルト設定値を復元します。以下のメッセージが画面に表示される場合は、何かキーを押して進めて下さい。

```
Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....
```

- *Clear CMOS (CMOSをクリア)*

  CMOSデータ消去の詳細については[CMOSデーターの消去]章を参照してください。

ソフトウェアの情報

本製品にはドライバー/ユーティリティDVDが同梱されています。OSのインストールが終了したら、全てのドライバーのインストールし、セットアップを完了させてください。ユーティリティソフトはユーザーのニーズに応じてインストールしてください。ドライバー/ユーティリティDVDには以下の内容が含まれています。

- Driver menu : 使用できるドライバーを表示します。要望によってドライバーをインストールし、デバイスを起動します。
- Utility menu : サポートのソフトウェアアプリケーションを表示します。
- WebSite menu : 必要なウェブサイトを表示します。

注意

MSIのホームページから最新のドライバーやBIOSを入手することができます。

785G-E65 系列

繁體中文

Asia version

主機板規格

支援處理器

■ 支援 AM3 架構的 AMD® Phenom™ II X4/ X3 以及 Athlon™ X4/ X3/ X2 系列處理器
(欲知更多 CPU 相關訊息，請參閱微星科技網站
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

■ 支援 HyperTransport(HT) 3.0 技術, 支援達每秒 5.2 GT/s

晶片組

■ 北橋: AMD® 785G 晶片組
■ 南橋: AMD® SB710 晶片組

記憶體

■ DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*表示超頻) SDRAM (支援總合最高 16GB)
■ 4 條 DDR3 DIMM (240pin / 1.5V)
(有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站:
http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

■ 由 Realtek® RTL 8111DL 支援 PCIE LAN 10/100/1000 快速乙太網路

IEEE 1394 (選配)

■ 由 VIA® VT6315N 晶片整合
■ 傳輸速率達每秒 400Mb

音效

■ 由 Realtek® ALC888S/ ALC889 整合晶片
■ 支援 8 聲道輸出
■ 符合 Azalia 1.0 規格

IDE

■ 由 AMD® SB710 支援 1 個 IDE 連接埠
■ 支援 Ultra DMA 66/100/133 模式
■ 支援 PIO 以及主控匯流排操作模式

SATA

■ 由 AMD® SB710 支援 5 個 SATAII 連接埠
■ 支援儲存及資料傳輸率達每秒 3.0 Gb

E-SATA

■ 由 AMD® SB710 支援 1 個 E-SATA 連接埠
■ 支援儲存及資料傳輸率達每秒 3.0 Gb

RAID

■ 由 AMD® SB710 控制的 SATA 1~5 連接埠支援 RAID 0/ 1/ 10/ JBOD 模式

軟碟機

■ 1 台軟碟機
■ 支援 1 台 360KB、720KB、1.2MB、1.44MB 及 2.88MB 規格的軟碟機

接頭

■ 背板
- 1 個 PS/2 連接埠
- 1 個光纖 S/PDIF-out 連接埠
- 1 個 VGA 連接埠
- 1 個 DVI-D 連接埠
- 1 個 HDMI 連接埠
- 1 個 IEEE 1394 連接埠 (選配)
- 6 個 USB2.0 連接埠
- 1 個 eSATA 連接埠
- 1 個區域網路接頭
- 6 個音效接頭

■ 內建接頭
- 3 個 USB2.0 接頭
- 1 個 IEEE 1394 接頭 (選配)
- 1 個光纖 S/PDIF-out 接頭
- 1 個 CD-In 接頭
- 1 個前置面板音效接頭
- 1 個機殼開啟警告開關接頭
- 1 個序列埠接頭
- 1 個 TPM 接頭
- 1 個超頻開關
- 1 個電源 LED 鈕
- 1 個重設 LED 鈕
- 1 個清除 CMOS 按鈕

插槽

- 1 個 PCI Express x16 插槽
- 3 個 PCI Express x1 插槽
- 2 個 PCI 插槽, 支援 3.3V/ 5V PCI 匯流排

尺寸

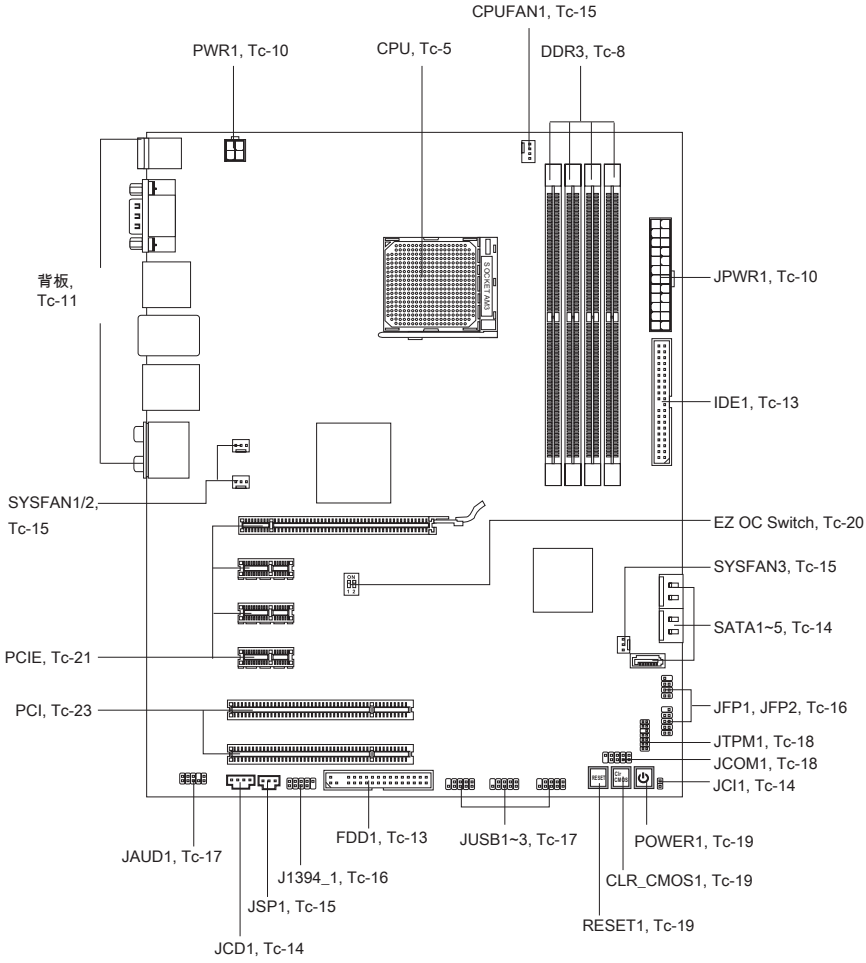
■ ATX (30.5 公分 X 24.4 公分)

裝機

■ 9 個裝機孔

如須了解附件之型號以便進行選購，請至以下網頁依產品名稱搜尋：
http://tw.msi.com

快速零組件指南


CPUFAN1, Tc-15
PWR1, Tc-10
CPU, Tc-5
DDR3, Tc-8
背板,
Tc-11
JPWR1, Tc-10
IDE1, Tc-13
SYSFAN1/2,
Tc-15
EZ OC Switch, Tc-20
SYSFAN3, Tc-15
SATA1~5, Tc-14
PCIE, Tc-21
PCI, Tc-23
JFP1, JFP2, Tc-16
JTPM1, Tc-18
JCOM1, Tc-18
JCI1, Tc-14
JAUD1, Tc-17
FDD1, Tc-13
JUSB1~3, Tc-17
POWER1, Tc-19
J1394_1, Tc-16
CLR_CMOS1, Tc-19
JSP1, Tc-15
RESET1, Tc-19
JCD1, Tc-14

CPU (中央處理器)

安裝 CPU 時，請確認附有散熱風扇，以避免 CPU 過熱。若無散熱風扇，請向經銷商洽購。並在開機前，先將風扇正確地安裝在主機板上。
有關更多 CPU 的最新訊息，請至微星科技網站：
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

注意事項

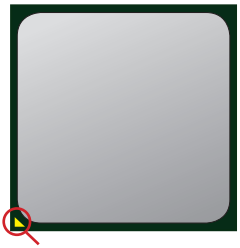
溫度過高
溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及系統。請確保散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。請於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏或貼上耐溫膠帶以加強散熱。

更換 CPU
更換 CPU 時，應先關掉 ATX 電源開關或拔掉電源線，以免損壞 CPU。

超頻使用
即使本主機板設計為可超頻運作，但在將其調整為超頻運作時，請確認系統零組件可承受此異常設定。任何在非本產品規格建議下的操作，我們均不保證其造成的損壞及操作時的風險。

AM3 CPU 簡介

圖為 CPU 表面。請於 CPU 的表面塗上散熱膏幫助散熱。



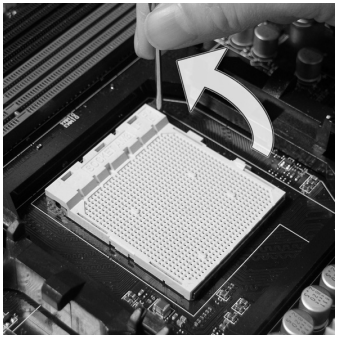
黃色箭頭

安裝中央處理器與散熱風扇

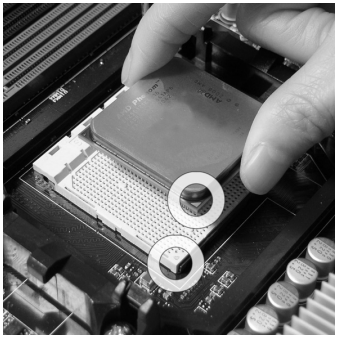
在安裝中央處理器時，為避免過熱，請確認購買的中央處理器，是否隨附一顆散熱風扇。安裝前先於中央處理器上塗抹散熱膏以助散熱。

請依下列步驟，正確地安裝中央處理器與散熱風扇。錯誤的安裝會使中央處理器與主機板受損。

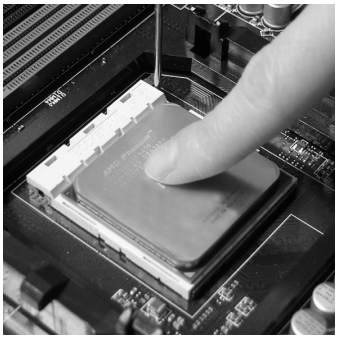
1. 將側邊的拉桿從插座拉起，再將拉桿上拉至 90 度角。



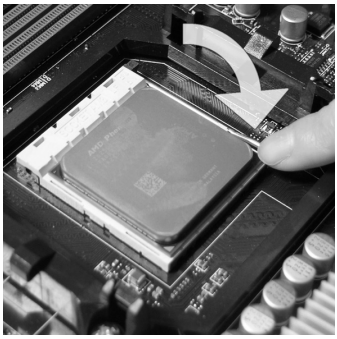
2. 找出 CPU 上的箭頭標記。CPU 的安裝，僅能以一正確方向插入。



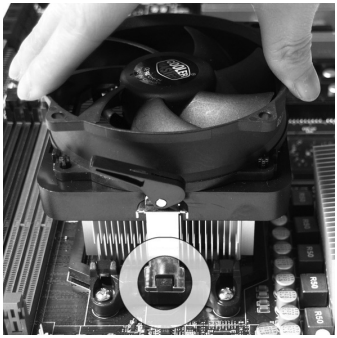
3. 若 CPU 安裝無誤，插梢應完全地進入插座內，且看不到插梢。請注意，CPU 安裝錯誤，可能會造成主機板永久毀損。



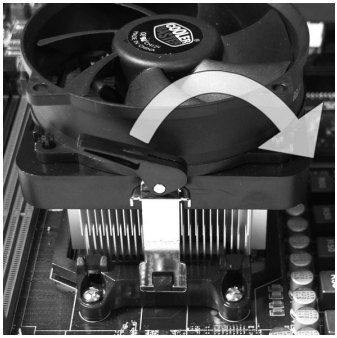
4. 壓下拉桿完成安裝。在壓下拉桿時，CPU 可能會移動，請緊按住 CPU 上方，確定插座的拉桿，完全地插入插座內。



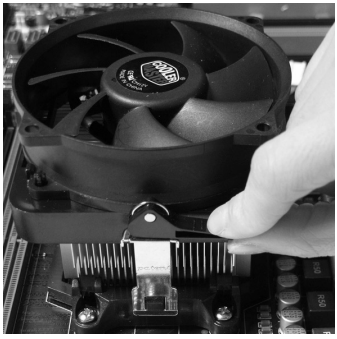
5. 將風扇放置在風扇底座上。
先將扣具的一端扣上。



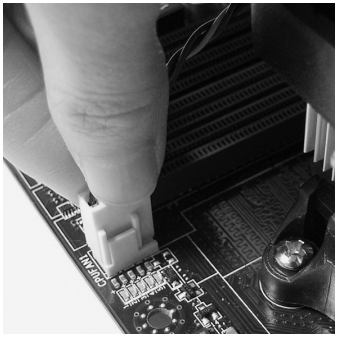
6. 再將扣具的另一端扣上，讓使風扇底座，緊密地固定在主機板上。
找到固定桿，並將其拉起。



7. 將固定桿壓下。



8. 將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇接頭。

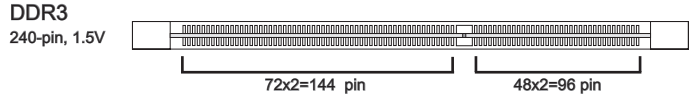


注意事項

- *本節主機板圖片，僅供中央處理器及散熱風扇示範用。該圖示可能會與您購置的主機板外觀有所差異。*
- *若要鬆開安全鉤，請務必小心手指；因為當安全鉤未扣好固定栓時，固定桿所產生的反彈力道，可能會彈到您的手指。*

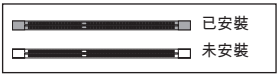
記憶體

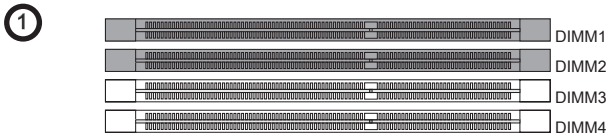
主機板上的 DIMM，是用來裝記憶體模組。
有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站：
http://www.msi.com/index.php?func=testreport



雙通道記憶體通則

雙通道模式下，記憶體模組可用二條匯流排同時傳送及接收資料。開啟雙通道模式可加強系統效能。有關雙通道模式下分配通則，請參考如下圖示。







注意事項

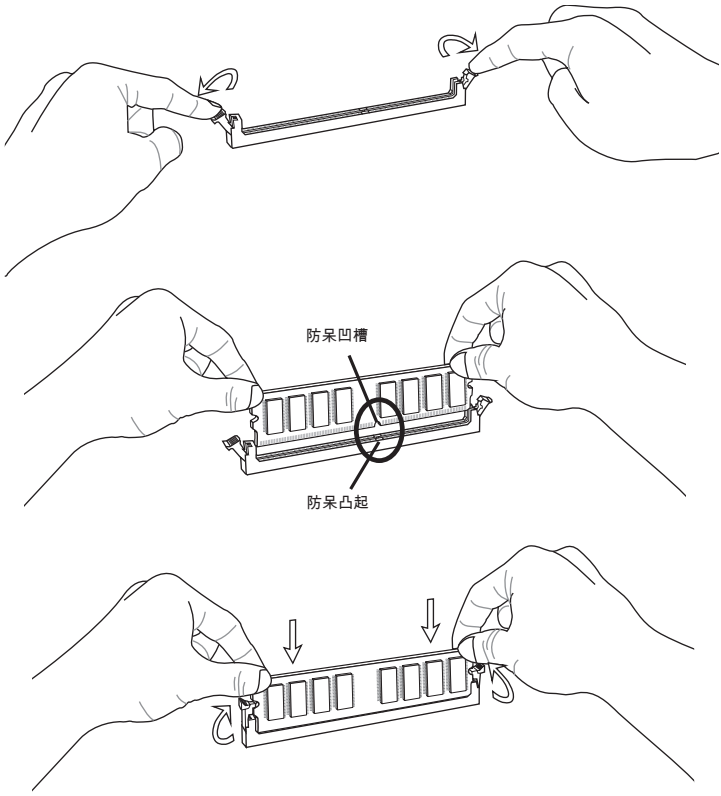
- *DDR3 記憶體模組，無法與 DDR2 互換且無法向下相容。因此請在 DDR3 插槽內，插入 DDR3 記憶體模組。*
- *要使用雙通道模式，請確認已於不同通道的記憶體插槽，安裝同密度容量及同廠牌的記憶體。*
- *請先將記憶體插入 **DIMM1 插槽**，以確保系統正常開機。*
- *因晶片配置的緣故，在每個 DIMM 模組安裝 4GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 15+ GB 的容量 (而非 16GB 整)。*

安裝記憶體模組

1. 記憶體模組上只有一個防呆凹槽。模組只能以一種方向安裝。
2. 將記憶體模組垂直插入插槽，直到記憶體模組上的金手指，牢固地插入插槽內。在記憶體模組已正確地固定後，上槽兩側的塑膠卡榫會自動卡上。
3. 手動檢查是否記憶體模組已經固定在適當的位置。

注意事項

若已正確地將記憶體模組插入該插槽的話，應看不見金手指。

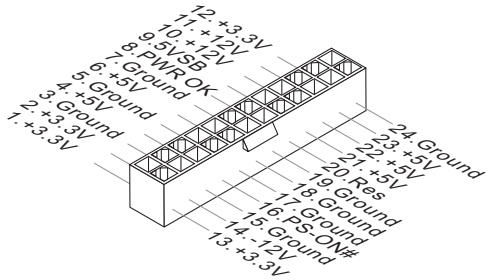


電源供應器

ATX 24-pin 電源接頭：JPWR1

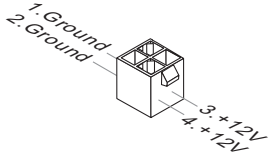
本接頭用來接 ATX 24-pin 電源供應器。連接該電源時，請確認電源接頭插入的方向正確且對準腳位，再將電源接頭緊密地壓入接頭內。

您亦可使用 ATX 20-pin 電源，安裝該電源時，請確認電源插頭插入腳位對準 pin1 及 pin13。



ATX 4-pin 電源接頭：PWR1

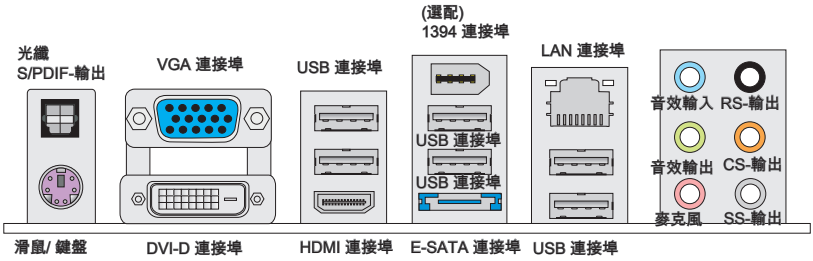
本電源接頭提供 12V 電壓給 CPU 使用。



注意事項

- *確認所有接頭均接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。*
- *建議使用 350 瓦或以上電源，有助系統穩定性。*

背板



▸滑鼠/ 鍵盤

標準 PS/2® 滑鼠/鍵盤的 DIN 接頭，可接 PS/2® 滑鼠/鍵盤。

▸USB 連接埠

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的設備。

▸VGA 連接埠

DB15-pin 的母接頭為接顯示器使用。

▸DVI-D 連接埠

DVI-D (數位影像介面)連接埠，是用來連接 LCD螢幕。DVI-D 連接埠可提供電腦與螢幕間的高速數位通訊。只要將 LCD 螢幕的排線接到 DVI-D 連接埠，並確定另一端已接到螢幕即可(若需更多訊息，請參閱螢幕使用手冊)。

▸光纖 S/PDIF-Out 連接埠

S/PDIF (Sony & Philip Digital Interconnect Format) 連接器，是透過光纖排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

▸HDMI 連接埠

即高畫質多媒體介面(HDMI)，是一種全數位化影像/聲音傳輸介面，可以傳送無壓縮的音效信號及視訊信號。HDMI 支援任何電視格式，包括標準、加強，或高畫質視訊畫面，以及單一排線上的多聲道數位音效。

▸1394 連接埠 (選配)

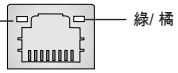
位於主機板的背板的 IEEE1394 埠，可連接 IEEE1394 裝置。

▸E-SATA 連接埠

E-SATA 連接埠是用來外接 E-SATA 硬碟。

▸LAN 連接埠

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。您可直接將網路線接到本連接埠。



LED	顏色	LED 狀態	說明
左	黃	Off	LAN 連線未建立
		On(穩定狀態)	LAN 連線已建立
		On(發亮且閃爍中)	電腦正透過網路連接到另一台電腦
右	綠	Off	資料傳輸速率為每秒10 Mbit
		On	資料傳輸速率為每秒100 Mbit
	橘	On	資料傳輸速率為每秒1000 Mbit

▸音效埠

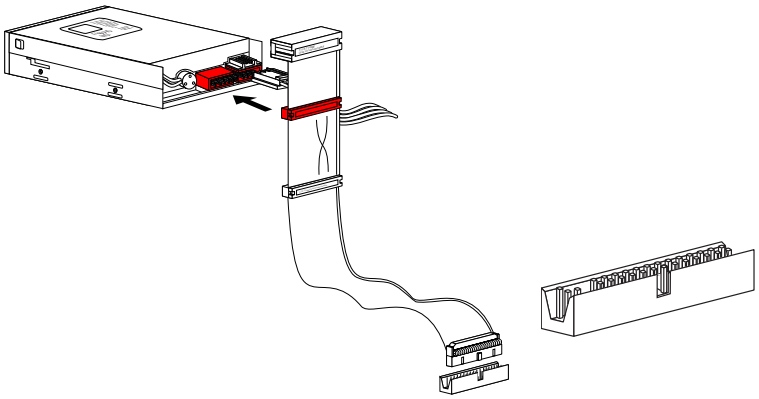
音效接頭供音效裝置使用，可由顏色來區分不同音效。

- 音效輸入(藍) - 音效輸入，是供外接 CD 播放機、錄音機或其他音效裝置使用。
- 音效輸出 (綠) - 音效輸出是連接喇叭或耳機。
- 麥克風 (粉紅) - 本接頭是接麥克風使用。
- RS-輸出(黑) - 後置環繞音效輸出在 4/5.1/7.1 聲道模式。
- CS-輸出(橘) - 中置/重低音輸出在 5.1/7.1 聲道模式。
- SS-輸出(灰) - 側置環繞音效輸出在 7.1 聲道模式。

接頭

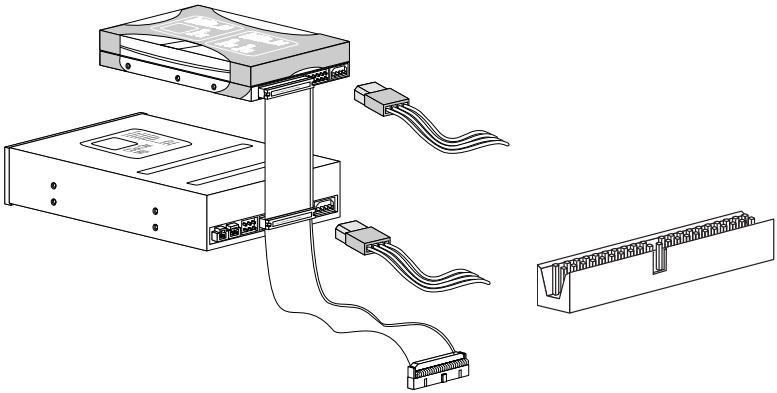
軟碟機接頭：FDD1

本軟碟機接頭，可支援 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB 及 2.88MB 等規格的軟碟機。



IDE 接頭：IDE1

本接頭可接硬碟、光碟機及其他 IDE 裝置。

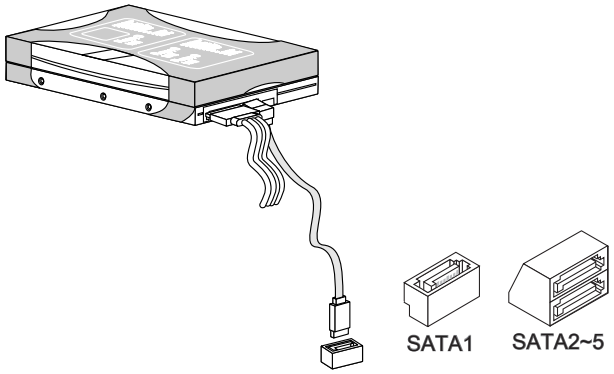


注意事項

若在同一條排線上安裝兩組硬碟，須依硬碟的跳線，將硬碟設為排線選擇模式或將硬碟個別指定到主要/次要模式。請參考硬碟廠商提供之說明文件來設定跳線。

Serial ATA 接頭：SATA1~5

本接頭為高速 Serial ATA 介面，可各接一台 Serial ATA 裝置。

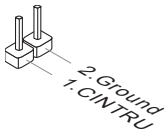


注意事項

請勿摺疊 Serial ATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。

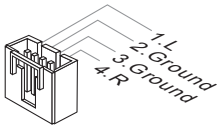
機殼開啟警告開關接頭：JCI1

本接頭接到機殼開啟開關排線。在機殼被打開時，會啟動機殼開啟機制，系統會記錄該狀態，並於螢幕上顯示警告訊息。請進入 BIOS 設定程式中清除此紀錄訊息。



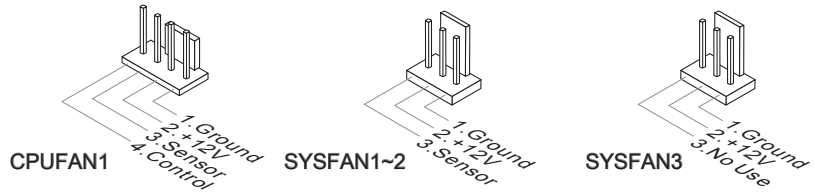
CD-In 接頭：JCD1

本接頭接外接音效。



風扇電源接頭：CPUFAN1, SYSFAN1~3

電源風扇接頭均支援 +12V 散熱風扇。在將電線接到接頭時，請切記紅線是正極，務必要連接到 +12V；而黑線是接地線，須連接到 GND。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，須使用具速度感應器設計之風扇，方能使用 CPU 風扇控制功能。

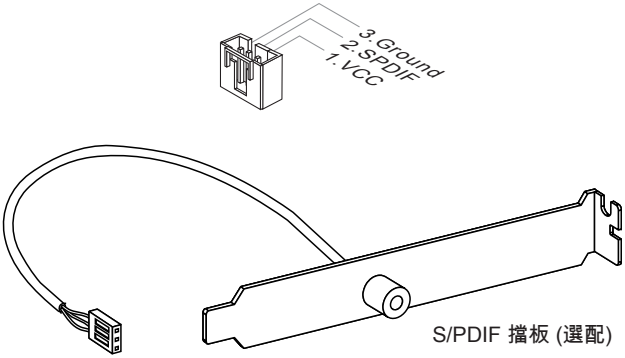


注意事項

- *請上處理器之官方網站參考建議之 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇合適的 CPU 散熱風扇。*
- *CPUFAN1 支援風扇控制功能。請安裝 **Overclocking Center** 工具程式，會根據 CPU 的實際溫度，來控制 CPU 散熱風扇的速度。*
- *CPUFAN1 可使用 3 個或 4 個針角的散熱風扇。*

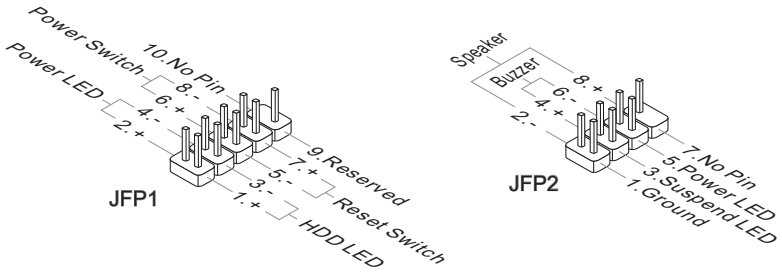
S/PDIF-Out 接頭：JSP1

本接頭可接到 S/PDIF (Sony & Philip Digital Interconnect Format) 介面，來傳輸數位音效。



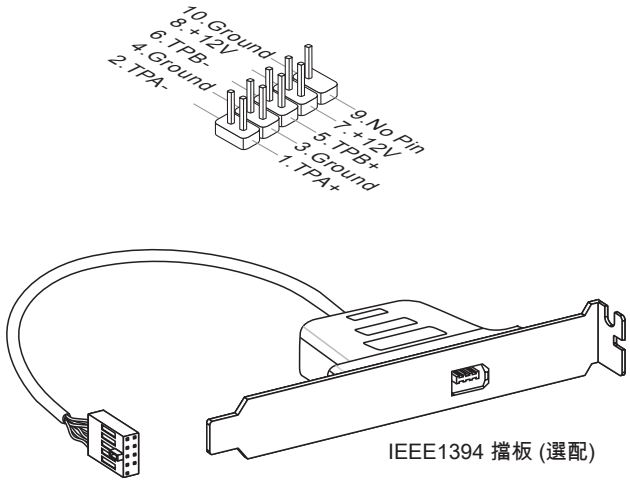
面板接頭：JFP1, JFP2

本接頭接到面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規格。



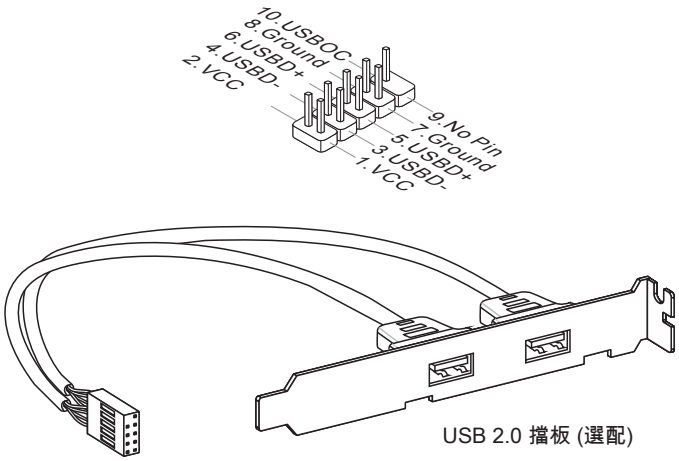
IEEE1394 接頭：J1394_1 (選配)

本連接器是透過另行選配的 IEEE1394 擋板，來連接 IEEE1394 裝置。



USB 接頭：JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

本接頭規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規格，適用於高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。



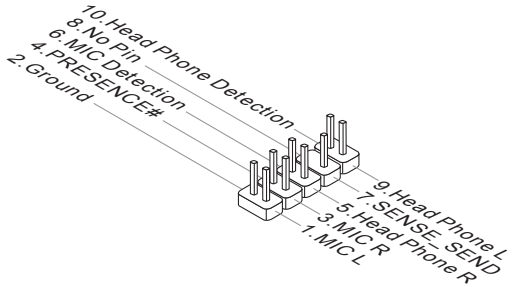
USB 2.0 擋板 (選配)

注意事項

請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。

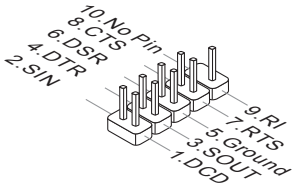
面板音效接頭：JAUD1

本接頭接到面板音效，且規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規格。



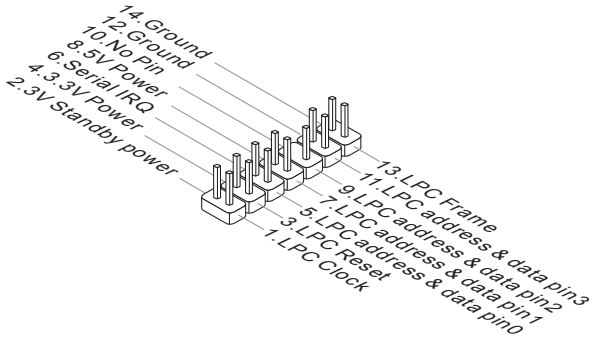
序列埠接頭：JCOM1

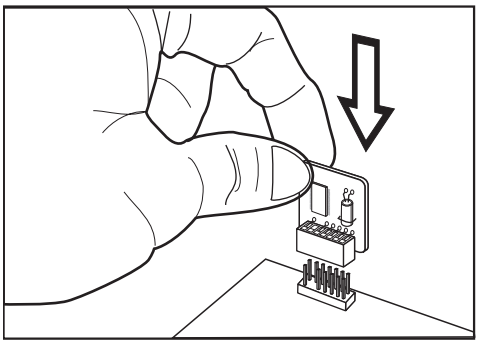
本接頭可傳送/接收 16 位元組 FIFO 的 16550A 高速通信埠。您可直接接上序列滑鼠或是其他序列裝置。



TPM 接頭：JTPM1

本接頭接到可信任安全模組(選配)。更多詳情請參閱 TPM 安全平台使用手冊。



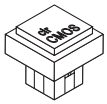


按鈕

本主機板提供下述按鈕，來設定電腦功能；本節會說明如何使用按鈕來調整主機板功能。

清除 CMOS 按鈕：CLR_CMOS1

主機板上有一個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。請使用本鈕來清除系統設定。



注意事項

請在清除 CMOS 資料前，先確認已關機。

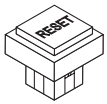
電源鈕：POWER1

本鈕是用來開機或關機。本鈕在開機時會亮，關機時則不亮。



重開機鈕：RESET1

本重開機鈕是用來重新開機。本鈕在 S0 狀態時會亮。



開關

本主機板提供下列開關，來設定電腦功能；本節會說明如何使用開關來調整主機板功能。

超頻 FSB 開關：EZ OC Switch

您可藉更改本關關，超頻 FSB 來增加處理器頻率。請依下列指示設定 FSB。



預設值



增加 10% FSB 速度



增加 15% FSB 速度



增加 20% FSB 速度

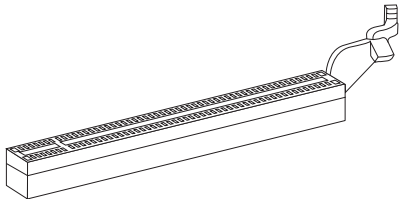
注意事項

- *在設定本開關前，先行確認已關機。*
- *若硬體超頻於開機時造成系統不穩或當機，會於開機自我測試 POST 顯示以下訊息。此時請將本開關設為預設值。*

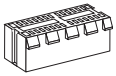
插槽

PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

PCI Express 插槽支援 PCI Express 介面的擴充卡。



PCI Express x16 插槽



PCI Express x1 插槽

Hybrid CrossFireX™ 技術

Hybrid CrossFireX™ 技術可結合 AMD® 785G 內建圖形處理器與獨立的圖形處理器同時運算，帶來多顆 GPU 的效能以達極速的 frame rate，在單一顯示器上一舉將繪圖效能傾洩而出。

系統需求

1. Hybrid CrossFireX™ 僅支援於 Vista 作業系統中。
2. 以 ATI Radeon™ HD 2400 系列、ATI Radeon™ HD 3400 系列為基礎的繪圖卡或 ATI Mobility Radeon™ HD 3400 系列繪圖處理器。
3. 內建 AMD® 785G 整合晶片組的主機板。

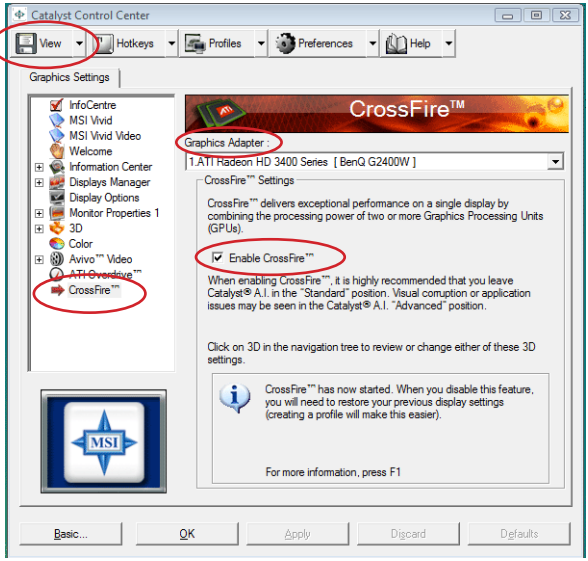
啟用 Hybrid CrossFireX™ 技術

系統關機並安裝支援 Hybrid CrossFireX™ 技術的 ATI 繪圖卡。再開機安裝支援 CrossFireX™ 的驅動程式。重新開機並等待快捷列出現圖示。點選該圖示即會出現 Catalyst Control Center 畫面：



按本圖示

1. 選擇「檢視」下的「進階檢視」。



2. 請於 Catalyst Control Center 下的「圖形設定」選單中選取 CrossFire™。
3. 在「圖形配接卡」表單中選取作為顯示 GPU 的顯卡。
4. 勾選 「啟用 CrossFire™」。
5. 按「套用」。

在 Hybrid CrossFireX™ 啟用後，除了正在執行 Hybrid CrossFireX™ 的顯示器之外，GPU Accelerated Physics 以及其它顯示器都會自動停用。
欲知更多詳情請參考以下 AMD 官方網站：
http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx

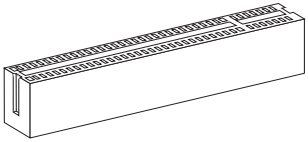
注意事項

更改內建繪圖卡操作模式可能會導致 Hybrid CrossFireX™ 失敗。請依以下步驟設定系統以避免失敗：

- *於 Catalyst Control Center 關閉 Hybrid CrossFireX™。*
- *重開機進 BIOS。*
- *請在AdVanced BIOS Features「進階 BIOS 功能」-> Chipset Feature「晶片功能」-> On-Chip VGA「內建 VGA」中選一個需要的選項。*
- *儲存 BIOS 設定再重開機。*
- *再一次於 Catalyst Control Center 啟用 Hybrid CrossFireX™。*

PCI 插槽

PCI 插槽支援網卡、SCSI 卡、USB 卡及其它符合 PCI 規格的外接卡。.



32-bit PCI 插槽

注意事項

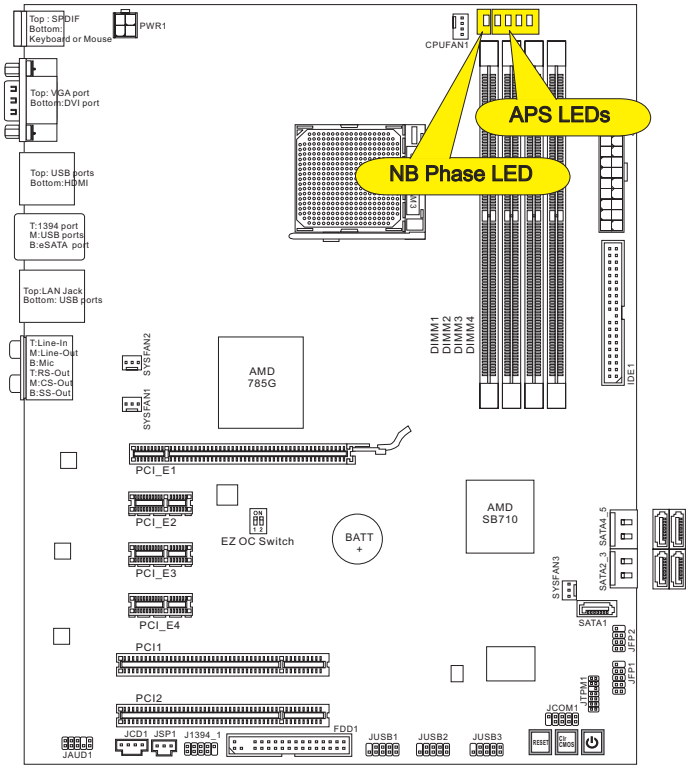
新增或移除擴充卡時，請確認已將電源線拔掉。另外，請詳讀擴充卡的使用說明，確認在使用擴充卡時所需變更如跳線、開關或 BIOS 設定等軟硬體設定。

PCI 的中斷要求

IRQ 是中斷要求 (Interrupt request line) 的英文縮寫，是個可讓裝置傳送中斷訊號至微處理器的硬體線路。PCI 的 IRQ 腳位，通常都連接到 PCI 匯流排腳位，如下表所示：

	順序1	順序2	順序3	順序4
PCI 插槽1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI 插槽2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

LED 燈號說明



APS 燈號 (APS LEDs)

APS (動態相位切換) 燈號表目前 CPU 電源相位模式。請依以下說明讀取狀態。

■ : 亮, □ : 不亮

■■■■ CPU 在 4 相電源模式時，會有 4 顆 LED 亮藍燈
■■■□ CPU 在 3 相電源模式時，會有 3 顆 LED 亮藍燈
■■□□ CPU 在雙相電源模式時，會有 2 顆 LED 亮藍燈
■□□□ CPU 在單相電源模式時，會有 1 顆 LED 亮藍燈

北橋相位燈號 (NB Phase LED)

亮藍燈表北橋晶片運作中。

BIOS 設定

本章節提供關於 BIOS 設定程式的資訊，讓您將系統效能最佳化。如有下列狀況，請執行此 BIOS 設定程式：

- 系統開機時出現錯誤訊息，並要求執行 BIOS 設定程式。
- 使用者欲改變 BIOS 預設值，另作個人化設定。

注意事項

- *為達最佳效能，我們會持續更新 BIOS 的內容和項目。因此，本章所描述的內容，可能和實際主機板上的所見的 BIOS 內容有所出入。故本章中所提及的設定項目僅供參考。*
- *開機後，系統在完成記憶體容量計算後，會在第一行顯示如下訊息：*

A7576AMS V1.0 072409 where:

第一個字元 A 表示此程式源頭由 AMI 公司提供; W 表示此程式源頭由 AWARD 公司提供; P 表示此程式源頭由 PHOENIX 公司提供

第二~五字元 表本主機板型號

第六字元 I 表示 Intel 晶片; N 表 NVIDIA 晶片; A 是 AMD 晶片 V 是 VIA 晶片

第七~八字元 MS 表示一般客戶

V1.0 表 BIOS 版本

072409 表 BIOS 發行日期

進入設定

開機後，系統就會開始POST (開機自我測試)程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 <DEL> 鍵，進入設定程式。

Press DEL to enter SETUP
(按 DEL 鍵進入設定)

若此訊息在您反應前就已消失，而您還想要進入設定時，請將系統關閉，再重新啟動，或是按 RESET 鍵。亦可同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵重新開機。

操作說明

在進入設定程式後，首先出現主選單的畫面。

主選單

主選單顯示 BIOS 支援的設定類別。請使用方向鍵 (↑↓) 來選擇項目。螢幕下方會顯示反白設定功能的線上說明。

子選單

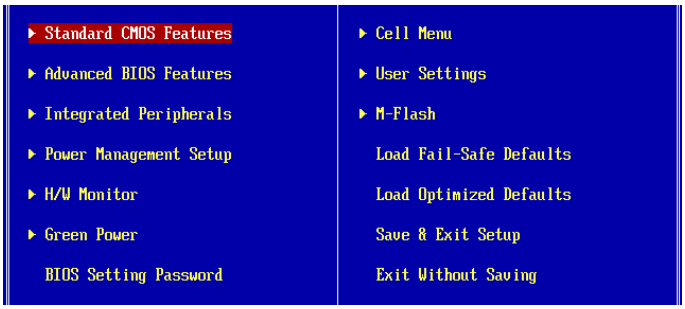
若看到往右的指標出現，表示仍有相關設定的子選單於其下可供選擇。
請使用方向鍵 (↑↓) 來選取欄位，並按<Enter>，叫出該子選單。然後用控制鍵，於子選單中輸入數值及移動欄位。若想回到主目錄，只需按下 <Esc> 即可。

一般求助 <F1>

BIOS 設定程式提供一般求助的畫面，你可於任何選單中，按下 <F1> 叫出。求助畫面會列出反白欄位的可用選項及按鍵供您選擇。按 <Esc>，即可跳出求助視窗。

主選單

進入 BIOS CMOS 設定公用程式後即出現主選單。您可利用方向鍵於下列設定選項中選擇，再按下<Enter>鍵接受該選項後進入子選單。



▸**Standard CMOS Features (標準 CMOS 功能)**
使用本選單設定基本的系統組態，例如時間、日期等。

▸**Advanced BIOS Features (進階 BIOS 功能)**
使用本選單設定特殊的進階功能。

▸**Integrated Peripherals (整合型週邊)**
使用本選單設定整合型週邊裝置。

▸**Power Management Setup (電源管理設定)**
使用本選單設定電源管理。

▸**H/W Monitor**
本選單顯示 PC Health 狀態。

▸**Green Power**
本選單可指定電源相位。

▸**BIOS Setting Password (設定 BIOS 密碼)**
使用本選單設定 BIOS 密碼。

▸**Cell Menu**
本選單可指定頻率及電壓控制。

▸**User Settings (使用者設定)**
使用本選單儲存自訂設定到 BIOS CMOS 或由 BIOS CMOS 載入。

▸**M-Flash**
使用本選單由儲存裝置 (FAT 或 FAT32 格式) 讀取或 flash BIOS。

▸Load Fail-Safe Defaults (載入安全預設值)
本選單載入 BIOS 出廠預設值。

▸Load Optimized Defaults (載入最佳預設值)
使用本選單載入 BIOS 的最佳預設值，以獲穩定的系統效能。

▸Save & Exit Setup (儲存並離開設定)
將變更儲存到 CMOS，並離開設定程式。

▸Exit Without Saving (離開但不儲存)
放棄所有變更並離開設定程式。

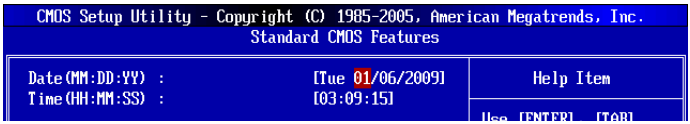
要執行一般使用，請在進入 BIOS 設定公用程式後，請依下列步驟進行。

1. 載入最佳預設值: 使用上下鍵 (↑↓) 反白「載入最佳預設值」欄位，再按 <Enter> 會出現下面的訊息：

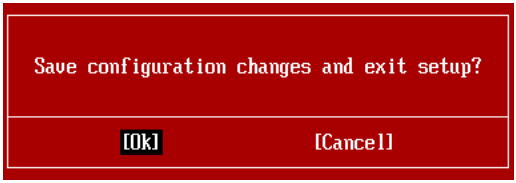


選擇 [Ok]，再按<Enter>，即可載入展現系統最佳效能的預設值。

2. 設定日期及時間: 選擇「標準 CMOS 功能」，再按<Enter>進入該選單來調整日期及時間。



3. 儲存後離開設定: 使用上下鍵反白「儲存後離開設定」欄位，再按 <Enter> 會出現下面的訊息：



選擇 [Ok]，再按<Enter>，即可儲存設定後離開 BIOS 設定公用程式。

注意事項

上述設定僅供一般設定使用，若需詳細 BIOS 設定，請參閱微星科技網站上之英文手冊內容。

4. Cell Menu 簡介: 本選單提供給要超頻主機板的進階使用者。



注意事項

除非對晶片組功能非常熟悉，否則請勿任意變更設定。

▸Current CPU / DRAM Frequency (目前 CPU / 記憶體頻率)

上述選項顯示目前 CPU 及記憶體速度的時脈。唯讀。

▸CPU Specifications (CPU 規格)

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。本子選單顯示已安裝的 CPU 訊息。

▸AMD Cool'n'Quiet

本技術有效及大幅減低 CPU 轉速及電源損耗的情形。

注意事項

為確保 Cool'n'Quiet 功能已啟用且正常運作，請再次確認以下二點：

- *執行 BIOS 設定，選擇 **Cell Menu**。並在該選項下，將 **AMD Cool'n'Quiet** 選項設為開啟 [Enabled]。*
- *進入 Windows 選擇「開始」->「所有程式」->「控制台」->「電源選項」。進入「**電源選項內容**」頁籤，在「**電源配置選項**」選 「**最小電源管理**」。*

▸CPU Technology Support (CPU 支援技術)

按下 <Enter> 鍵，即可進入以下子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。

▸Adjust CPU FSB Frequency (MHz) (調整 CPU 外頻)

本項設定 CPU 前端匯流排的頻率(以 MHz 計)。

▸Adjust CPU Ratio (調整 CPU 倍頻比率)

本項調整 CPU 倍頻比率。本項僅在處理器支援本功能時方有效。

▸Adjusted CPU Frequency (MHz) (調整後 CPU 頻率)

本項顯示調整後 CPU 的頻率。唯讀。

▸Adjust CPU-NB Ratio (調整 CPU-NB 倍頻比率)

本項調整 CPU-NB 倍頻比率。

▸Adjusted CPU-NB Frequency (MHz) (調整後 CPU-NB 倍頻比率)

本項顯示調整後 CPU-NB 倍頻頻率。唯讀。

▸EC Firmware

本項選擇「進階時脈校正」選項中的 EC Firmware。若要開核，請將本項設為 [Special] 再調整「進階時脈校正」為 [Auto] 即可。

▸Advanced Clock Calibration (進階時脈校正)

本項用來超頻。設為開啟 [Enabled] 將 CPU 倍頻比率調到較高值。本項僅在處理器支援本功能時方有效。

▸Auto OverClock Technology (自動超頻技術)

將本項設為 [Max FSB] 讓系統自動測到最高 FSB 倍頻比率去超頻。若不幸超頻失敗，請將 FSB 頻率設為較低數值試試。

▸MultiStep OC Booster

本項避免 BIOS 執行超頻時當機。

[關閉]	關閉本項，於開機自我測試 POST 時套用超頻設定。
[模式 1]	先於開機自我測試 POST 時部份超頻，載入作業系統後再完整超頻。
[模式 2]	載入作業系統再套用超頻設定。

▸Memory-Z

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。

▸DIMM1~4 Memory SPD Information (DIMM1~4 記憶體 SPD 訊息)

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。本項顯示已安裝記憶體訊息。

▸Advance DRAM Configuration (進階記憶體設定)

按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。

▸DRAM Timing Mode (記憶體時序模式)

本項可自動偵測記憶體時序。將本項設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，部份欄位會出現反白並可選擇。DCT 0 控制通道 A，而 DCT1 控制通道 B。

▸CAS Latency (CL)

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。本項控制行位址信號 (CAS) 延遲，也就是於 SDRAM 接收讀取指令後，開始進行讀取前的延遲時間 (以時脈計)。

▸tRCD

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。在DRAM更新時，列和欄位址是分開處理的。本項設定列位址 (RAS) 到行位址 (CAS) 之間的過渡時間。時脈數越少，記憶體的效能越好。

▸tRP

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。本項控制列位址(RAS)預充電的時脈。若未累積足夠時間，讓列位址在記憶體更新之前預充電，更新可能會不完全，且記憶體可能漏失資料。本項僅適用於系統安裝同步動態隨機存取記憶體時。

▸ tRAS

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。本項指定 RAS 由讀取到寫入記憶體所需時間。

▸tRTP

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。讀取到預充電間的間隔時間。

▸tRC

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。本項是記憶體完成列活化，到預充電整個週期所需的最小時脈。

▸tWR

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。本項指定從整個有效的寫入過程到記憶體預充電之間的延遲時脈，是為確保預充電前，寫入緩衝區的資料能確實寫入記憶體。

▸tRRD

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。本項設定不同記憶體間(active-to-active) 的延遲時脈。讀取到預充電指令間的時間差。

▸tWTR

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。 本項控制寫入資料到讀取指令延遲的記憶體時序，涵蓋最後有效讀入過程到下次讀取指令給 DDR 裝置間所需的最小時脈。

▸tRFC0~3

將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。本項決定 RFC 由記憶體讀取及寫入記憶體所需時間。

▸tWRTTO

本項可自動偵測記憶體時序。將本項設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，部份欄位會出現反白並可選擇。由讀取到寫入資料的時序，亦即 CAS 上次讀取的時脈到下次寫入時間的最短週期。將本欄位設為較小的值，系統會以較快速度執行，但相對系統可能會不穩。請視記憶體模組狀況調整。

▸tWRRD

本項可自動偵測記憶體時序。將本項設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，部份欄位會出現反白並可選擇。寫入到讀取資料的時序，亦即上次提供給晶片或記憶體的虛擬 CAS 寫入時脈到下次讀取間的最短週期。將本欄位設為較小的值，系統會以較快速度執行，但相對系統可能會不穩。請視記憶體模組狀況調整。

▸tWRWR

本項可自動偵測記憶體時序。將本項設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，部份欄位會出現反白並可選擇。寫入到寫入的時序，亦即首次虛擬 CAS 寫入時脈到下次變更已開啟的結束字元間的最短週期。本欄位設為較小的值，系統會以較快速度執行，但相對系統可能會不穩。請視記憶體模組狀況調整。

▸tRDRD

本項可自動偵測記憶體時序。將本項設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，部份欄位會出現反白並可選擇。讀取到讀取的時序設定，亦即首次虛擬 CAS 爆發讀取時脈到下次變更已開啟的 terminator 間的最短週期。將本欄位設為較小的值，系統會以較快速度執行，但相對系統可能會不穩。請視記憶體模組狀況調整。

▸DRAM Drive Strength (記憶體強度)

本功能調整記憶體資料匯流排的強度。增加記憶體匯流排強度可於超頻時增加穩定性。

▸DRAM Advance Control (記憶體進階控制)

本項可自動偵測進階記憶體時序。若將本欄位設為 [DCT 0]、[DCT 1] 或兩者 [Both] 時，部份欄位會顯示可供選擇。

▸1T/2T Memory Timing (1T/2T 記憶體時序)
將「記憶體時序模式」設為 [DCT 0], [DCT1] 或 [Both](兩者)時，可調整本欄位。本項控制 SDRAM 指令速率。若選 [1T]，則 SDRAM 信號控制器會以一週期速率執行 (T 表時序週期)，選 [2T]，則以二週期執行。

▸DCT Unganged Mode (記憶體控制器 Unganged 記憶體)
本功能將兩個 64-bit DCT 整合成 128-bit 介面。

▸Bank Interleaving (記憶體交錯技術)
本項是在記憶體超頻時提升效能的重要參數，可讓系統同時於多條記憶體 bank 間作存取。

▸Power Down Enable (開啟節電技術)
本項是種記憶體節電技術。系統在一段時間後未存取記憶體即會自動減少記憶體電壓。

▸MemClk Tristate C3/ATLVID
本項設定在 C3 和 ATLVID 模式間開啟或關閉 MemClk Trisating。

▸FSB/DRAM Ratio (FSB / 記憶體倍頻比率)
本項可調整 FSB / 記憶體的倍頻比率。

▸Adjusted DRAM Frequency (MHz) (調整後記憶體頻率)
本項顯示調整後記憶體的頻率。唯讀。

▸Onboard VGA Over Clock (內建 VGA 核心超頻)
本項用於超頻內建 VGA。

▸Onboard VGA Clock (內建 VGA 時脈)
本欄位在上項「內建 VGA 超頻」設為開啟 [Enabled] 時才會出現。本項用於調整內建 VGA 時脈。

▸HT Link Control (超執行緒連結控制)
按下 <Enter> 鍵，即可進入子選單。

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width (超執行緒進出連結頻寬)
這些選項設定超執行緒的操作頻寬。設為自動 [Auto]，系統即會自動偵測。

▸HT Link Speed (HT 連結速度)
本項調整 HyperTransport 連結速度。設為 [Auto]，系統會自動偵測 HT 連結速度。

▸Adjusted HT Link Frequency (MHz) (調整後HT 連結頻率)
本項顯示調整後 HyperTransport 連結頻率。唯讀。

▸Adjust PCI-E Frequency (MHz) (調整 PCI-E 頻率)
本項設定 PCI-E 頻率(以 MHz 計)。

▸Auto Disable DRAM/PCI Frequency (自動關閉記憶體/ PCI 頻率)
設為開啟 [Enabled]，系統會從未使用的記憶體/ PCI 插槽移除 (關閉) 時脈以減少電磁波干擾 (EMI)。

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)

上述選項用來調整 CPU、記憶體以及晶片組等的電壓。

▸Spread Spectrum (頻譜擴散組態)

主機板的時脈產生器開展到最大時，脈衝的極大值突波，會引起電磁波干擾(EMI)。頻譜擴散功能，可藉由調節脈衝以減少 EMI 的問題。若無電磁波干擾的問題，請將本項目設為關閉 [Disabled]，以達到較佳的系統穩定性及效能。若要符合 EMI 規範，請選擇開啟 [Enabled]，以減少電磁波。切記，如需進行超頻，請務必將本功能關閉，因為即使是些微的劇波，均足以引起時脈速度的增快，進而使超頻中的處理器被鎖定。

注意事項

- *若無電磁波干擾 (EMI) 的問題，請設為關閉 [Disabled]，以達較佳的系統穩定性及效能。但若要符合 EMI 規範，請選擇要減少電磁波的範圍。*
- *頻譜擴散的數值越大，可減少較多電磁波，但相對系統就越不穩定。欲知頻譜擴散適當數值，請查詢當地規範。*
- *如需進行超頻，請務必將本功能關閉，因為即使是些微的劇波，均足以引起時脈速度的增快，進而使超頻中的處理器被鎖定。*

注意事項

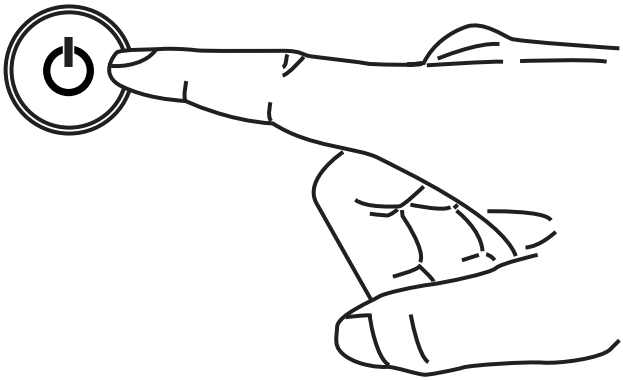
超頻失敗的解決方法

本主機板的設計可支援超頻的功能。但前提是需確認零件可承受超頻此異常設定。基本上，我們不建議任何超出產品規格的操作設定。對於不當操作或超出產品規格的模式所引起的損壞及危險，我們亦不提供任何保固。

將系統由超頻失敗救回的二個方法...

- ***重新開機***

  按電源鈕將系統重開三次。請務必注意，每次開機均須間隔十秒以上，以避免電流影響其它裝置或零組件。



在第四次開機時，BIOS會認定先前的超頻失敗，並自動恢復原設定。請在下列訊息出現時，按任意鍵正常開機。

```
Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....
```

- ***清除 CMOS***

  請參閱本手冊清除 CMOS 資料的方法。

軟體訊息

請取出隨附的驅動程式或公用程式光碟片，並放入光碟機中。該軟體會自動執行，請點選該驅動程式或公用程式，接著照跳出視窗指示即可完成安裝。驅動程式或公用程式光碟內含：

- 驅動程式選單：本選單顯示所有可用驅動程式。請依個人需求安裝啟用裝置。
- 公用程式選單：本選單列出主機板支援的軟體程式。
- 網站選單：本選單列出可能會用到的網站。

注意事項

若要取得最新驅動程式及 BIOS 以獲較佳系統效能，請上微星科技網站取得相關訊息。

785G-E65 系列

简体中文

Asia version

主板规格

处理器支持

- AM3 封装支持 AMD® Phenom™ II X4/ X3 和 Athlon X4/ X3/ X2 处理器
  (要了解CPU的最新信息，请访问
  http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2)

HyperTransport

- HyperTransport™ 3.0，支持高达每秒 5.2 GT

芯片组

- 北桥: AMD® 785G 芯片
- 南桥: AMD® SB710 芯片

内存支持

- DDR3 1066/ 1333/ 1600*/ 1800*/ 2133* (*=超频) SDRAM (最大总计 16GB)
- 4 条 DDR3 DIMM (240 针 / 1.5V)
  (要了解更多模组兼容性问题,请访问
  http://www.msi.com/index.php?func=testreport)

LAN

- 通过 Realtek® RTL8111DL 支持 PCIE LAN 10/100/1000 快速以太网

IEEE 1394 (选配)

- 由 VIA® VT6315N 芯片整合
- 传输速率高达每秒 400Mb

音频

- 由 Realtek® ALC888S/ ALC889 芯片整合
- 灵活的 8 声道音频插孔
- 兼容 Azalia 1.0 规范

IDE

- 通过 AMD® SB710 支持 1 个 IDE 端口
- 支持 Ultra DMA 66/100/133 模式
- 支持 PIO，总线控制操作模式

SATA

- 通过 AMD® SB710 支持 5 个 SATAII 端口
- 支持数据传输速率高达每秒 3 Gb

E-SATA

- 通过 AMD® SB710 支持 1 个 E-SATA 端口
- 支持数据传输速率高达每秒 3 Gb

RAID

- 通过 AMD® SB710，SATA 1~5 支持 RAID 0/ 1/ 10 或 JBOD 模式

软驱

- 1 个软驱端口
- 支持一个 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB 和 2.88 MB

接口

■ 后置面板
- 1 个 PS/2 端口
- 1 个 光纤 S/PDIF-Out 端口
- 1 个 VGA 端口
- 1 个 DVI-D 端口
- 1 个 HDMI 端口
- 1 个 IEEE1394 端口 (选配)
- 6 个 USB 2.0 端口
- 1 个 eSATA 端口
- 1 个 LAN 插孔
- 6 个 灵活的音频插口

■ 板载周边
- 3 个 USB 2.0 接口
- 1 个 IEEE1394 接口 (选配)
- 1 个 S/PDIF-Out 接口
- 1 个 CD-In 接口
- 1 个 前置面板音频接口
- 1 个 机箱入侵检测接口
- 1 个 串行接口
- 1 个 TPM 接口
- 1 个 超频开关
- 1 个 电源 LED按钮
- 1 个 重启 LED 按钮
- 1 个 清除 CMOS 按钮

插槽

- 1 个 PCI Express x16 插槽
- 3 个 PCI Express x1 插槽
- 2 个 PCI 插槽，支持 3.3V/ 5V PCI 总线界面

出厂规格

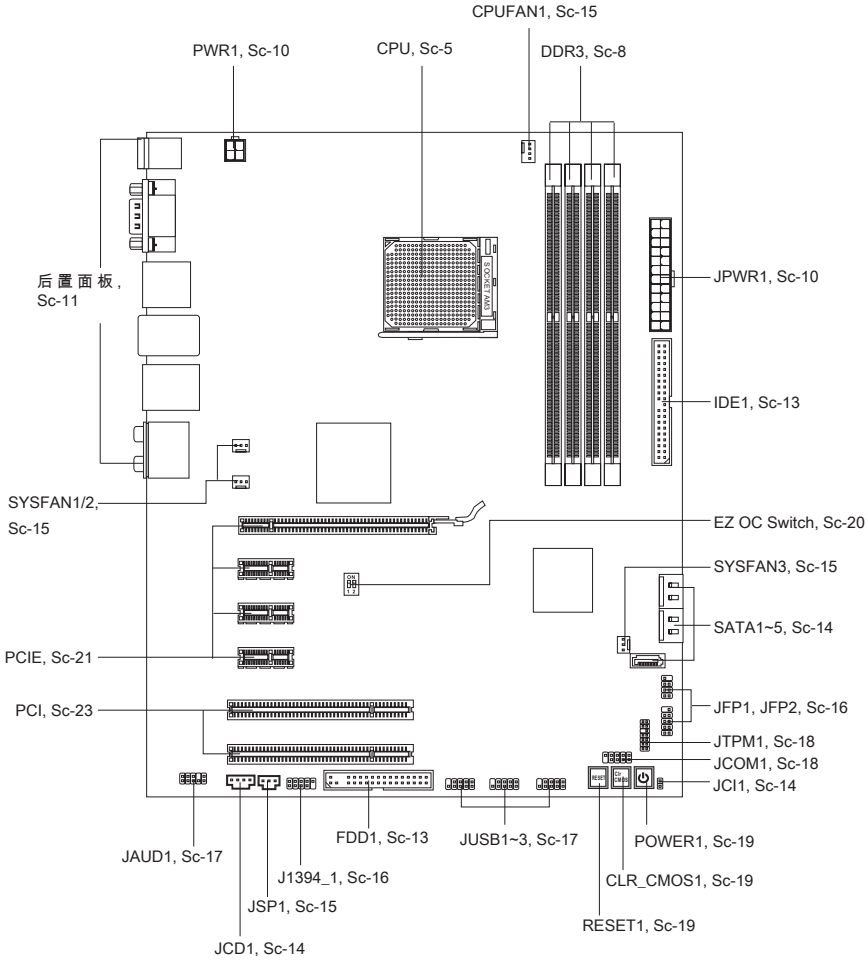
■ ATX (30.5 公分 X 24.4 公分)

固定孔

■ 9 个固定孔

如果您需要购买配件，并要求零件号码，您可以搜索该产品的网页来获得详细说明。 网址为: http://www.msi.com/index.php

组件快速指南


CPUFAN1, Sc-15
PWR1, Sc-10
CPU, Sc-5
DDR3, Sc-8
后置面板, Sc-11
JPWR1, Sc-10
IDE1, Sc-13
SYSFAN1/2, Sc-15
EZ OC Switch, Sc-20
SYSFAN3, Sc-15
SATA1~5, Sc-14
PCIE, Sc-21
PCI, Sc-23
JFP1, JFP2, Sc-16
JTPM1, Sc-18
JCOM1, Sc-18
JCI1, Sc-14
JAUD1, Sc-17
FDD1, Sc-13
JUSB1~3, Sc-17
POWER1, Sc-19
J1394_1, Sc-16
CLR_CMOS1, Sc-19
JSP1, Sc-15
RESET1, Sc-19
JCD1, Sc-14

CPU（中央处理器）

当您在安装CPU时，请务必确认您使用的CPU带有防过热的散热片和降温风扇。如果您的CPU没有散热片和降温风扇，请与销售商联系，并在开机之前妥善安装。
要了解CPU的最新信息，请访问
http://www.msi.com/index.php?func=cpuform2

注意

过热

温度过高会严重损害CPU和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护CPU以免过热烧毁。确认，您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带) 以增强散热。

更换 CPU

更换CPU时，请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。

超频

主板设计支持超频。然而，请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。

AM3 CPU 简介

在 CPU 的表面， 记得使用一些散热胶涂在 CPU 表面，使它更好的散热。



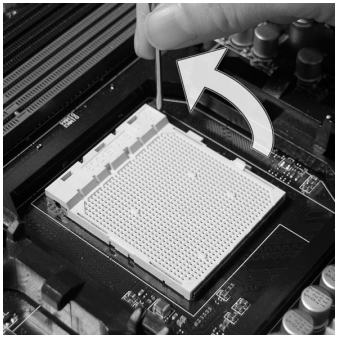
金色箭头

CPU和风扇的安装

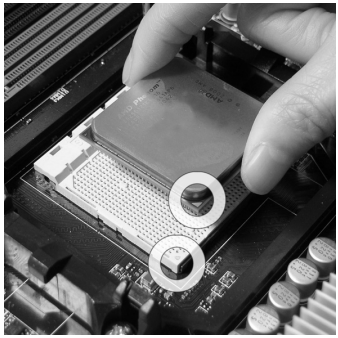
当您安装CPU时，**确认CPU带有散热片和风扇放置在CPU的顶部。**同时，请不要忘记使用一些散热胶涂在 CPU 的表面，使它更好的散热。

请根据以下步骤正确安装CPU和风扇。错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。

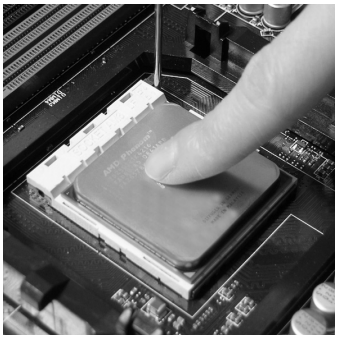
1. 将拉杆从插槽上拉起，确认与插槽成90度角。



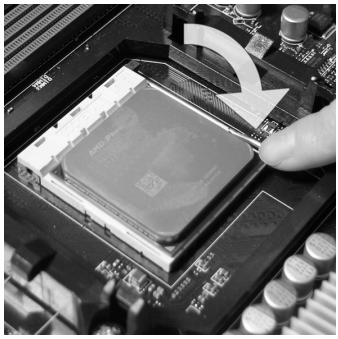
2. 寻找CPU上的金色箭头，金色箭头方向如图所示，只有方向正确CPU才能插入。



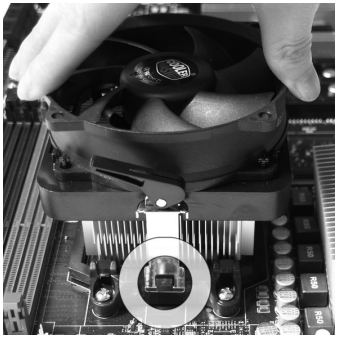
3. 如果CPU是正确安装的，针脚应该完全嵌入进插座里并且不能被看到请注意任何违反正确操作的行为都可能导致主板的永久性破坏。



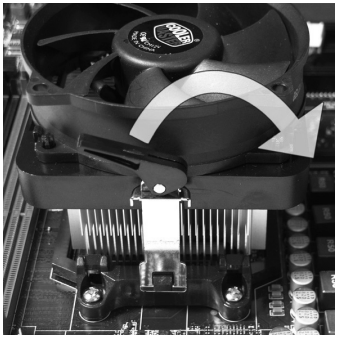
4. 稳固的将CPU插入到插座里并且关上拉杆。当拉上拉杆时CPU可能会移动一般关上拉杆时用手指按住CPU的上端，以确保CPU正确的而且是完全的嵌入进插座里了。



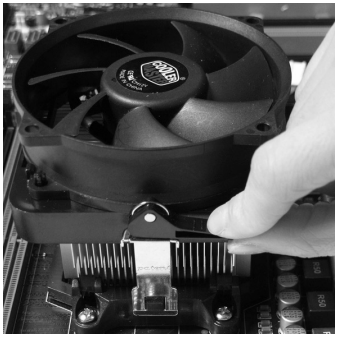
5. 将散热装置放于底座上。
首先，将钩子的一端钩住。



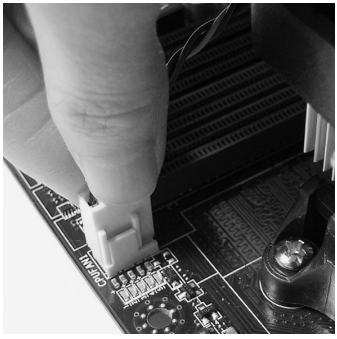
6. 然后，按下钩子的另一端，以将散热装置固定在底座上。找到固定杆并将其拉起。



7. 拉下固定杆。



8. 将CPU风扇电源线插入主板上的CPU风扇电源接口。

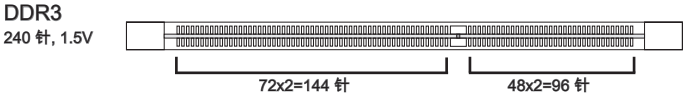


注意

- *此部分所显示的主板图片仅作为本节安装范例。实际情况会因为您购买的型号不同而有所差异。*
- *当您从固定螺栓中断开安全钩时，请务必关注您的的手指，因为一旦安全钩从固定螺被断开，固定杠杆将立即回弹。*

内存

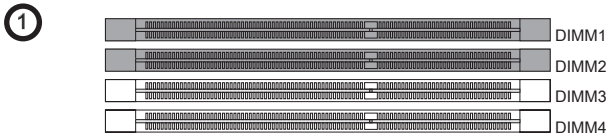
DIMM插槽用来安装内存模块。要了解内存模组支持的更新信息，请访问
http://www.msi.com/index.php?func=testreport

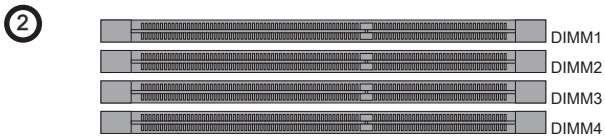


双通道内存插入规则

在双通道模式，内存模块能够在二组数据总线下同时传输和接收数据。打开双通道模式可以提高系统性能。请参考以下双通道模式下插入规则。







注意

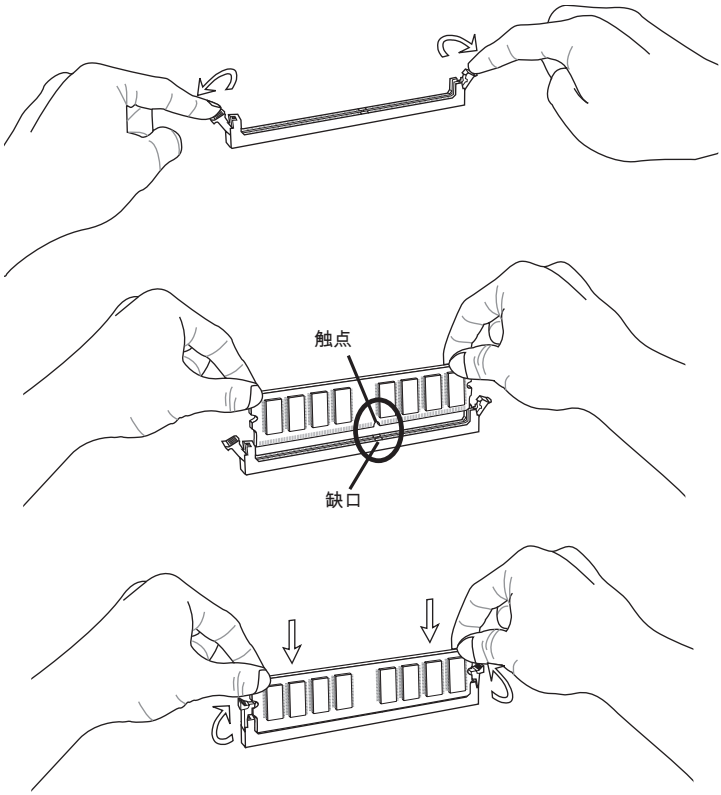
- *由于DDR3内存不与DDR2内存互换，并且DDR3不向下兼容，所以你应该把DDR3内存插入DDR3插槽中。*
- *在双通道模式下，一定要使用**同类型同密度**的内存模块，插入不同颜色的内存插槽中。*
- *要成功的启动系统，必须首先将内存模块插入DIMM1插槽中。*
- *由于系统资源部署，在每条DIMM安装一根4GB内存时，系统仅能检测出最高大于15+GB (但不足16GB)。*

安装内存模组

1. 内存模组的中央仅有一个缺口，内存将被正确的安装到插槽中。
2. 垂直插入内存模组到DIMM插槽，然后将其推入，直到内存模块金手指部分完全插入。当内存模组完全到位，二边塑料卡口将自动闭合。
3. 手动检查内存模块是否由内存槽孔夹完全锁定。

注意

如果您正确的插入了内存， 您将看不到金手指部分。

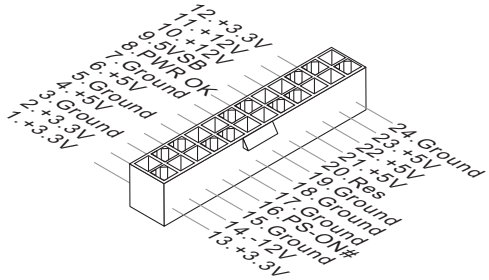


电源适配器

ATX 24-pin 电源接口: JPWR1

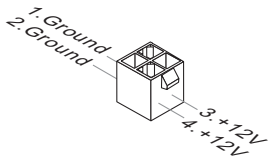
此接口可以连接ATX 24-pin电源适配器。在与ATX 24-pin电源适配器相连时，请务必确认，电源适配器的接头安装方向正确，针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入，并使其与主板电源接口稳固连接。

若您喜欢，可以使用20-pin ATX电源适配器，如果您使用20-pin ATX电源适配器，请顺着pin1和pin13插上电源适配器。



ATX 4-pin 电源接口: PWR1

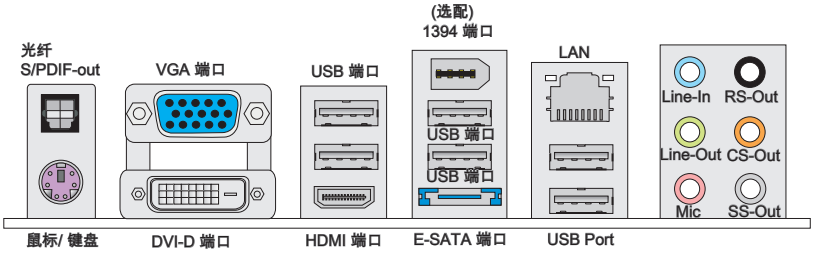
此电源接口用于为CPU供电。



注意

- *确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板提供稳定的工作电流。*
- *为了系统稳定，强烈建议您使用350瓦(或更大功率)的电源适配器。*

后置面板



▸**鼠标/ 键盘**

主板提供一个标准的 PS/2® 鼠标/键盘迷你 DIN 接口。 可连接一个 PS/2® 鼠标/键盘。

▸**USB 端口**

USB (通用串行总线)端口用于连接USB设备，如键盘，鼠标或其他USB兼容设备。

▸**VGA 端口**

此 DB15-pin 接口用于连接显示器。

▸**DVI-D 端口**

DVI-D (Digital Visual Interface-Digital) 接口允许您连接LCD显示器。它在计算机和它的显示设备之间提供一种高速数字互联。要连接LCD显示器，将您的显示器线缆轻松的插入DVI-D接口，并确认线缆另一端正确的连接到您的显示器（更多信息请参考您的显示器手册)。

▸**光纤 S/PDIF-Out**

此SPDIF(Sony & Philips 数字连接界面)连接器，通过光纤电缆传送数字音频信号到外置扬声器。

▸**HDMI 端口**

高清晰度的多媒体接口(HDMI) 是一个全数字化的audio/video 接口,能传送未压缩的数据流。HDMI支持所有电视格式，包括标准，提高，或高清晰度的视频，加上多声道数字式音频在一根唯一的数据线上。

▸**1394 端口 (选配)**

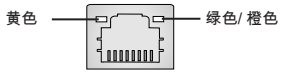
后置面板 IEEE1394 端口用于连接 IEEE1394 设备。

▸**E-SATA 端口**

此 E-SATA 端口用于连接外置 E-SATA 硬盘。

▸LAN

标准的RJ-45插孔以连接到局域网(LAN)，
你可以将一个网络线缆连接其上。



LED	颜色	LED 状态	状况
左边	黄色	关	网络未连接。
		开(稳定状态)	网络连接正常。
		开(闪烁)	此计算机与其他计算机使用网络通信中。
右边	绿色	关	10 Mbits/秒数据传输。
		开	100 Mbits/秒数据传输。
	橙色	开	1000 Mbits/秒数据传输。

▸音频端口

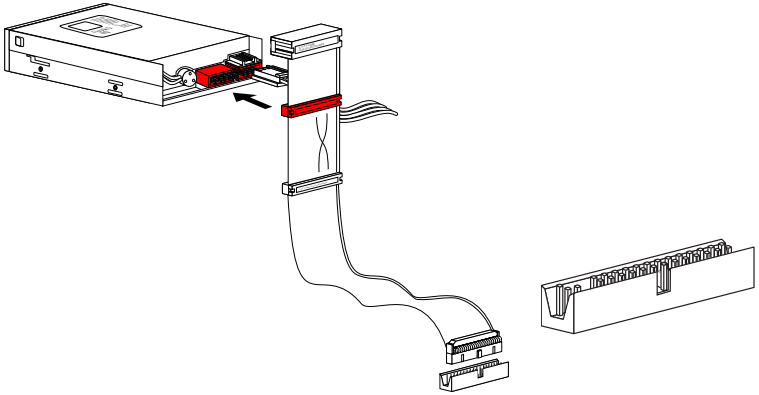
这些音频接口用于连接音频设备。您可以根据不同颜色的音频插孔来区分不同的音效。

- Line-In (蓝色) -音效输入，用于外部的CD播放器，磁带机或其他的音频设备。
- Line-Out (绿色) -音效输出，可连接音箱或耳麦。
- Mic (粉色) - 麦克风, 可连接麦克风。
- RS-Out (黑色) - 后置/环绕输出在4/ 5. 1/ 7.1声道模式中。
- CS-Out (橙色) - 中置/超重低音输出在5.1/ 7.1声道模式中。
- SS-Out (灰色) - 侧置/超重低音输出在7.1声道模式中。

接口

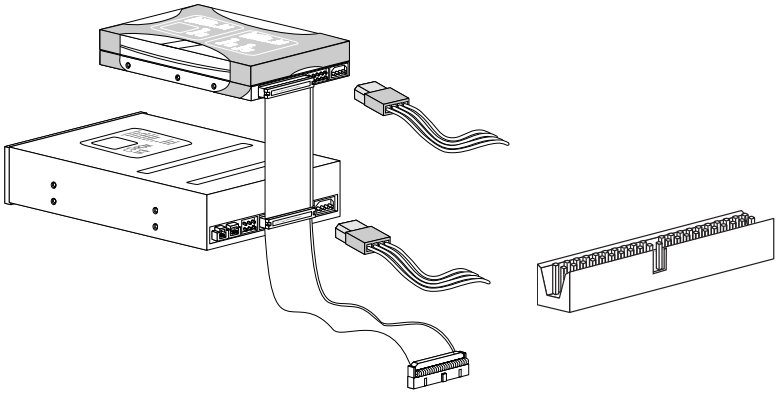
软盘驱动器接口: FDD1

此接口支持 360 KB，720 KB，1.2 MB，1.44 MB 和 2.88 MB 的软盘驱动器。



IDE 接口: IDE1

此接口支持IDE硬盘设备，光驱，和其它IDE设备。

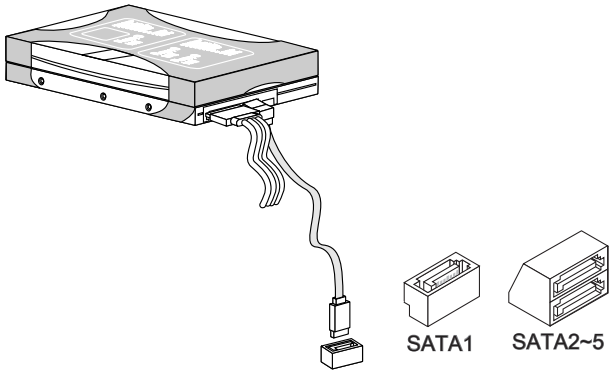


注意

如果您在硬盘线上安装第二块硬盘，您必须通过跳线分别设置硬盘为主或从模式。参见硬盘厂商提供的硬盘文档关于跳线设置的介绍。

串行 ATA 接口: SATA1~5

此接口是高速传输的Serial ATA界面端口。每个接口都可以连接 1 个Serial ATA设备。

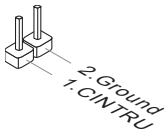


注意

请勿将Serial ATA数据线对折成90度，否则，会造成在传输过程中的数据丢失。

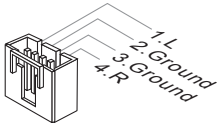
机箱入侵开关接口: JCI1

此接头与机箱开关相连。如果机箱被打开了，此接头会短接，系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。



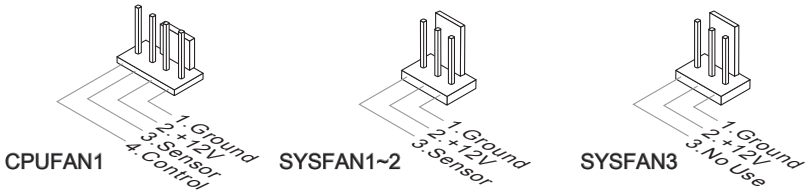
CD-In 接口: JCD1

此接口用于扩展音频输出设备连接。



风扇电源接口: CPUFAN1, SYSFAN1~3

风扇电源支持+12V的系统散热风扇。当您将接线接到风扇接头时请注意红色线为正极，必须接+12V，而黑色线是接地，必须接到GND。如果您的主机板有系统硬件监控芯片。您必须使用一个特别设计的支持风扇速度侦测的风扇方可使用此功能。

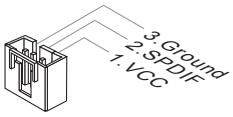


注意

- *请访问处理器官方网站以参见推荐的 CPU 风扇或咨询商家合适的 CPU 散热风扇。*
- *CPUFAN1 支持风扇控制，您可以安装 **Overclocking Center** 工具根据当前 CPU 温度自动控制 CPU 风扇速度。*
- *风扇散热器 3 针或 4 针电源接口对于 CPUFAN1 都可用。*

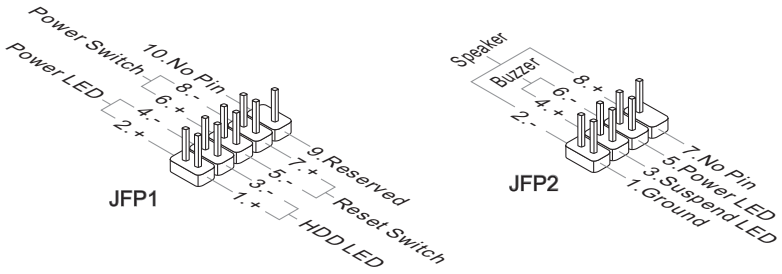
S/PDIF-Out 接口: JSP1

此接口用来连接 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 界面来传送数字音频信号。



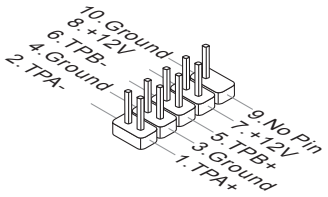
前置面板接口: JFP1, JFP2

此接口用于连接前置面板开关、指示灯。JFP1是和Intel®的前置I/O面板连接规格兼容的。



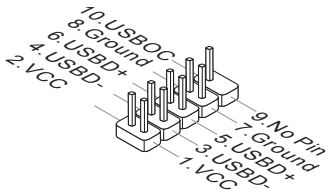
IEEE1394 接口: J1394_1 (选配)

此接口允许您使用选配的 IEEE1394 挡板连接 IEEE1394 设备。



前置 USB 接口: JUSB1 / JUSB2 / JUSB3

此接口与Intel®的I/O面板连接规格兼容的。可以连接高速的USB界面周边，例如USB HDD， 数码相机，MP3播放器，打印机， 调制解调器等。

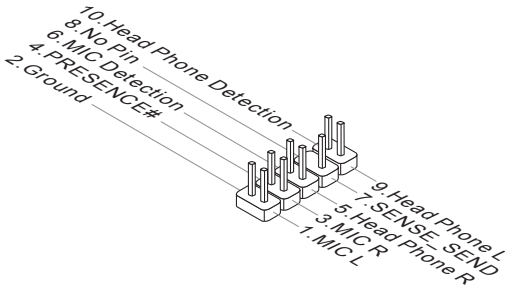


注意

请注意，VCC和GND的针脚必须安插正确，否则可能引起主板零件的损坏。

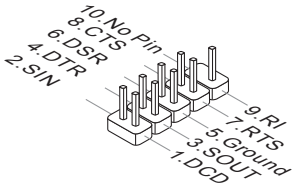
前置面板音频接口: JAUD1

您可以在前置面板接口上连接一个音频接口，它是和 Intel® 的前置 I/O 面板连接规格兼容的。



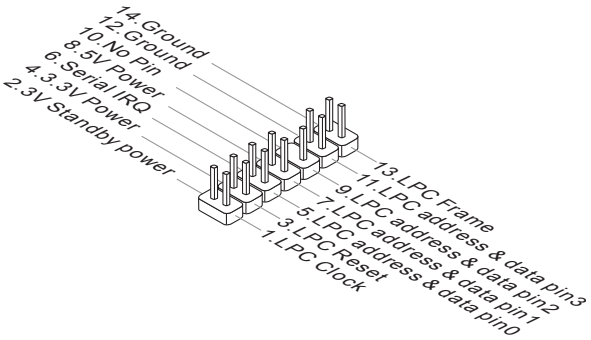
串行端口接口: JCOM1

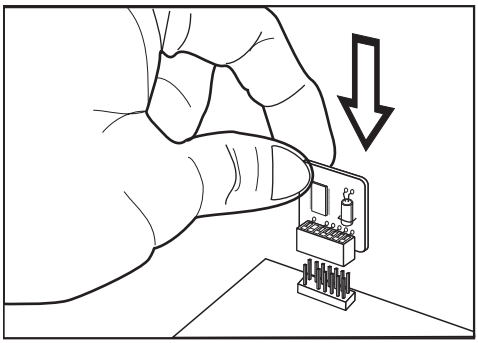
串行端口是一个每秒接收16 个字节FIFOs 的16550A 高速通信端口。您可以连接一个串行设备。



TPM 模组接口: JTPM1

此接口连接一个TPM(安全平台模组)模组(选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。



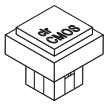


按钮

此主板提供如下的按钮用于您设定计算机功能。此节将介绍如何通过使用按钮改变您的主板功能。

清除 CMOS 按钮: CLR_CMOS1

主板上建有一个 CMOS RAM，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候引导操作系统的。如果您想清除系统配置，可使用按纽清除数据。按下按纽清除数据。



注意

请确认在清除 CMOS 数据前系统电源已关闭。

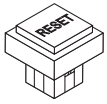
电源按钮: POWER1

电源按钮用来打开或关闭系统。按下按钮以开启或关闭系统。当您开启系统电源后此按钮灯亮。当系统电源关闭此按钮灯灭。



重启按钮: RESET1

此重启按钮用来重新启动系统。 按下按钮重新启动系统。当系统在 S0 状态下时此按钮灯将亮。



开关

FSB 超频开关: EZ OC Switch

您可以通过改变开关超频FSB以增加处理器频率。按下面的介绍设定FSB。



缺省值



FSB速度增加
10%



FSB速度增加
15%



FSB速度增加
20%

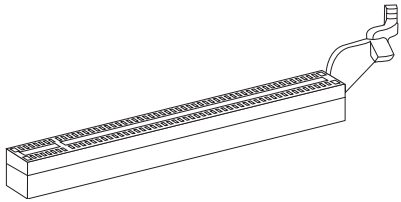
注意

- *设定开关前确保系统电源已关闭。*
- *当超频导致系统不稳定或崩溃时，请重新设置开关到默认值。*

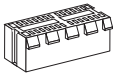
插槽

PCI (周边设备连接) Express 插槽

此 PCI Express 插槽支持 PCI Express 界面扩展卡。



PCI Express x16 插槽



PCI Express x1 插槽

Hybrid CrossFireX™ 技术

Hybrid CrossFireX™ 技术可以结合AMD® 785G内置图形处理器与独立的图形处理器同时运算。带来多个GPU的性能，以达到极速的速率，在单一显示器上完美地将图形性能发挥至极。

系统要求

1. Hybrid CrossFireX™仅支持 Vista 操作系统。
2. 支持 ATI Radeon™ HD 2400 Series[2]， ATI Radeon™ HD 3400 系列或 ATI Mobility Radeon™ HD 3400 系列图形处理器的显卡。
3. 支持 AMD® 785G 整合芯片主机板。

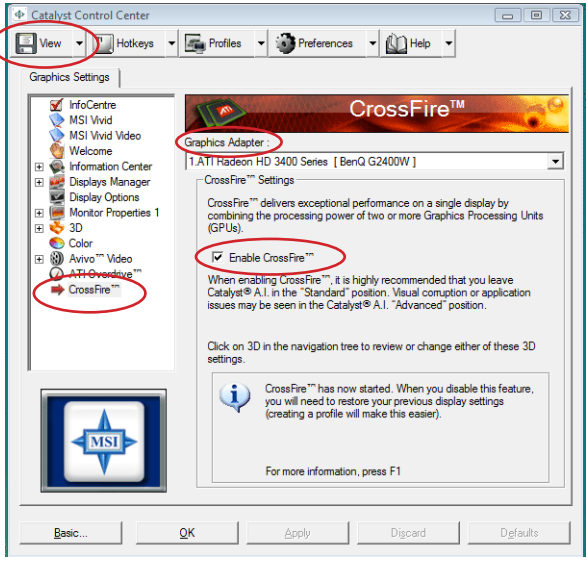
启用 Hybrid CrossFireX™ 技术

系统关机并安装支持 Hybrid CrossFireX™ 技术的 ATI 显卡。再开机安装支持 Hybrid CrossFireX™ 技术的驱动程序。再一次重新开机并等待快捷列出现 ATI 图示。点击该图标并在Catalyst 控制中心里出现如下显示:



点击此图标

1. 选择“查看”菜单下的“高级查看”。



2. 从 “Graphics Settings”图形菜单下选择 CrossFire™。
3. 从 “Graphics Adapter” 列表选择作为显示GPU的显卡。
4. 选择 “Enable CrossFire™”。
5. 点击 Apply。

当 Hybrid CrossFireX™ 启用后， 除了正在执行的 Hybrid CrossFireX™ 显示器之外，GPU Accelerated Physics 以及其它显示器都会自动停用。
欲知更多详情请参考 http://game.amd.com/us-en/crossfirex_hybrid.aspx

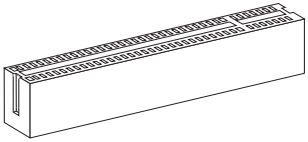
注意

变更集成显卡的运行模式可能会导致 Hybrid CrossFireX™ 失败。 为了避免这种情况发生，请按照下面的步骤安装系统：

- *关闭 Catalyst 控制中心的 Hybrid CrossFireX™ 选项。*
- *重启并进入 BIOS。*
- *选择 Advanced BIOS Features -> Chipset Feature -> On-Chip VGA 选项。*
- *保存BIOS设置，然后重启。*
- *打开 Catalyst 控制中心的 Hybrid CrossFireX™ 选项。*

PCI (周边设备连接) 插槽

PCI插槽支持网卡，SCSI卡，USB卡，和其它的一些兼容 PCI 规格的扩展卡。



32-bit PCI 插槽

注意

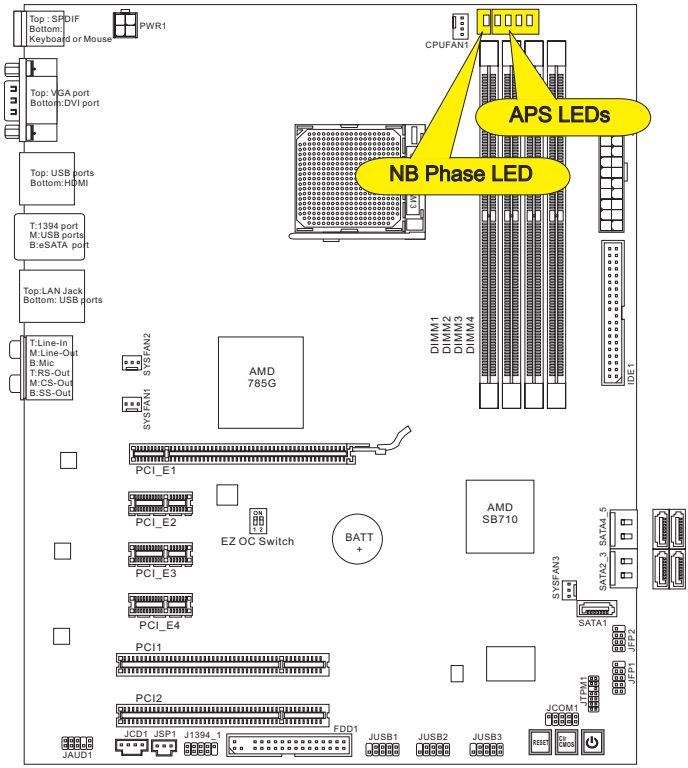
在增加或移除扩展卡时，确认首先已拔除电源。同时查看关于扩展卡的文档为扩展卡配置必要的硬件或软件，比如跳线，开关或BIOS配置。

PCI 中断请求队列

IRQ是中断请求队列和中断请求确认的缩写。将设备的中断信号送到微处理器的硬件列表。PCI的IRQ针脚一般都是连接到如下表所示的PCI总线接口:

	顺序1	顺序2	顺序3	顺序4
PCI 插槽 1	INT E#	INT F#	INT G#	INT H#
PCI 插槽 2	INT F#	INT G#	INT H#	INT E#

LED 状态灯说明



APS LEDs

这些 APS (Active Phase Switching) 指示灯表明CPU当前的电源工作模式，具体操作请阅读下面的说明。

■: 开， □: 关

■■■■ 当 CPU 在第 4 相电源模式时，4 个 LED 亮蓝色灯。
■■■□ 当 CPU 在第 3 相电源模式时，3 个 LED 亮蓝色灯。
■■□□ 当 CPU 在第 2 相电源模式时，2 个 LED 亮蓝色灯。
■□□□ 当 CPU 在第 1 相电源模式时，1 个 LED 亮蓝色灯。

NB Phase LED（NB 相位指示灯）

当 NB 正在工作时，蓝色灯亮。

BIOS 设置

此章节提供BIOS设置程序基本信息，允许您为最佳应用配置系统。您可能在以下情形要运行设置程序:

- 系统启动时屏幕上显示错误信息，要求您运行 BIOS SETUP。
- 您希望改变缺省设定到定制特性。

注意

- *BIOS中的每一项都是在不断更新，以提高系统性能。所以此章节中描述的BIOS跟最新的BIOS有些细微的差异，仅供参考使用。*
- *在启动时，BIOS版本出现在内存数目后面的第一行。它的常见格式为:*

A7576AMS V1.0 072409 此处:

第1位说明了BIOS的制造者 A = AMI，W = AWARD，P = PHOENIX。

第2-5位代表产品编号。

第6位代表了芯片组 I = Intel, N = NVIDIA, A = AMD 和 V = VIA。

第7-8位代表客户，MS=所有普通用户。

V1.0 表示BIOS 版本。

072409 表示BIOS的更新日期。

BIOS 设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按<DEL> 键即可进入设定程序。

Press DEL to enter SETUP

（按 DEL 键进入设定）

如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

获得帮助

进入setup程序之后，第一个屏幕就是主菜单。

主菜单

主菜单显示了BIOS所提供的设定项目类别。您可用方向键（↑↓）选择不同的条目。对选定项目的提示信息显示在屏幕的底部。

子菜单

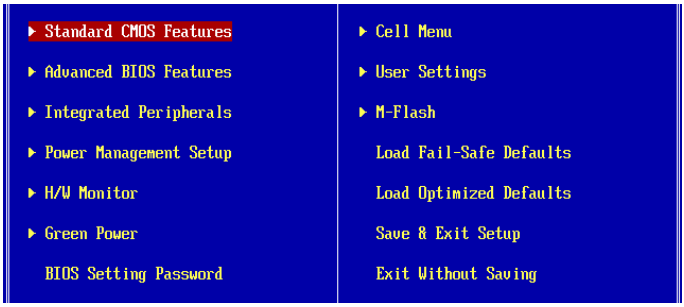
如果您看到向右的指示箭头符号（如右图所示）出现在某些选项的左边，这表示包含附加选项的子菜单可从这些选项中展开。您也可使用控制键位（↑↓）以高亮显示选区并按<Enter>以唤出子菜单。然后您可使用控制键位来进入选值，并在子菜单中进行选择。如果您要返回到主菜单，请按<Esc>键位。

主题帮助 <F1>

BIOS设置菜单提供您主题帮助的屏幕。您可在任一菜单中按<F1>以唤出此幕。此帮助屏幕列出了高亮显示项目的使用控制键位和相关选项。按<Esc>以退出帮助屏幕。

主菜单

一旦您进入 BIOS CMOS设置工具，屏幕上将显示主菜单。主菜单允许您从功能设置项和两个退出选择项做出选择。使用方向键选定项并按<Enter>接受或进入子菜单。



▸Standard CMOS Features（标准CMOS特性）
使用此菜单可对基本的系统配置进行设定。如时间，日期等。

▸Advanced BIOS Features（高级BIOS特性）
使用此菜单可以进行设置特别增强的特性。

▸Integrated Peripherals（整合周边）
使用此菜单可对周边设备进行特别的设定。

▸Power Management Setup（电源管理设置）
使用此菜单可以对系统电源管理进行特别的设定。

▸H/W Monitor（硬件监视）
此菜单用来显示计算机的健康状态。

▸Green Power
此菜单用来设定电源相位。

▸BIOS Setting Password（BIOS密码设置）
使用此项可设置 BIOS 的密码。

▸Cell Menu（核心菜单）
使用此菜单可以对频率/电压控制进行设定。

▸User Settings（用户设置）
用此菜单到/从BIOS里的CMOS中保存/ 加载您的设定。

▸M-Flash
使用此菜单可以从存储装置读取或刷新 BIOS（仅支持 FAT/FAT32 装置）。

▸Load Fail-Safe Defaults（载入故障保护缺省值）
使用此菜单可以载入BIOS厂商为稳定系统性能而设定的缺省值。

▸Load Optimized Defaults（载入优化设置缺省值）
使用此菜单可以为稳定系统操作性能载入系统优化性能设置的BIOS值。

▸Save & Exit Setup（保存后退出）
保存对CMOS的修改，然后退出Setup程序。

▸Exit Without Saving（不保存退出）
放弃对CMOS的修改，然后退出Setup程序。

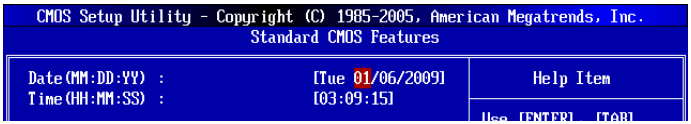
当进入BIOS设置工具，下列步骤用于一般应用。

1. Load Optimized Defaults : 使用控制键（↑↓）高亮 Load Optimized Defaults 区域并按 <Enter>键， 显示下面的信息:

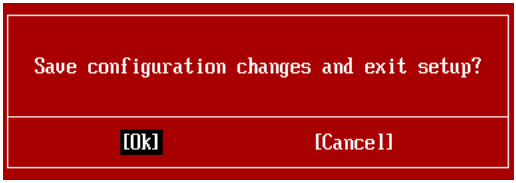


按 [Ok] 为优化系统性能载入缺省设置。

2. Setup Date/ Time : 选择 Standard CMOS Features 并按<Enter>进入 Standard CMOS Features-菜单。调整日期，时间选项。



3. Save & Exit Setup : 使用控制键（↑↓）高亮 Save & Exit Setup 区域并按 <Enter>键，显示下面的信息:



按 [Ok] 保存配置，退出BIOS Setup utility。

注意

以上配置仅用于一般应用。如果您需要BIOS设置详细设定，请查阅MSI网站英文版说明书。

4. Cell Menu 介绍：此菜单用于希望超频主板的高级用户。



注意

仅当您熟悉芯片组时，才可以更改这些设定值。

▸Current CPU/ DRAM Frequency（当前 CPU / DRAM 频率）

此项用来显示当前CPU和内存频率。只读。

▸CPU Specifications（CPU 属性）

按<Enter>进入子菜单。子菜单显示已安装的CPU信息。

▸AMD Cool'n'Quiet
Cool'n'Quiet 技术可以有效及大幅降低CPU速度及电源损耗。

注意

要确定 Cool'n'Quiet 功能被打开并正常工作，请务必再次确认:

** 运行BIOS设置，并选择 Cell Menu。在** Cell Menu**下找到 **AMD Cool'n'Quiet**，并将此设置为 "Enabled"。*

- *进入Windows，并选择 [Start]->[Settings]->[Control Panel]->[Power Options]。进入 Power Options Properties 标签。并在 Power schemes 下，选择 Minimal Power Management 。*

▸CPU Technology Support（CPU技术支持）
按<Enter>进入子菜单，此菜单显示已安装CPU所支持的技术。 只读。

▸Adjust CPU FSB Frequency (MHz)（调整 CPU FSB 频率，单位 MHz）
此项允许您设置CPU前端总线频率。单位MHz。

▸Adjust CPU Ratio（调整 CPU 倍频）
此项允许您调整 CPU 倍频。仅在您的处理器支持此功能时才生效。

▸Adjusted CPU Frequency (MHz)（调整后的 CPU 频率，单位MHz）
显示调整后的 CPU 频率。只读。

▸Adjust CPU-NB Ratio（调整 CPU-NB 倍频）
此项用来调整 CPU-NB 倍频。

▸Adjusted CPU-NB Frequency (MHz)（调整后的 CPU-NB 频率）
显示调整后的 CPU-NB 频率。只读。

▸EC Firmware（EC 固件）
此项允许您选择高级时钟校准的EC固件。对于未锁定的附加内核，您可以设置它为[Special]同时设定高级时钟校准到[Auto] 。这样可以激活处理器的内核。

▸Advanced Clock Calibration（高级时钟校准）
此项提供超频。当设置[Enabled]，允许您去设置CPU更高频率。当处理器支持此功能时才能实现。

▸Auto OverClock Technology（自动超频技术）
当设置此项为 [Max FSB] 时允许系统自动检测 FSB 超频极限。 假如超频失败，您可以通过降低 FSB 时钟频率，从而达到成功超频。

▸MultiStep OC Booster（多段超频启动）
此项用来避免超频时 BIOS 可能遇到的风险。

[Disabled]	关闭此项， 允许通过 POST 超频。
[Mode 1]	通过 POST 简单超频，然后允许载入系统时完整超频。
[Mode 2]	载入操作系统然后允许超频设置。

▸MEMORY-Z
按<Enter>进入子菜单。

▸DIMM1~4 Memory SPD Information（内存速度信息）

按<Enter>进入子菜单。 此菜单显示已安装内存信息。

▸Advance DRAM Configuration（高级DRAM 配置）

按<Enter>进入子菜单。

▸DRAM Timing Mode（DRAM 时序模式）

该选项可以自动检测所有内存条的时序，如果您设置该项为 [DCT 0]，[DCT 1] 或 [Both]，一些区域将会出现并可以设置。 DCT 0 控制通道A，DCT1 控制通道 B。

▸CAS Latency (CL)（CAS 延时）

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。控制CAS延迟，决定SDRAM接受并开始读取指令的延迟时间（在时钟周期内）。

▸tRCD

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。 在DRAM重置时，列和栏位置是分开处理的。此项设定列位址 (RAS)到行位址(CAS)和信号之间的延迟时间。时序数越少，DRAM 的效能越好。

▸tRP

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。此项控制列位址(RAS)预充电的时序。若无足够时间，让列位址在DRAM更新之前预充电，更新可能会不完全，而且DRAM可能漏失资料。此项仅适用于系统安装同步动态随机存取内存时。

▸tRAS

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。此项指定RAS由读取到写入内存所需时间。

▸tRTP

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。此项设定读取到预充电的时间间隔。

▸tRC

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。行周期时间决定了完成一个完整的循环所需的最小周期数，也就是从行激活到行充电的时间。

▸tWR

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。 此项指定从整个有效的写入过程到内存预充电之间的延迟时脉。为确保预充电前，写入缓冲器的资料能确实写入内存。

▸tRRD

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。在不同的banks中指定active-to-active延迟。

▸tWTR

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。此项控制写入资料到读取指令延迟的内存时序。包含最后有效读入过程到下次读取指令给同台DDR装置间所需的最小时脉。

▸tRFC0~3

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]， 此项可调整。此项指定RFC由读取到写入内存所需时间。

▸tWRTTO

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]，[DCT1] 或 [Both]，此区域可调整。它是指读时序到写数据时序时，CAS读操作指令的最后一个时钟到下一条写操作指令间的最小周期。如果你把这一项值设得较小，系统将运行较快但较不稳定。请根据内存模块参数设置此项。

▸tWRRD

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]，[DCT1] 或 [Both]，此区域可调整。它是指写时序下接读时序时，不同芯片或DIMM的从第一个虚拟CAS突发写入操作的最后一个时钟到下一个突发读入操作的最小周期。如果你把这一项值设得较小，系统将运行较快但较不稳定。请根据内存模块参数设置此项。

▸tWRWR

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]，[DCT1] 或 [Both]，此区域可调整。它是指写时序下接写时序时，从第一个虚拟CAS突发写入操作的最后一个时钟到下一个改变了激活的结束时序的突发写入操作的最小周期。如果你把这一项值设得较小，系统将运行较快但较不稳定。请根据内存模块参数设置此项。

▸tRDRD

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]，[DCT1] 或 [Both]，此区域可调整。它是指当读时序下接读时序时，不同芯片或DIMM的从第一个虚拟CAS突发读入操作的最后一个时钟到下一个突发读入操作的最小周期。如果你把这一项值设得较小，系统将运行较快但较不稳定。请根据内存模块参数设置此项。

▸DRAM Drive Strength（内存驱动强度）

此功能允许用户控制内存数据总线的信号强度，增加内存总线的驱动强度可以增强超频的稳定性。

▸DRAM Advance Control（内存高级控制）

此区域有自动检测高级内存时序的功能。如果您设置此区域为 [DCT 0]，[DCT 1] 或 [Both]，一些选项将出现并可选。

▸1T/2T Memory Timing（1T/2T 内存时钟）

当 DRAM Timing Mode 设置为 [DCT 0]， [DCT1] 或 [Both]，此区域可调。 此项控制 SDRAM 命令速率。选择 [1T] 使控制器运行在一周期速率执行 (T=时钟周期)。选择 [2T] 使控制器运行在二周期速率执行。

▸DCT Unganged Mode（DCT Unganged 模式）

此选项用来把两个64位DCT整合成一个128位界面。

▸Bank Interleaving（内存交错技术）

内存交错技术选项是一个提高内存超频兼容性重要选项，它允许系统同时访问多个内存bank。

▸Power Down Enable（省电模式）

此选项是一个内存省电技术. 当系统在一段时间内没有访问内存，它将自动地降低内存供电。

▸MemClk Tristate C3/ATLVID（C3 与 ATLVID 间转换）

此选项允许您打开或关闭内存在 C3 与 ATLVID 模式间的三态转换。

▸FSB/DRAM Ratio（FSB/DRAM 比率）
此项允许您选择FSB时钟的倍频和内存时钟的倍频。

▸Adjusted DRAM Frequency (MHz)（调整后的内存频率，单位MHz）
显示调整后的内存频率。只读。

▸Onboard VGA Over Clock（板载显卡超频）
此项允许您对板载显卡进行超频。

▸ Onboard VGA Clock（板载显卡时钟频率）
当 Onboard VGA Over Clock 设置为 [Enabled] 时，此选项出现。 它允许您去调整板载显卡的时钟频率。

▸HT Link Control（HT 连接控制）
按<Enter>进入子菜单。

▸HT Incoming/ Outgoing Link Width（HT上/下行连接宽度）
此项允许您设置 Hyper-Transport 连接宽度。 设置为 [Auto]，系统将自动监测HT连接宽度。

▸HT Link Speed（HT 连接速度）
此项允许您设置 Hyper-Transport 连接速度。设置[Auto]，系统将自动地检测 HT 连接速度。

▸Adjusted HT Link Frequency (MHz)（调整后的 HT 连接频率）
此项显示调整后的 HT 连接频率。只读。

▸Adjust PCI-E Frequency (MHz)（调整 PCI-E频率，单位MHz）
此项允许您设定PCIE频率，单位MHz。

▸Auto Disable DRAM/PCI Frequency（自动关闭 DRAM/PCI 频率）
设为[Enabled]，系统将从空的DRAM/ PCI插槽移除(关闭)时钟以最小电磁干扰(EMI)。

▸CPU VDD Voltage (V)/ CPU-NB VDD Voltage (V)/ CPU Voltage (V)/ CPU-NB Voltage (V)/ DRAM Voltage (V)/ NB Voltage (V)/ HT Link Voltage (V)/ SB Voltage (V)
此项用来调整 CPU，内存和芯片组的电压。

▸Spread Spectrum（展频）

当主板上的时钟震荡发生器工作时，脉冲的极值（尖峰）会产生EMI（电磁干扰）。频率范围设定功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰，所以脉冲波的尖峰会衰减为较为平滑的曲线。如果您没有遇到电磁干扰问题，将此项设定为 [Disabled]，这样可以优化系统的性能表现和稳定性。但是如果您被电磁干扰问题困扰请开启此项，这样可以减少电磁干扰。注意，如果您超频使用，必须将此项禁用。因为即使是微小的峰值漂移（抖动）也会引入时钟速度的短暂突发。这样会导致您超频的处理器锁死。

注意

- *如果您没有任何EMI方面的问题，要使系统获得最佳的稳定性和性能，请设置为[Disabled]。但是，如果您被EMI所干扰的话，请选择Spread Spectrum(频展)的值，以减少EMI。*
- *Spread Spectrum (频展) 的值越高，EMI会减少，系统的稳定性也相应的降低。要为Spread Spectrum (频展) 设定一个最合适的值，请参考当地的EMI规章。*
- *当您超频时,请关闭 Spread Spectrum (频展) ，因为即使一个很微小峰值漂移也会引入时钟速率的短暂推动，这样会导致您超频的处理器锁死。*

注意

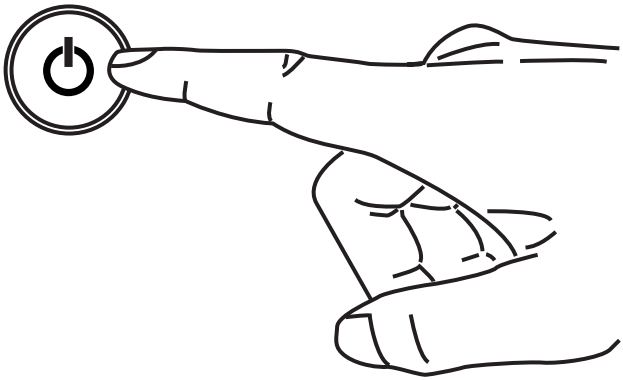
超频失败后的解决方案

此主板支持高超频性能。 然而，请确保您的外围设备和组件能承受一些特殊的设置。任何超过产品规格外的动作不推荐。任何因操作不当造成的危险和毁坏将不在我们的产品保修之内。

超频失败后，两种方法保存您的系统....

- ***重启***

  按下电源开关重启系统三次。请注意，为了避免电流对其它设别和部件的影响。我们建议重启动作间隔超过10秒。



在第四次重启之后， BIOS 将判断以前的超频是失败的并自动恢复默认值设置。 当下列信息显示在屏幕上时，请按任意键正常启动您的系统。

```
Warning !!! The previous overclocking had failed,
and system will restore its defaults setting,
Press any key to continue.....
```

- ***清除 CMOS***

  请参考 "如何清除 CMOS 数据" 章节获得更多关于清除 CMOS 的信息。

软件信息

从主板包装中取出驱动/工具光盘，放到光驱中。将自动运行安装，单击屏幕驱动或工具完成安装。此驱动/工具光盘内容包括:

- Driver menu : 驱动菜单显示可用的驱动。安装您需要的驱动使设备可用。
- Utility menu : 工具菜单显示主板支持的软件应用程序。
- WebSite menu : 网站菜单显示必要网页站点。

注意

请访问 MSI 官方网站以获得最新驱动和 BIOS 以得到最佳系统性能。

有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB 板	○	○	○	○	○	○
结构件	○	○	○	○	○	○
芯　片	×	○	○	○	○	○
连接器	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

附记 ： 请参照

- 含铅的电子组件。
- 钢合金中铅的含量达 0.35%，铝合金中含量达 0.4%，铜合金中的含量达 4%。
- -铅使用于高熔点之焊料时(即铅合金之铅含量大于或等于 85%)

  -铅使用于电子陶瓷零件。
- 含铅之焊料，用于连接接脚(pins)与微处理器(microprocessors)封装，此焊料由两个以上元素所组成且含量介于 80~85%。
- 含铅之焊料使用于集成电路覆晶封装(Flip Chippackages)内部；介于半导体芯片和载体间，来完成电力连结。